



股票代碼：6202

盛群半導體股份有限公司

一一一年度年報

刊印日期：中華民國一一二年四月十日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://www.holtek.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：

姓 名：蔡榮宗

職 稱：業務行銷中心副總經理

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：ir@holtek.com.tw

代理發言人：

姓 名：廖明通

職 稱：財務會計處處長

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：ir@holtek.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區新竹市研新二路 3 號

電 話：(03)563-1999

分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座

Block A, 3/F Tin On Industrial Building

777-779 Cheung Sha Wan Rd.

Kowloon, Hong Kong

電 話：852-2745-8288

台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2

電 話：(02)2655-7070

大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司

中國東莞松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢

電 話：86-769-2626-1300

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網 址：www.sinotrade.com.tw

電 話：(02)2381-6288

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：呂倩慧會計師、鄭安志會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓（台北 101 大樓）

網 址：www.kpmg.com.tw

電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

六、公司網址

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一一一年度年報

目 錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司簡介	
一、設立日期-----	3
二、公司沿革-----	3
參、公司治理報告	
一、組織系統-----	5
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 -----	8
三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金-----	13
四、公司治理運作情形-----	19
五、會計師公費資訊-----	42
六、更換會計師資訊-----	42
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形 -----	43
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	43
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊-----	44
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	44
肆、募資情形	
一、資本及股份-----	45
二、公司債-----	49
三、特別股-----	49
四、海外存託憑證-----	49
五、員工認股權憑證-----	49
六、限制員工權利新股-----	49
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	49
八、資金運用計畫執行情形-----	49

伍、營運概況

一、業務內容-----	50
二、市場及產銷概況-----	59
三、從業員工-----	65
四、環保支出資訊-----	65
五、勞資關係-----	65
六、資通安全管理-----	68
七、重要契約-----	70

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表-----	71
二、最近五年度財務分析-----	75
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告-----	77
四、最近年度財務報告-----	77
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告-----	77
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	77

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	79
二、財務績效-----	80
三、現金流量-----	81
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	81
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	81
六、風險事項分析-----	82
七、其他重要事項-----	83

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	84
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	90
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形-----	90
四、其他必要補充說明事項-----	90
五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	90

附錄

附錄一：111 年度合併財務報告及會計師查核報告-----	91
附錄二：111 年度個體財務報告及會計師查核報告-----	149

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

2022 年是一個變化多端的一年，原本期望新冠肺炎(COVID-19)疫情控制露出曙光，邊境逐步採取解封開放政策，全球的經濟活動將會重新活絡起來，半導體產業對於全球經濟的復甦充滿期待；但一切隨著俄烏戰端掀起一片巨浪，加上中美貿易與科技摩擦的問題加劇，以及大陸封控造成各項活動瞬間停滯，全球經濟產生重大通膨危機，從各個應用領域需求強勁造成芯片短缺，到需求急遽萎縮影響到半導體產業，導致從上游到下游與消費電子有關的公司，難有突出的營運表現，超乎 IC 產業經營團隊意料之外，盛群也受到全球消費力驟減與大陸內需及出口停滯影響，2022 年整體表現不盡理想。

2022 年盛群全年營收為新台幣(以下同) 60.16 億元，較 2021 年的 71.28 億元減少 16%，毛利率降低至 50.6%，歸屬母公司稅後淨利為 11.06 億元，較前一年度 20.44 億元下滑 46%，每股稅後盈餘為 4.89 元。

2022 年市場需求急速萎縮，導致盛群重點產品的觸控應用 MCU、32 位元 MCU、USB 應用 MCU、RF 無線通訊 MCU、電源管理(PMIC)、健康量測類 MCU、無線充電應用等，因通膨與封控影響下，營收未能達成預定目標且呈現負成長；唯安防感煙氣體偵測、直流無刷馬達 BLDC、電動工具等產品，維持良好的表現。整體而言盛群在 2022 年的表現不盡理想，有許多需要改進與注意之處，期待 2023 年積極調整。

2022 年盛群整體營運概況，分別從產品開發／業務／生產等方面做摘要說明：

產品開發方面，2022 年推出包括 8 位元、32 位元 MCU／轉廠 LCD，LED 驅動 IC／觸控／RF 無線通訊 hopping code MCU／BLDC 馬達控制及驅動 MCU／Smart Card 讀卡應用 MCU／安全防護感煙、感煙驅動、感煙聯網等 MCU／電動工具充電器等各類型 MCU IC 共 52 項，與第 2.0 代近接感應模塊／燃氣偵測數字傳感器等 8 項產品，以及 3 項開發平台，提供不同領域的客戶產品需求及提升客戶產品差異化與量產效率。

業務推廣方面，全球防疫政策不一，中國大陸仍然持續針對防疫進行封控，生產製造停滯與內需緊縮，加上終端客戶轉移大陸製造重心，進而影響到整個業務推展活動，造成 2022 年大陸地區營收較前一年度衰退 60%；反而是持續擴大印度、新興發展中國家的新市場與新客戶等，依照既定目標與計劃執行，產品項目及客源持續在增加，整體海外營收增長 26%，這是非常好的現象。

生產方面，2022 年是產銷最混亂的年度，上半年交不完的訂單到下半年市場需求急速反轉直下，晶圓封裝價格維持在高檔造成庫存急遽升高，與預期的產銷落差加大，這是 2022 年生產方面未能順利因應客戶需求的改變及未能達成年度出貨目標的主要原因。

2023 年主要營運重點：

2023 年從相關訊息推斷，新冠肺炎(COVID-19)疫情日漸降溫與解封，然因俄烏戰爭、各國升息、地緣政治風險升高，加上中國內需疲弱等問題堆疊，引爆通膨壓力快速拉升，衝擊終端消費市況，加劇全球經濟衰退的憂慮。目前下游消費性電子需求全面放緩，成品庫存去化緩慢，2023 年晶圓產能供給雖無虞，但價格並未如預期降低，盛群將以庫存去化為優先，同時持續執行重點產品的開發，內部積極降低相關費用支出，並加強開拓海外地區市場，提供全球客戶全方位的服務。

產品開發方面

盛群持續以 MCU 為主軸，積極佈局「智慧生活與安全防護應用」之相關 IC 研發，提升原有 MCU 產品的功能與性能。持續開發 32 位 Arm®核心專用 MCU，應用於圖像識別、電機控制、指紋識別、健康測量、安全防護、音樂合成…等。整合 AES 加解密功能、CRC 運算功能、24 位元高解析度 Delta-Sigma A/D 轉換器、多通道音樂合成器、CAN Bus、以及前端 AFE 等周邊。同時開發各類型數位感測模塊產品並結合 Bluetooth、Sub-1 GHz 無線射頻技術，積極搶攻物聯網(IoT)市場商機，進而接應 AIoT(人工智慧物聯網)浪潮。

產銷方面

盛群以提供全方位服務(Total Solution)為發展目標，除標準 MCU 外，針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，不斷強化既有研發能力，積極建立產品的獨創性，增加其價值。2023 年產能方面不若 2022 年來的吃緊，預期 2023 年晶圓代工及封裝測試的資源將會是無虞的，我們將以去化既有庫存為首要目標，產銷部門的關鍵工作則是如何降低晶圓採購價格以及縮短晶圓、光罩與封裝的生產時間。

由於 2023 年將面臨全球經濟下滑風險，盛群除了專注於微控制器產品(MCU)與周邊 IC 的開發與銷售外，內部各相關單位必須要積極開源與節流，包括落實內部 IC 開發 IP 模組化，有效運用研發環境與資源，提升整體效益，並持續推動執行內部成本與費用的控管。另外，盛群亦積極投入企業永續發展，我們持續從環境永續、公司治理、員工關懷、產品責任及社會共融面向一一推動，並依循「TCFD 公布之氣候相關財務揭露建議書」透過四項核心元素「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」建立風險架構，鑑別可能對營運造成的重大性風險與機會，提出其相關管理行動及應對策略；我們相信盛群於 2023 年憑藉在 MCU 長期深耕的技術經驗，與遵循 ESG 相關法令執行，從產品開發到日常生活中的節能減碳來創造企業之最大價值，將穩定獲利回饋給所有股東與同仁，善盡企業社會責任。最後感謝全體股東的支持與鼓勵。

祝福全體股東 健康如意、平安喜樂、財源廣進!

董事長 吳啟勇



總經理 高國棟



貳、公司簡介

一、 設立日期：民國八十七年十月一日。

二、 公司沿革

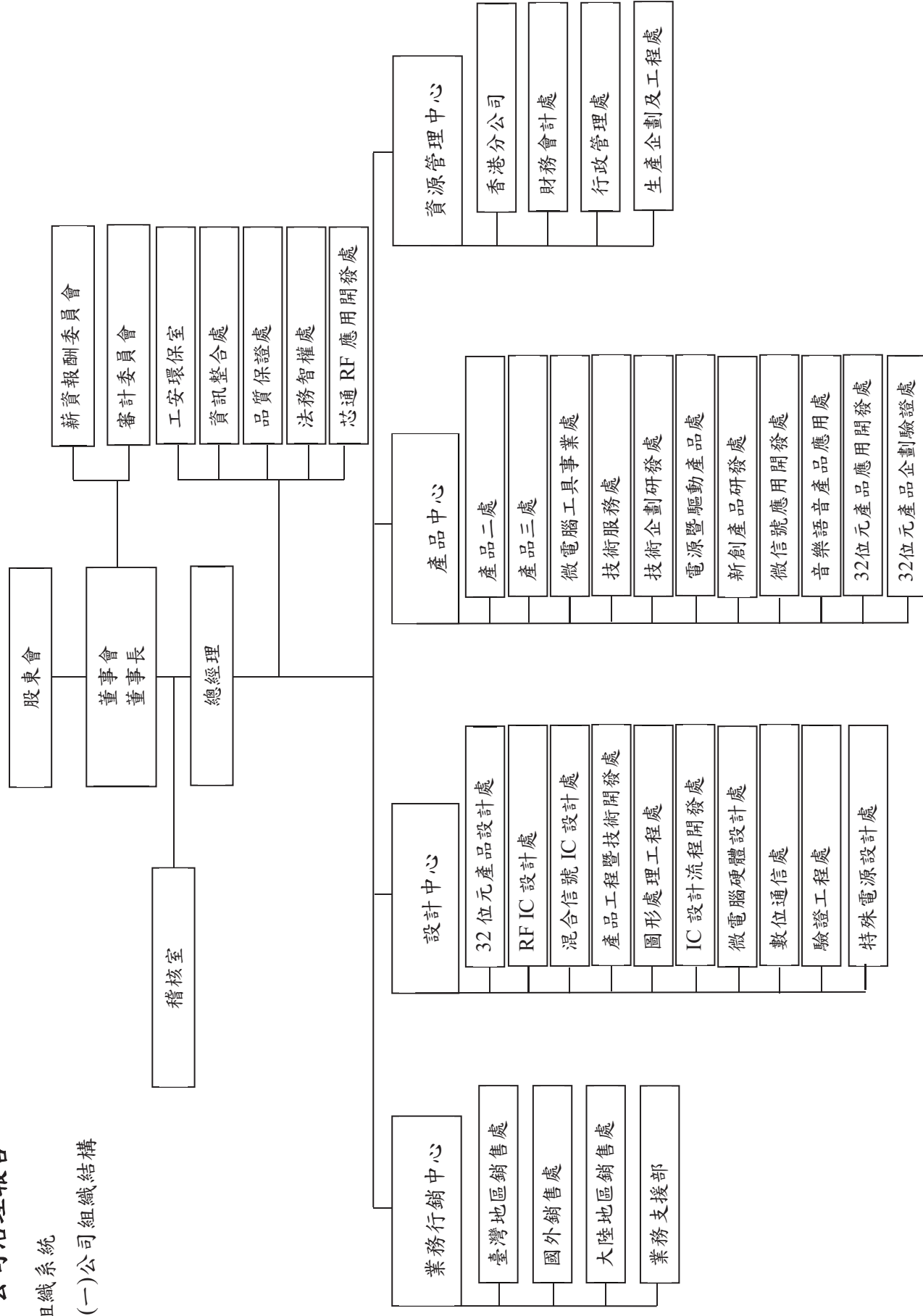
- | | | |
|--------|-----|--|
| 民國八十七年 | 十月 | 盛群半導體公司於新竹科學園區成立，設立實收資本額新台幣四億元。 |
| 民國八十八年 | 三月 | 現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。 |
| 民國八十九年 | 三月 | 推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit OTP MCU。 |
| | 四月 | 設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。 |
| | 五月 | 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。
通過國際 ISO 9001 品保認證。 |
| 民國九十年 | 三月 | 設立上海子公司(盛揚半導體(上海)有限公司)，從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 |
| | 五月 | 設立美國子公司(Holtek Semiconductor(USA), Inc.)，從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 |
| 民國九十一年 | 八月 | 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。 |
| | 十月 | 投資蘇州子公司(金科集成電路(蘇州)有限公司)，負責大陸地區生產及出貨服務。 |
| | 十一月 | 股票正式櫃檯買賣。 |
| 民國九十二年 | 七月 | 通過國際 ISO 14001 環境管理系統驗證。 |
| | 八月 | 取得 SONY"Green Partner"認證。 |
| | 九月 | 獲頒經濟部第十二屆國家發明獎。 |
| 民國九十三年 | 九月 | 股票正式上市買賣。 |
| | 十二月 | GSA 頒發 Outstanding Financial Performance Award。 |
| 民國九十四年 | 六月 | 取得華碩"Green Partner"認證。 |
| | 九月 | 取得經濟部核定在臺設立研發中心計劃。 |
| | 十月 | 取得三星電子"ECO Partner"認證。 |
| | 十一月 | 台灣首屆盛群盃 MCU 校園競賽。 |
| 民國九十五年 | 五月 | 大陸首屆盛群盃 MCU 校園競賽。 |
| | 十一月 | 通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。 |
| 民國九十六年 | 一月 | 推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit Flash MCU。 |
| | 五月 | 通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。 |
| | 十二月 | Holtek 無線 USB 語音傳輸晶片 HT82A850R/HT82A851R 榮獲中國電子業界創新大獎。 |
| 民國九十七年 | 二月 | 投資廈門子公司(芯群集成電路(廈門)有限公司)，負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。 |
| 民國九十九年 | 一月 | 推出公司第一顆整合型 8-bit Touch Flash MCU。 |
| 民國一〇〇年 | 五月 | 盛揚半導體(上海)有限公司遷移至深圳，更名為盛揚半導體(深圳)有限公司，從事大陸地區 IC 銷售及技術支持服務。 |

	六月	推出公司第一顆 Arm® Cortex™-M3 32-bit Flash MCU。
	十月	推出 Touch Key Flash MCU with LED / LCD Driver。
民國一〇一年	六月	盛揚半導體(深圳)有限公司營運據點遷移，並於東莞松山湖設立子公司(合泰半導體(中國)有限公司)，從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
民國一〇二年	九月	合泰半導體(中國)有限公司北京辦事處成立，負責大陸華北地區之銷售及技術服務。 合泰半導體(中國)有限公司杭州辦事處成立，負責大陸華東及華中地區之銷售及技術服務。 合泰半導體(中國)有限公司順德辦事處成立，負責大陸順德地區之銷售及技術服務。
	十一月	通過 WPC 聯盟 Qi 標準。
民國一〇三年	七月	推出全球最薄 6.5mm 及 4.9mm 光學式指紋辨識系列產品。 全球第五家擁有 UL 60730-1(家庭用電器用品安全機制)軟體認證的半導體公司。
	十一月	無線充電微控制器 IC 取得 WPC 無線充電聯盟 Qi 規格認證。
民國一〇四年	三月	獲選第三屆中堅企業潛力企業。
	九月	移動電源微控制器 IC 取得 UL QC2.0 規格認證。
	十二月	盛群盃 HOLTEK MCU 創意大賽邁入第十屆擴大舉辦。 推出 Arm® Cortex® -M0+。 1mm 指紋辨識感測器。
民國一〇五年	二月	盛群宣佈與 Sony Mobile 簽署合作意向書。
民國一〇六年	四月	榮獲第三屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。
民國一〇七年	十二月	盛群榮獲 GSA 頒發之 107 年最佳財務管理半導體公司獎。
民國一〇八年	四月	榮獲第五屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。
民國一〇九年	十月	STREAM 電子樂器應用音樂/語音 MCU 及開發平台。 各類消防/安防產品專用 MCU 及傳感器。
民國一一〇年	十二月	總營收突破 71 億。 盛群入圍 110 年 GSA 全球半導體產業協會最佳財務管理獎。 通過 UL / IEC 60730-1 Class B 馬達控制軟體安全認證。 新推出 Arm® Cortex® -M0+藍牙 5.2 低功耗藍牙 MCU。
民國一一一年	十二月	32-bit MCU 銷售數量累計達 1.5 億顆。 推出 32-bit 無刷直流馬達產品開發平台 HCT(紅血球容積比)血糖儀專用 MCU 及其方案。 推出各類數位傳感器模組，包含溫濕度數位傳感器、PIR 數位傳感器、氣壓數位傳感器、紅外接近感應數位模塊等。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織結構



(二)各主要部門所營業務

部 門	主要職掌
稽核室	全公司業務及行政之稽核。
工安環保室	工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。
資訊整合處	資訊系統開發架構、資安管理規劃及網路/硬體設施管理。
品質保證處	進出貨檢驗、外包廠品質監控與評鑑、品質活動推行、儀器校正作業、產品可靠度測試及客訴服務。
法務智權處	法律事務、智慧財產權建立與維護及各項諮詢服務。
芯通 RF 應用開發處	RF IC 特性規劃與驗證、法規適用參考設計、模塊開發、軟件設置規劃與驗證及通訊協議開發。
臺灣地區銷售處	臺灣地區產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。
國外銷售處	海外地區技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推廣銷售與服務。
大陸地區銷售處	大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。
業務支援部	產品庫存之調節管理、業務資訊分析及產品訂價與成本管理。
32 位元產品設計處	32 位元微處理器之相關 IC/IP 設計開發與整合。
RF IC 設計處	無線射頻接收機系統設計、整合和研發。
混合信號 IC 設計處	(A)Analog IC/IP、Memory IC/IP、Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (B)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch-up Cell 標準化。
產品工程暨技術開發處	靜電防護工程與產品工程之評估、管理及驗證等。
圖形處理工程處	(A)圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B)光罩委外製作及圖形佈局工作。
IC 設計流程開發處	(A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。
微電腦硬體設計處	MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。
數位通信處	數位信號處理器開發、數位信號處理演算法開發、通信系統架構分析與模擬、數位調變/解調技術開發、基頻資料封包處理/鏈結層控制器開發。
驗證工程處	開發工具/IC 等各種產品的規格驗證。
特殊電源設計處	電源管理晶片設計與開發規劃、低功耗控制器研究與設計規劃、電源智財開發與流程建立規劃和管理。
產品二處	8-bit MCU 之規劃、開發及產品推廣。
產品三處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU、MCU 週邊相關 ASIC 等 IC 產品開發技術，前瞻產品技術之搜尋，關鍵技術研究，關鍵性 IP 建立。 (B)VFD/LED/LCD Display Controller/Driver IC 的相關規格制定、設計開發、產品驗證及軟、硬體技術支援。
微電腦工具事業處	專案技術開發、新技術評估與導入、工具開發技術評估；客服問題處理、落實改善計畫；實驗室維護管理、零件採購與寄送。
技術服務處	對客戶需求提供技術及產品應用整合工作；新產品應用技術前置研發與執行、建立解決方案等；整合媒體資源、產學推廣及人才引進。
技術企劃研發處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU 等相關 IC 產品開發技術相關事宜，包含產品系統技術分析、IC 市場與技術開發評估、IC 規格技術企劃、IC 應用驗證、產品系統驗證、產品應用開發、技術文件及

部 門	主要職掌
	後續產品推廣技術服務等事項。 (B) 前瞻產品技術之搜尋、關鍵技術研究、關鍵性 IP 建立與提升產品層次及競爭力。
電源暨驅動產品處	電源驅動 IC 之市場企劃、設計開發及新產品推廣。
新創產品研發處	產品分析與專案企劃、人機介面專案研究與規格制訂、電腦軟體/APP 設計企劃與開發、產品 IC 規格制訂與企劃、構型與機械設計及導入機構工程量產。
微信號應用開發處	傳感器產品應用開發、特定產品專用 ASSP MCU 產品開發、IP 建立。
音樂語音產品應用處	Voice Algorithm Research 演算法先期設計技術評估及開發、Voice Algorithm Development 演算法開發移植、Algorithm Application 演算法應用。
32 位元產品應用開發處	提供 32-bit MCU 平台之軟韌體及應用增值服務。
32 位元產品企劃驗證處	32 位元微處理器產品企劃工作，制定規格並執行相關功能驗證。
香港分公司	從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。
財務會計處	財會與稅務管理、轉投資管理、資金管理、客戶信用管理、進出口保稅管理、股務及投資人關係等。
行政管理處	人力資源管理、採購總務管理。
生產企劃及工程處	統籌委外採購及封裝/測試委工、倉儲/物流管理、工具製造、封裝/測試工程等作業事宜；產銷協調，訂單交期及訂單監控，配貨出貨及貨源調配安排。

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

112 年 3 月 26 日 單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選就任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名
董事長	中華民國	吳啟勇	男 61~70	1110524	3年	870907	3932905	1.74%	3,932,905	1.74%	-	-	-	-	逢甲大學電子系 盛群半導體股份公司董事長	盛群半導體股份公司執行長 Holtek Semiconductor Holding (BVN) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVN) Ltd.、Best Comm RF Electronics Inc.、金科集成電路(蘇州)等公司之法人董事代表；盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、芯通科技、倍創科技等公司之董事長、超靈電子獨立董事	-	-
董事長代表之法人	中華民國	柏康投資(股)公司	-	1110524	3年	1110524	6,578,502	2.91%	6,578,502	2.91%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
董事	中華民國	高國棟	男 61~70	1110524	3年	870907	6,701,176	2.96%	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子科 盛群半導體股份公司總經理	盛群半導體股份公司總經理 Holtek Semiconductor Holding (BVN) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Holtek Holding (BVN) Ltd.、Siemens Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Best Module-Tech Corporation、Best Modules Corp. Holtek Semiconductor (India) Private Limited、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠捷電子(東莞)、芯動微電子(杭州)、易智芯科技(廈門)、倍易創新電子商務(廈門)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技、欣宏電子等公司之法人董事代表；金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理	-	-
董事	中華民國	張治	男 61~70	1110524	3年	930601	1,111,785	0.49%	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所 盛群半導體股份公司設計及產品中心執行副總經理	盛群半導體股份公司設計及產品中心執行副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事代表	-	-
董事	中華民國	蔡榮宗	男 51~60	1110524	3年	1080529	332,684	0.15%	300,000	0.13%	186,580	0.08%	-	-	逢甲大學自動控制系 盛群半導體股份公司業務行銷中心副總經理	盛群半導體股份公司業務行銷中心副總經理 Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Best Modules Corp.、Sanitek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、新禾電子香港、Newtek Electronics Ltd.、Thunetk 子(深圳)、新鼎電子香港、New Wave Electronics Holding Ltd.、Thunetk Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、信發電子香港、E-Micro Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、華榮匯電子科技香港、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Quanding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、全鼎電子香港、金濤高科、倍易創新電子商務(廈門)、合泰半導體(中國)、倍創科技、欣宏電子、鈺威科技等公司之法人董事代表；Holtek Semiconductor (India) Private Limited 法人董事代表暨總經理	-	-
董事	中華民國	劉添河	男 61~70	1110524	3年	1110524	50,422	0.02%	10,000	0.00%	-	-	-	-	臺北工專電子科 盛群半導體股份公司產品中心副總經理	盛群半導體股份公司產品中心副總經理	-	-
董事	中華民國	王仁宗	男 61~70	1110524	3年	930601	2,137,209	0.94%	2,137,209	0.94%	1,500,000	0.66%	-	-	清華大學科管所	無	-	-
獨立董事	中華民國	呂正榮	男 71~75	1110524	3年	910417	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 元碩企業股份公司獨立董事	-	-
獨立董事	中華民國	邢智田	男 71~75	1110524	3年	930601	36,000	0.02%	36,000	0.02%	-	-	-	-	美國佛羅里達大學電機博士 廣達電腦股份公司資深副總經理 達研究院院長	和詮科技股份有限公司獨立董事	-	-
獨立董事	中華民國	許瑞婷	女 51~60	1110524	3年	1110524	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系 元利盛精密機械股份公司經營管理處協理	元利盛精密機械股份公司經營管理處協理	-	-

註：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊，無此情形。

表一：法人股東之主要股東

112 年 3 月 26 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
柏康投資股份有限公司	章安華(42%)、吳啟勇(58%)

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 柏康投資(股)公 司代表人吳啟勇	策略管理、實務經驗、產業知識、領導能力兼備，專注於半導體產業之經營管理逾 40 年經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
董事 高國棟	決策管理與危機處理、實務經驗、產業知識、國際市場觀，專注於半導體產業之經營管理逾 40 年經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 張 治	技術研發、危機處理、實務經驗、產業知識，專精於半導體產業相關營運規劃逾 40 年經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 蔡榮宗	市場行銷及科技產業、實務經驗、產業知識、經營管理與危機處理能力。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 劉源河	市場行銷及技術服務、產業知識、實務經驗、經營管理與決策能力。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 王仁宗	公司治理、財務會計、實務經驗、經營管理與決策能力。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
獨立董事 呂正樂	具有法律、財務會計、公司治理及營運管理與實務經驗，目前是亞東聯合會計師事務所合夥會計師，且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 雖然擔任獨立董事已逾三屆(9 年)，但在經營管理上，能提供公司治理及營運管理意見與方針，因此，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1

姓名	條件	專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事 邢智田		熟稔半導體產業鏈之科技發展，具備公司治理、科技產業管理及危機處理能力與實務經驗。 雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年)，但在經營管理上，能提供產業分析及科技應用洞察力，因此，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。 未有公司法第30條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重為36,000股(0.02%)；未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事 許瑞婷		具備會計及財務分析能力、公司治理、人力資源管理、經營管理與實務經驗。 未有公司法第30條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

註：董事專業資格與經驗請參閱本年報第8頁(一)董事資料。

董事會多元化及獨立性：

- 本公司訂有董事會多元化政策，依據該政策，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - (1)營運判斷能力。
 - (2)會計及財務分析能力。
 - (3)經營管理能力。
 - (4)危機處理能力。
 - (5)產業知識。
 - (6)國際市場觀。
 - (7)領導能力。
 - (8)決策能力。
- 本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事會應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之四項。本公司目前董事會及個別董事成員均達成多元化政策之管理目標。

3.為落實董事成員符合多元化政策，考量公司營運型態及發展需求擬定目標方針包括

(1)內部、外部與獨立董事組合保持均衡。

(2)半數獨立董事任期不逾9年。

(3)女性董事席次至少一席。

4.董事會多元化政策之達成說明：

董事會成員落實多元化情形

	性別	營運判斷能力	會計財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
吳啟勇	男	V	V	V	V	V	V	V	V
高國棟	男	V	V	V	V	V	V	V	V
張 治	男	V	V	V	V	V	V	V	V
蔡榮宗	男	V	V	V	V	V	V	V	V
劉源河	男	V		V	V	V	V	V	V
王仁宗	男	V	V	V	V		V	V	V
呂正樂	男	V	V	V	V		V	V	V
邢智田	男	V	V	V	V	V	V	V	V
許瑞婷	女		V	V	V		V	V	V

本公司現任董事成員共9位，包括3位獨立董事、1位外部董事及5位具員工身份董事；獨立董事占比為33%。董事會成員包括理工、財經等相關專業背景，相關經驗則涵蓋半導體領域，包括晶圓代工(包括吳啟勇董事、高國棟董事及邢智田獨立董事，共3位)、本公司從事的IC設計(即張治董事)，產品終端應用(包括蔡榮宗董事及劉源河董事，共2位)，以及具有財經經驗(包括王仁宗董事、呂正樂獨立董事及許瑞婷獨立董事，共3位)。

5.為健全本公司之董事會結構，增加一席女性董事，全體董事間皆不具配偶及二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：112 年 3 月 26 日 單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之職稱	備 註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比例				
執行長	中華民國	吳敏勇	男	87/10/01	3,932,905	1.74%	-	-	-	-	逢甲大學電子系	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、Best Comm RF Electronics Inc.、金科集成電路(蘇州)等公司之法人董事代表；盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、芯通科技、倍創科技等公司之董事長、超豐電子獨立董事	-	-
總經理	中華民國	高國棟	男	87/10/01	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子科	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Signos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Best Module-Tech Corporation、Best Modules Corp. Holtek Semiconductor (India) Private Limited、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠捷電子(東莞)、芯動微電子(杭州)、易智芯科技(廈門)、倍易創新電子商務(廈門)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技、欣宏電子等公司之法人董事代表；金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理	-	-
執行副總 經理	中華民國	張 治	男	87/12/11	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所	金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事代表	-	-
副總經理	中華民國	蔡榮宗	男	99/06/15	300,000	0.13%	186,580	0.08%	-	-	逢甲大學自動控制系	Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Best Modules Corp.、Samek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、新禾電子香港、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、新鼎電子香港、New Wave Electronics Holding Ltd.、Inutek Technology Ltd.、信微智電子(上海)、信霖電子香港、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、Fortic Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、華榮匯電子科技香港、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Quarding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、全鼎電子香港、金壽高科、倍易創新電子商務(廈門)、合泰半導體(中國)、倍創科技、欣宏電子、始威科技等公司之法人董事代表；Holtek Semiconductor (India) Private Limited 法人董事代表暨總經理	-	-
副總經理	中華民國	劉源河	男	106/01/01	50,422	0.02%	10,000	0.00%	-	-	臺北工業專科學校電子科	無	-	-
副總經理 (註1)	中華民國	王明坤	男	100/04/01	27,349	0.01%	1,000	0.00%	-	-	臺灣技術學院電子系	Best Comm RF Electronics Inc.、芯通科技、芯通電子科技(東莞)、滾達科技、Bestway Electronics Inc.、新緯科技(深圳)、Fine Chip Electronics Inc.、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、安禧普電子科技(東莞)、JXY Electronics Corporation、深圳市集芯源電子、Best Health Electronics Corporation、悠捷電子(東莞)、悠捷電子香港、Best Drive-Tech Corporation、芯動微電子(杭州)、Best Module-Tech Corporation、易智芯科技(廈門)、Best Solution Electronic Inc.、優方科技、優方科技(東莞)等公司之法人董事代表	-	-
協理	中華民國	吳紹簡	男	92/06/23	103,845	0.05%	10,080	0.00%	-	-	東海大學物理系	無	-	-
協理	中華民國	吳德傳	男	94/04/15	1,117,317	0.49%	75,000	0.03%	-	-	成功大學電子研究所	無	-	-
協理	中華民國	余國成	男	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	-	-	逢甲大學電子系	無	-	-
協理(註2)	中華民國	王鈺鈿	男	98/07/01	-	-	-	-	-	-	成功大學電機所	無	-	-
協理	中華民國	潘建州	男	108/05/20	120,000	0.05%	10,000	0.00%	-	-	臺灣工業技術學院電機系	無	-	-
會計主管	中華民國	廖明通	男	107/06/01	18,000	0.01%	-	-	-	-	中興大學會計系	金科集成電路(蘇州)、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、安禧普電子科技(東莞)、悠捷電子(東莞)、新禾(廈門)電子、滾達電子(深圳)、信微智電子(上海)、振揚電子(青島)、華榮匯電子科技(北京)、全鼎電子(蘇州)、健芳電子科技(上海)、深圳市集芯源電子、易智芯科技(廈門)、芯動微電子(杭州)、易智芯科技(廈門)、倍易創新電子商務(廈門)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技等公司之法人監察人代表；欣宏電子監察人	-	-
財務主管				108/02/01									-	-

註1：王明坤副總經理於111年7月25日就任。

註2：王鈺鈿協理於111年5月31日解任。

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

日期：111 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (註 10)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註 11)
		報酬(A) (註 2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註 3)	業務執行費用(D) (註 4)	薪資、獎金及特支費等(E) (註 5)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G) (註 6)				本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	
						本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司		財務報告內所有公司 (註 7)				
										現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	柏康投資(股)公司代表人 吳啟勇															
董事	高國棟															
董事	張 治	0	0	0	15,199	0	0	14,612	0	0	8,824	0	8,824	0	3.49%	3.49%
董事	蔡榮宗															
董事	劉源河															
董事	王仁宗															
獨立董事	呂正樂	0	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35%	無
獨立董事	邢智田	0	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35%	無
獨立董事	許瑞婷															

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
(1)獨立董事之酬勞，係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業通常水準議定之。
(2)本公司依據「董事會績效評估辦法」，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)獨立董事之酬勞，係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業通常水準議定之。

(2)本公司依據「董事會績效評估辦法」，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)I
低於 1,000,000 元	—	—	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	王仁宗、呂正樂、邢智田 許瑞婷	王仁宗、呂正樂、邢智田 許瑞婷	王仁宗、呂正樂、邢智田 許瑞婷	王仁宗、呂正樂、邢智田 許瑞婷
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	柏康投資(股)公司 高國棟、張 治 蔡榮宗、劉源河	柏康投資(股)公司 高國棟、張 治 蔡榮宗、劉源河	柏康投資(股)公司	柏康投資(股)公司
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	吳啟勇、高國棟、張 治 蔡榮宗、劉源河	吳啟勇、高國棟、張 治 蔡榮宗、劉源河
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	9	9	10	10

註1：董事姓名應分別列示，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(二)總經理及副總經理之酬金

日期：111 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後純 益之比例(%) (註 8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)	
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所 有公司(註 5)	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)		
執行長	吳啟勇	11,188	11,188	0	0	6,194	6,194	10,588	10,588	0	10,588	0	2.53%	2.53%	無
總經理	高國棟														
執行副總 經理	張 治														
副總經理	蔡榮宗														
副總經理	劉源河	王明坤 (註 1)													
副總經理	王明坤 (註 1)														

註 1：王明坤副總經理於 111 年 7 月 25 日就任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	王明坤	王明坤
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	高國棟、蔡榮宗、劉源河	高國棟、蔡榮宗、劉源河
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	吳啟勇、張 治	吳啟勇、張 治
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	6	6

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

日期：111 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	吳啟勇	0	17,647	17,647	1.60%
	總經理	高國棟				
	執行副總經理	張治				
	副總經理	蔡榮宗				
	副總經理	劉源河				
	副總經理(註3)	王明坤				
	協理	吳紹菡				
	協理	吳德傳				
	協理	余國成				
	協理(註4)	王鈺鈿				
	協理	潘建州				
	財務會計主管	廖明通				

註1：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註2：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註3：王明坤副總經理於 111 年 7 月 25 日就任。

註4：王鈺鈿協理於 111 年 5 月 31 日解任。

(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.最近二年度董事、總經理及副總經理酬金之分析

單位：新台幣仟元

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	110 年度		111 年度		110 年度		111 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	66,386	3.25%	42,535	3.84%	66,386	3.25%	42,535	3.84%
總經理及副總經理	32,355	1.58%	27,970	2.53%	32,355	1.58%	27,970	2.53%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

(A)本公司董事酬金：依本公司章程第 19 條規定，董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之；另當年度如有獲利，依本公司章程第 24 條規定，應提撥不高於 1.5%為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之績效及酬金，由薪資報酬委員會討論依各董事執行業務程度於上述金額內分配董事酬金，再提交董事會決議。

(B)本公司經理人酬金：依「人事薪資制度」、「起薪及調薪辦法」、「員工季獎金發放標準公告」、參考同業通常水準支給情形及公司整體營運績效等訂定，包括固定薪資、績效獎金、員工酬勞及其他薪酬。其中員工酬勞係依本公司章程第 24 條規定，應提撥 5%至 15%為員工酬勞。

(2)訂定酬金之程序：

(A)為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以「董事會績效評估辦法」及適用經理人及員工之「績效評估辦法」所執行之評核結果為依據。董事酬勞係由薪資報酬委員會參考同業通常水準支給情形，並考量整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果、所投入時間、所擔負之職責等，評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯性，提出建議後提交董事會決議。經理人之酬金係依據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，並依本公司人事規章辦理。

(B)111 年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果均為「優」。

(C)為獎勵員工在工作上的努力付出，藉由薪酬結構的規劃，搭配分紅與季度獎金的利潤共享。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，皆經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：111 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	柏康投資(股)公司 代表人：吳啟勇	6	0	100%	連任，111.05.24 改選後 以法人代表人當選
董事	高國棟	6	0	100%	111.05.24 改選，連任
董事	張 治	6	0	100%	111.05.24 改選，連任
董事	林正鋒	3	0	100%	111.05.24 改選，舊任
董事	劉源河	3	0	100%	111.05.24 改選，新任
董事	蔡榮宗	6	0	100%	111.05.24 改選，連任
董事	王仁宗	6	0	100%	111.05.24 改選，連任
獨立董事	呂正樂	6	0	100%	111.05.24 改選，連任
獨立董事	邢智田	6	0	100%	111.05.24 改選，連任
獨立董事	郭泰豪	3	0	100%	111.05.24 改選，舊任
獨立董事	許瑞婷	3	0	100%	111.05.24 改選，新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已成立審計委員會不適用證券交易法第 14 條之 3 之規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：
無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事對利害關係議案均有迴避。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日	董事會 個別董事成員 審計委員會 薪資報酬委員會	董事會內部自評 、董事成員自評 、審計委員會內 部自評、薪資報 酬委員會內部自 評	1.董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 2.董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 3.審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制。 4.薪資報酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制。

以上績效評估結果提報於 112 年 2 月 16 日董事會。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (一)本公司於 100 年 10 月 25 日成立薪資報酬委員會，及 105 年 5 月 27 日成立審計委員會，以提升董事會運作效能。
- (二)本公司訂定並經董事會通過「董事會議事規則」、「董事會績效評估辦法」、「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策」，並依「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會績效評估，111 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果均為「優」。

(二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其職權包括：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、公司之併購事項。
- 十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

● 審計委員會 111 年度審議工作重點如下：

- 1、公司財務報告、營業報告書、盈餘分派。
- 2、公司內部控制制度、稽核計畫及執行情形。
- 3、公司修訂「取得或處分資產處理程序」、投資案。
- 4、委任簽證會計師及評估簽證會計師獨立性。
- 5、公司董監事及經理人責任保險。

● 審閱財務報告

董事會造送本公司 110 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本公司審計委員會依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定，委託安侯建業聯合會計師事務所查核，認為尚無不合，並經本公司 111 年 3 月 2 日審計委員會審查通過後，依規定出具審計委員會查核報告書，提報 111 年股東常會報告。

● 評估內部控制制度之有效性

本公司 111 年 3 月 2 日審計委員會通過 110 年度內部控制制度聲明書，本公司及子公司之整體內部控制制度，經審計委員會評估後認為其設計及執行係屬有效。審計委員會評估公司內部控制制度政策及程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)之有效性，並審查簽證會計師、稽核部門及管理階層之定期報告(包括風險管理與法令遵循等)，審計委員會認為公司已採用必要之控制機制來監督並糾正違規行為。

● 委任簽證會計師及評估簽證會計師獨立性

依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性及適任性。本公司經審計委員會及董事會評估簽證會計師無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事，二位會計師除簽證相關費用外，未擔任本公司之董事、經理人或重大影響之職務，亦無其他財務利益及業務關係，同一會計師未連續執行簽證服務超過七年，會計

師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合獨立性及適任性條件。本公司 111 年 3 月 2 日審計委員會及 111 年 3 月 3 日董事會通過 112 年委任安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及鄭安志會計師擔任本公司簽證會計師。

111 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	呂正樂	5	0	100%	111.05.24 改選，連任
獨立董事	邢智田	5	0	100%	111.05.24 改選，連任
獨立董事	郭泰豪	3	0	100%	111.05.24 改選，舊任
獨立董事	許瑞婷	2	0	100%	111.05.24 改選，新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111.01.25 第二屆第 14 次	1.盛凌投資股份有限公司撤銷投資案 2.本公司 110 年第 4 季稽核查核報告案。 3.本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 4.本公司 109 年合併財務報告及個體財務報告案。	全體出席審計 委員同意照案 通過	無
111.03.02 第二屆第 15 次	1.本公司 111 年 1 月份稽核查核報告案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.討論解除董事競業禁止案。 4.本公司出具內部控制制度聲明書案。 5.因應安侯建業聯合會計師事務所職務調整會計師更換案。 6.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 7.MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。	全體出席審計 委員同意照案 通過	無
111.04.22 第二屆第 16 次	1.本公司 111 年 2 月至 3 月份稽核查核報告案。 2.本公司 111 年第 1 季合併財務報告案。 3.MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。 4.MCU Holdings Ltd.調整投資案。	全體出席審計 委員同意照案 通過	無
111.07.22 第三屆第 1 次	1.本公司 111 年第 2 季稽核查核報告案。 2.本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。	全體出席審計 委員同意照案 通過	無
111.10.28 第三屆第 2 次	1.本公司 111 年第 3 季稽核查核報告案。 2.本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 3.本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 4.本公司向金融機構申請授信額度案。 5.倍創科技股份有限公司投資案。 6. MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。 7.本公司 112 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 8.本公司 112 年營運計畫書案。	全體出席審計 委員同意照案 通過	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：
無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

1.本公司每年定期召開審計委員會及董事會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，並將討論事項載明於會議記錄，獨立董事與稽核主管達到充分溝通。

日期	方式	溝通重點	結果
111.01.25	審計委員會	1.110 年第四季稽核查核報告。	本次會議無意見
111.03.02	審計委員會 會前會	1.111 年 1 月份稽核查核報告。 2.110 年度內部控制制度聲明書。	本次會議無意見
111.04.22	審計委員會	1.111 年 2 月至 3 月份稽核計畫執行報告。	本次會議無意見
111.07.22	審計委員會	1.111 年第二季稽核查核報告案。	本次會議無意見
111.10.28	審計委員會 會前會	1.111 年第三季稽核查核報告案。 2.112 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。	本次會議無意見

2.本公司進行年度財務報表審閱時，由會計師列席審計委員會及董事會，說明財務報告查核情形、重大資產評價及會計估計等，會計師針對董事所提問題進行討論及溝通。

日期	方式	溝通重點	結果
111.01.25	審計委員會 會前會	1.110 年度合併及個體財務報告查核情形。 2.說明重大資產評價及會計估計。 3.其他重大會計審計議題。	本次會議無意見

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理守則」，並揭露於公司網站的「公司治理」專區，供投資人查詢相關公司治理規章。
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司已訂定「股東會議事規則」，並設有發言人制度、投資人關係專責人員及法務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事項，並於本公司網站揭露聯繫方式。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司掌握董事、經理人及持股百分之十以上股東之持股情形。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司已訂定「對子公司之監理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，且實施必要的控管機制，建立適當的防火牆機制。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司已訂定「誠信經營守則」、「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」，嚴格禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)無差異。 本公司訂有董事會多元化政策，依據該政策，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(1)營運判斷能力、(2)會計及財務分析能力、(3)經營管理能力、(4)危機處理能力、(5)產業知識、(6)國際市場觀、(7)領導能力、(8)決策能力。 2.本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事會應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之四項。本公司目前前董事會及個別董事成員均達成多元化政策之管理目標。 3.為落實董事會成員符合多元化政策，考量公司營運型態及發展需求擬定目標方針包括(1)內部、外部與獨立董事組合保持均衡、(2)半數獨立董事任期不逾9年、(3)女性董事席次至少一席。 4.本公司現任董事會成員共9位，包括3位獨立董事、1位外部董事及5位具員工身份董事；獨立董事占比為33%。董事會成員包括理工、財經等相關

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
			專業背景，相關經驗則涵蓋半導體領域，包括晶圓代工(包括吳啟勇董事、高國棟董事及邢智田獨立董事，共3位)、本公司從事的IC設計(即張治董事)，產品終端應用(包括蔡榮宗董事及劉源河董事，共2位)，以及具有財經經驗(包括王仁宗董事、呂正樂獨立董事及許瑞婷獨立董事，共3位)。
			5.為健全本公司之董事會結構，增加一席女性董事，全體董事間皆不具配偶及二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項規定。(本公司個別董事成員資料及具備之能力請參閱本年第8~11頁)
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會協助董事會執行其職責外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二)本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會協助董事會執行其職責外，未來將視法令規定及營運需要決定是否設置其他功能性委員會。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)無差異。
			1.本公司董事會於105年1月25日通過「董事會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會之績效評估至少包括下列五大面向：(1)對公司營運之參與程度。(2)提升董事會及功能性委員會決策品質。(3)董事會及功能性委員會組成與結構。(4)董事的選任及持續進修。(5)內部控制。
			2.每年年度結束時收集董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之相關資訊，將問卷回收後，針對評估指標之評分制定，送交董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
			3.本公司於112年2月16日向董事會報告，111年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果均為「優」。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)無差異。
			1.本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供超然獨立聲明書及審計品質指標(AQIs)外，並依評估會計師標準及13項AQI指標進行評估。
			2.經確認簽證會計師除簽證相關費用外，無其他財務利益及業務關係，並參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗及受訓時數均優於同業平均水平。最近一次評估結果經112年2月15日審計委員會決議通過後，並提報112年2月16日董事會決議通過。
			3.本公司檢視簽證會計師評估標準如下

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明			
			評估項目			
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等）？	V			1.簽證會計師未與本公司有直接或重大間接財務利益關係	是	否
				2.簽證會計師未與本公司或本公司董事有融資或保證行為	V	
				3.簽證會計師未仲介本公司所發行之股票或其他證券	V	
				4.簽證會計師及審計小組成員目前或最近二年內未擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	V	
				5.簽證會計師未與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	V	
				6.簽證會計師未擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	V	
				7.簽證會計師及審計小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係	V	
				8.簽證會計師任期未逾 7 年	V	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V			1.本公司經109年10月26日董事會決議通過，指派財務主管廖明通處長擔任公司治理主管，主要職責為：依法辦理董事會及股東會之會議相關事項、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、協助董事遵循法令、提供董事執行業務所需之資料。 2.公司治理主管進修情形請參閱本年報第38頁。	無差異。	
六、公司是否委任專任專股服務代辦機構辦理股東會事務？	V			本公司設置投資人關係專責單位，包括股東、客戶、供應商及投資人公司相關資訊及溝通管道，公司網站亦設置利害關係人專區與各專責人員連絡方式，以回應利害關係人關切之議題，且每年至少一次向董事會報告執行情形。 本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。	無差異。	
七、資訊公開						
(一)公司是否架設網站，揭露及公司治理資訊？	V			(一)本公司設置中/英文網站(www.holtek.com.tw)，定期揭露財務業務及公司治理資訊。	(一)無差異。	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V			(二) 1.本公司指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，定期揭露財務業務及公司治理資訊。 2.本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料放置於公開資訊觀測站	(二)無差異。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		及本公司網站。 (三)本公司年度財務報告於年度終了後兩個月內公告及申報，第一、二、三季財務報告及各月份之營運情形，皆於規定期限內提前申報。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？	V		1.員工權益、僱員關懷：本公司制定各項符合勞工法令規定，以保障員工權益，並定期召開勞資會議，進行有效溝通。本公司設有職工福利委員會定期舉辦活動，包括年節禮券、旅遊、社團活動、員工健康檢查及團體保險等。 2.投資者關係：本公司設有發言人制度及投資人關係專責人員處理股東權益之各項事務。 3.供應商關係：本公司注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。 4.利害關係人之權利：本公司網站揭露利害關係人專區，以回應利害關係人關切之議題。 5.董事進修情形：本公司每年規劃董事進修課程，加強專業知識及實務運作，請參閱本年第37頁。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定各種風險管理机制、內部控制及規章，進行各種風險的評估及管理。本公司已於111年1月26日訂定「風險管理政策」，以作為本公司風險管理之最高指導原則。由各管理單位定期對風險事項予以評估及檢討，並向總經理報告評估結果，再由總經理彙整重大風險事項後，定期向董事會報告。 7.公司為董事購買責任保險之情形：本公司經111年10月28日審計委員會及111年10月31日董事會通過續保董監事責任保險案，111年度投保金額為美金伍佰萬元，並依規定申報於公開資訊觀測站。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。			本公司111年度公司治理評鑑結果已改善情形，包括：訂定「內線交易防制辦法」，每季定期以郵件通知董事及經理人各季財務報告公告前之封閉期間，提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間間交易股票；111年董事選舉已選任1位女性董事，提升董事多元化；制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站揭露其運作情形；訂定「風險管理政策」，以作為本公司風險管理之最高指導原則。本公司111年度就尚未改善者提出優先加強事項與措施：加強公司英文網站揭露公司治理相關之資訊。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會之職責：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	邢智田	熟稔半導體產業鏈之科技發展，具備公司治理、科技產業管理及危機處理能力與實務經驗。雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年)，但在經營管理上，能提供產業分析及科技應用洞察力，因此，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重為 36,000 股(0.02%)；未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事	呂正樂	具有法律、財務會計、公司治理及營運管理與實務經驗，目前是亞東聯合會計師事務所合夥會計師，且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年)，但在經營管理上，能提供公司治理及營運管理意見與方針，因此，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事	許瑞婷	具備會計及財務分析能力、公司治理、人力資源管理、經營管理與實務經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員會由3位獨立董事組成。

(2)第五屆委員任期：111年5月24日至114年5月23日，111年度薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	邢智田	3	0	100%	111.05.24 改選，連任
委員	呂正樂	3	0	100%	111.05.24 改選，連任
委員	郭泰豪	1	0	100%	111.05.24 改選，舊任
委員	許瑞婷	2	0	100%	111.05.24 改選，新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
111.01.25 第四屆第10次	1.本公司111年度董事及經理人薪資報酬辦法。 2.本公司經理人110年度年終獎金案。 3.本公司經理人111年度調薪案。 4.本公司經理人每季績效津貼案。 5.本公司經理人111年度每月職等及職位補助案。 6.本公司經理人每季業績獎金案。 7.本公司經理人退休案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
111.07.22 第五屆第1次	1.本公司經理人每季績效津貼案。 2.本公司110年度董事酬勞金額分配案。 3.本公司經理人110年度員工酬勞分配案。 4.本公司經理人每季業績獎金案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
111.10.28 第五屆第2次	1.本公司經理人每季績效津貼案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	1.本公司於107年成立「企業社會責任委員會」，110年更名為「ESG永續發展委員會」，由董事長指派總經理擔任主任委員，並設有6個工作小組：環境永續、公司治理、員工關懷、研發創新、產品責任及社會共融等，成員由相關部門組成，並指派中高階主管擔任小組負責人，統籌相關事務，包括訂定及檢討公司企業社會責任和永續發展政策、管理方針及具體推動計畫。 2.每年向董事會報告永續發展推動情形及未來策略目標(提報至111年7月25日董事會)，議案內容包括：(1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)因應氣候變遷，持續接軌全球永續標準與管理趨勢，推動TCFD架構系統化。 3.董事會聽取管理階層報告ESG重大議題執行進度，董事會針對管理階層報告內容提供策略的可行性，並且適時敦促管理階層進行調整。	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	1.本公司永續報告書揭露資料涵蓋111年1月1日至111年12月31日在主要據點之永續發展績效表現，範圍以臺灣新竹之營運總部為主。 2.本公司董事會於111年1月26日通過訂定「風險管理政策」，以作為本公司風險管理之最高指導原則。由各管理單位定期對風險事項予以評估及檢討，並向總經理報告評估結果，再由總經理彙整重大風險事項後，定期向董事會報告。 3.本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策(請參閱本年第34頁(註1))。	無差異。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	(一)本公司已取得ISO 14001: 2015 環境管理系統(Valid until 2024/11/23)，並通過第三方驗證機構認證，管理系統範圍涵蓋新竹總部。為落實環境管理訂定環境政策、無有害物質政策，並定期會同高階主管召開環境管理審查委員會，檢視執行情況。	(一)無差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	(二) 1.本公司致力提升各項資源之利用效率，以污染預防及持續改善為發展基本架構，研發節能減碳之綠色概念產品、改善製程技術降低環境衝擊、導入綠色供應鏈，落實環保教育，確實執行資源回收，珍惜水資源，維	(二)無差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否																
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	護美好地球。 2.執行措施包括LED照明燈具改裝、包裝材料減量化、包材循環再利用、空調監控系統提升，以利確實掌握能源使用狀況等。相關資訊請參閱永續報告書第四章環境永續。 (三) 1.本公司以ESG永續發展委員會為氣候變遷管理的最高組織，由總經理擔任主席，召集各功能小組負責永續發展政策、管理方針及具體推動計畫之執行。 2.本公司位居半導體產業供應鏈上游，依據TCFD公布之氣候相關財務揭露建議書架構，評估氣候變遷對公司現在及未來的潛在風險與機會，包括環境保護法規、議題；下一代技術開發；各種氣候變遷所產生的天然災害、水旱災、風災與環境因子產生重大不利影響；供應鏈中斷等外在環境和經營的風險等，都有可能對我們掌握中游貨源及下游客戶交期營運上造成影響。因此，我們將持續關注並採取相關因應措施。相關資訊請參閱永續報告書第四章環境永續。 (四) 1.本公司於111年啟動溫室氣體盤查規劃並成立推動小組，主要以新竹總部為主，以直接排放源(範疇一)及間接排放源(範疇二)作為分類： <table><tr><th>年度</th><th>110年</th><th>111年</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>35.02</td><td>87.58</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>1,344.31</td><td>1,435.05</td></tr><tr><td>CO2總排放量(公噸CO2e/年)</td><td>1,379.33</td><td>1,522.63</td></tr><tr><td>溫室氣體排放密集度 (公噸CO2e/百萬元)</td><td>0.21</td><td>0.25</td></tr></table> 註：溫室氣體排放密集度：資料範圍(範疇一+範疇二)/營收(百萬元)。 節能措施：制訂節能計劃依序變更為LED燈管，降低燈源發熱量。各樓層辦公室皆設置分區開關，達到節能目的。推行伺服器虛擬化，節省電力及相關設備。設定未來5年每年節省1%的電力為目標。 2.本公司主要為一般生活用水及空調用水，無製程用水。主要以新竹總部	年度	110年	111年	範疇一	35.02	87.58	範疇二	1,344.31	1,435.05	CO2總排放量(公噸CO2e/年)	1,379.33	1,522.63	溫室氣體排放密集度 (公噸CO2e/百萬元)	0.21	0.25	(三)無差異。
	年度	110年	111年															
範疇一	35.02	87.58																
範疇二	1,344.31	1,435.05																
CO2總排放量(公噸CO2e/年)	1,379.33	1,522.63																
溫室氣體排放密集度 (公噸CO2e/百萬元)	0.21	0.25																
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	(四)無差異。	(四)無差異。															

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否																						
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？		摘要說明 為主，用水來源為台灣自來水公司並與漢磊科技元件研新廠共用水號，依據用水項目之耗水量、員工人數進行分攤計算比例(110年~111年分攤比例為8.4%)。 110年~111年用水量統計 <table><tr><th>年度</th><th>110年</th><th>111年</th></tr><tr><td>總取水量</td><td>15,674</td><td>15,638</td></tr></table> 單位：度 省水措施：給水裝置全部加裝變頻器以穩定水壓。公共洗手間使用感應式水龍頭，有效減少不必要的水資源浪費。設計雨水不落地設施，集中雨水再使用至不與人體直接接觸之用水。 3.本公司廢棄物資料以新竹總部為主。 110年~111年事業廢棄物統計 <table><tr><th>年度</th><th>110年</th><th>111年</th></tr><tr><td>一般生活廢棄物</td><td>8.32</td><td>9.31</td></tr><tr><td>資源回收類</td><td>3.46</td><td>1.79</td></tr><tr><td>有害事業廢棄物</td><td>0.17</td><td>0.35</td></tr><tr><td>合計總重量</td><td>11.95</td><td>11.45</td></tr></table> 單位：公噸 減量措施：持續推動文件管理電子化系統。落實廢棄物分類與資源回收，委由專人負責廢棄物的分類與清除，如：空碳粉匣、鐵鋁玻璃罐與廢紙等。 相關資訊請參閱永續報告書第四章環境永續。	年度	110年	111年	總取水量	15,674	15,638	年度	110年	111年	一般生活廢棄物	8.32	9.31	資源回收類	3.46	1.79	有害事業廢棄物	0.17	0.35	合計總重量	11.95	11.45	(一)無差異。
	年度	110年	111年																					
總取水量	15,674	15,638																						
年度	110年	111年																						
一般生活廢棄物	8.32	9.31																						
資源回收類	3.46	1.79																						
有害事業廢棄物	0.17	0.35																						
合計總重量	11.95	11.45																						
	(一) 1.本公司支持並遵循責任商業聯盟行為準則(RBA)、聯合國世界人權宣言及聯合國全球盟約等國際公認之人權規範與原則，並恪守經營所在國家及地區之法規為基本要求，特別針對以下人權議題進行保障：禁止強迫勞動、禁用童工、禁止歧視、確保人道待遇及結社自由。相關資訊請參閱永續報告書5.5健康職場。 2.111年度舉辦人權保障相關教育訓練：計1607人次，合計2474時數。																							

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	(二) 1.本公司章程第24條規定：公司年度如有獲利，應提撥5%至15%為員工酬勞及不高於1.5%為董事酬勞。 2.本公司由人事單位依據人事薪資制度、績效評估辦法、獎懲辦法及員工守則，評估標準為工作能力(包括工作量/難易度/達成率/效率及品質/知識技能)、管理及溝通能力、未來貢獻度，並考量當季特殊表現，送交總經理室會議中予以評定。 3.本公司招募之各類職務固定薪資皆高於政府所訂定之最低工資標準，並依政府法令、業界實務及人才市場狀況，設計符合需求與標準的薪資制度，無性別、宗教、種族、國籍等差異。在各職務類別上，對兩性員工均採取相同的標準，落實性別平等。 各職務類別之男性與女性同仁比例如下： <table><tr><th>職務類別</th><th>男性</th><th>女性</th></tr><tr><td>一般員工</td><td>64%</td><td>36%</td></tr><tr><td>主管職務</td><td>76%</td><td>24%</td></tr></table> 4.本公司提供團體保險、優於勞基法之休假、定期免費健康檢查、設置員工餐廳並補助提供員工豐富餐飲服務、年終獎金、員工酬勞，與公司共享營運利潤。 5.本公司成立職工福利委員會，定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院、社團活動等皆有補助。 (三)本公司持續推動各項員工安全衛生業務的改善活動及相關訓練，創造優良的工作環境，保護員工身心健康與安全，相關說明請參閱本年第67頁。	職務類別	男性	女性	一般員工	64%	36%	主管職務	76%	24%	(二)無差異。
職務類別	男性	女性										
一般員工	64%	36%										
主管職務	76%	24%										
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三)無差異。									
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)無差異。									
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益	V		(五)無差異。									

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
政策及申訴程序？		退貨處理規範」等作業程序，並且在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決並處理客戶申訴問題。 2.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品符合規範，維護客戶的權益。 3.本公司產品遵循國際環保法規，符合歐盟ROHS與REACH的要求，並在產品包裝上有明確標示，以確保產品不含有傷害人體的有害物質。 4.本公司訂定「誠信經營守則」，由法務智權處負責制定與執行公司商業機密之作業程序，落實管理與執行。 (六)	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	1.本公司依據內部規章執行供應商評估及管理事項，要求供應商遵守本公司對於品質、環保與職業安全衛生的要求，除符合本公司之供應商管理政策才得以成為合格供應商外，持續對供應商要求遵循綠色環保法規，並推廣採取各種保護環境之政策。 2.本公司要求供應商進行自評，再依據自評結果執行對供應商稽核，並透過系統或到廠方式，不定期對供應商實施教育訓練、溝通與宣導，使其能夠達到本公司的要求。相關說明請參閱永續報告書第三章產品責任。	(六)無差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V	本公司依據全球永續性標準委員會所發行之GRI永續報告標準(GRI Standards)之核心選項(Core Option)，自發性編製永續報告書，並於本公司網站設置企業永續專區，定期揭露相關資訊，目前報告書尚未取得第三方驗證。	無差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已修訂「永續發展實務守則」，其運作情形皆遵循該守則規範無重大差異。		請敘明其運作與所定守則之差異情形：	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參閱本公司網站企業永續專區： https://www.holtek.com.tw/web/guest/responsibility/responsibility			

註1、本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
環境	環境衝擊及管理	1.本公司依據法規制定環境保護措施，由專責單位定期每季檢視國際環保趨勢，持續朝著加強環境管理系統、加強綠色產品開發、加強綠色供應鏈管理以確保產業的競爭力，並進行內部教育訓練與宣導，使員工了解到氣候變遷的衝擊影響。 2.本公司致力於環境保護，已取得ISO14001環境管理系統，後續並定期取得認證。 3.依據ISO 14064-1標準，定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，公司檢討碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。
社會	職業安全	1.本公司已取得ISO45001職業安全衛生管理系統，後續並定期取得認證。 2.每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。
	產品安全	1.本公司全系列產品皆符合RoHs、REACH、無鹵要求，提供客戶不使用危害物質的保證書。 2.為確保客戶服務品質，設立客戶服務網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強與客戶之間的合作關係。
公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
	強化董事職能	1.為董事規劃相關進修議題，及提供法令與公司治理相關資訊。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
	資訊安全	依據資訊安全作業需求，定期評估資訊安全政策的適當性與有效性，經由系統稽查、備份還原、異地備援、定期修改個人電腦開機密碼、緊急應變演練、教育訓練等，降低資訊安全風險並保護公司資訊資產。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司董事會於102年10月25日通過訂定「誠信經營守則」，本公司董事及經理人需盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討成效及持續改善，確保誠信經營政策之落實。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司訂定「誠信經營守則」，分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施，提升公司誠信經營之成效。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三)本公司依據「誠信經營守則」及「檢舉制度」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並透過內部稽核制度，建立嚴謹的防範制度，防止不誠信行為發生。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)本公司避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)本公司由資源管理中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由業務行銷中心、設計中心、產品中心及法務智權處等單位協助負責，且每年至少一次向董事會報告執行情形(提報至111年7月25日董事會)。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司訂定「誠信經營守則」及「檢舉制度」，制定防止利益衝突政策，並有適當陳述管道，若發現或接獲檢舉涉有不誠信或違法行為時，由專責人員處理。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委	V		(四)本公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，由內部稽核人員定期查核所有交易循環，確保公司遵循內部控制及相關法令規範，並向審計委員會及董事會報告稽核結果。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事、會計主管、稽核主管及公司治理主管之進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
董事	高國棟	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
董事	張 治	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
董事	蔡榮宗	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
董事	劉源河	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/07/07	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
		111/10/06	臺灣證券交易所	2022 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3
		111/10/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
董事	王仁宗	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
獨立董事	呂正樂	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
獨立董事	邢智田	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3
獨立董事	許瑞婷	111/06/22	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3
		111/07/20	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
		111/10/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		111/10/19	社團法人中華公司治理協會	第 18 屆(2022)公司治理高峰論壇-提升董事職能、落實公司永續治理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
會計主管	廖明通	111/08/22 ~ 111/08/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	李文德	111/03/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	互聯網科技發展趨勢與內稽人員新思維	6
稽核主管	李文德	111/04/19	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6
公司治理主管	廖明通	111/03/03	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		111/07/07	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
		111/10/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		111/10/19	社團法人中華公司治理協會	第18屆(2022)公司治理高峰論壇-提升董事職能、落實公司永續治理	3
		111/11/16	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

盛群半導體股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期： 一一二年二月十六日

本公司民國一一一年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一一年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一二年二月十六日董事會通過，出席董事八人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

盛群半導體股份有限公司

董事長：吳啟勇



總經理：高國棟



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.111 年度股東會之重要決議

股東會重要決議	執行情形
承認事項 1.通過本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案。 2.通過本公司民國 110 年度盈餘分派案。	1.決議通過。 2.決議通過每股配發現金股利 8.1229 元，訂定 111 年 8 月 15 日為除息基準日，於 111 年 8 月 30 日發放現金股利，發放金額為新台幣 1,837,141,672 元。
討論及選舉事項 1.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)案。 3.通過本公司董事競業禁止解除案。	1.決議通過，依規定申報至公開資訊觀測站。 2.第九屆董事當選名單：柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇、高國棟、張 治、蔡榮宗、劉源河、王仁宗、呂正樂(獨立董事)、邢智田(獨立董事)、許瑞婷(獨立董事)。第九屆董事選舉依規定向科技部新竹科學園區管理局辦理變更登記，並於 111 年 5 月 31 日取得核准函。 3.決議通過。

2.111 年度及截至年報刊印日止之董事會：

日期	重要決議
111.01.26 第八屆第 17 次	1.盛凌投資股份有限公司撤銷投資案。 2.本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司 110 年度合併財務報告及個體財務報告案。 4.本公司「風險管理政策」訂定案。 5.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
111.03.03 第八屆第 18 次	1.本公司 110 年度營業報告書案。 2.本公司 110 年度盈餘分派案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。 5.董事會提名及審議第九屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 6.討論解除董事競業禁止案。 7.本公司 111 年股東常會召開日期案。 8.本公司出具內部控制制度聲明書案。 9.因應安侯建業聯合會計師事務所職務調整會計師更換案。 10.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 11. MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。
111.04.25 第八屆第 19 次	1.本公司 111 年第一季合併財務報告案。 2. MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。 3. MCU Holdings Ltd.修正投資案。 4.本公司經理人請辭案。
111.05.24 第九屆第 1 次	1.選任本公司第九屆董事長案。 2.本公司第五屆薪資報酬委員會委任案。

日期	重要決議
111.07.25 第九屆第 2 次	1.本公司 111 年第二季合併財務報告案。 2.訂定本公司 110 年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。 3.本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。 4.本公司「公司治理守則」修訂案。 5.本公司「誠信經營守則」修訂案。 6.本公司「內線交易防制辦法」訂定案。 7.本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。 8.本公司經理人委任案。 9.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
111.10.31 第九屆第 3 次	1.本公司 111 年第三季合併財務報告案。 2.本公司擬購買董事及經理人責任保險案。 3.本公司向金融機構申請授信額度案。 4.倍創科技股份有限公司投資案。 5.MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。 6.本公司 112 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 7.本公司 112 年營運計畫書案。 8.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
112.02.16 第九屆第 4 次	1.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.本公司 111 年度合併財務報告及個體財務報告案。 3.本公司 111 年第四季無資金貸與他人公告之情事案。 4.本公司「內部控制制度」修訂案。 5.本公司出具內部控制制度聲明書案。 6.本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 7.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 8.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
112.03.08 第九屆第 5 次	1.本公司 111 年度營業報告書案。 2.本公司 111 年度盈餘分派案。 3.本公司「公司章程」修訂案。 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。 5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.本公司補選第九屆董事一席案。 7.董事會提名及審議補選第九屆董事一席候選人名單案。 8.討論解除董事競業禁止案。 9.本公司 112 年股東常會召開日期案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

五、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	呂倩慧	111/01/01~111/12/31	3,610	1,040	4,650	稅務服務
	鄭安志					

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	111 年 3 月 3 日		
更換原因及說明	本公司委任之會計師事務所因內部業務調整，自 111 年第 1 季起本公司簽證會計師由呂倩慧會計師及游萬淵會計師更改為呂倩慧會計師及鄭安志會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項(本準則第 10 條第 6 款第 1 目之 4 至第 1 目之 7 應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	呂倩慧會計師、鄭安志會計師
委 任 之 日 期	111 年 3 月 3 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	111 年度		當年度截至 112 年 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
法人董事	柏康投資(股)公司	—	—	—	—
董事長暨執行長	吳啟勇	—	—	—	—
董事暨總經理	高國棟	—	—	—	—
董事暨副總經理	張 治	—	—	—	—
董事	林正鋒 (註 1)	—	—	—	—
董事暨副總經理	蔡榮宗	(10,000)	—	(22,684)	—
董事暨副總經理	劉源河	—	—	—	—
董事	王仁宗	—	—	—	—
獨立董事	呂正樂	—	—	—	—
獨立董事	邢智田	—	—	—	—
獨立董事	郭泰豪 (註 1)	—	—	—	—
獨立董事	許瑞婷	—	—	—	—
副總經理	王明坤 (註 2)	—	—	—	—
協 理	吳紹菡	—	—	—	—
協 理	吳德傳	(125,000)	—	—	—
協 理	余國成	—	—	—	—
協 理	王鈺鈿 (註 3)	(393)	—	—	—
協 理	潘建州	11,000	—	—	—
會計及財務主管	廖明通	—	—	—	—

註 1：林正鋒及郭泰豪於 111 年 5 月 24 日卸任。

註 2：王明坤副總經理於 111 年 7 月 25 日就任。

註 3：王鈺鈿協理於 111 年 5 月 31 日解任。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

112 年 3 月 26 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰	22,144,257	9.79%	—	—	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
柏康投資(股)公司 代表人：章安華	6,578,502	2.91%	—	—	—	—	吳啟勇	配偶	
柏鼎投資(股)公司 代表人：章安華	4,597,841	2.03%	—	—	—	—	吳啟勇	配偶	
吳啟勇	3,932,905	1.74%	—	—	—	—	柏康投資(股)公司 代表人：章安華 柏鼎投資(股)公司 代表人：章安華	配偶	
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金	3,275,000	1.45%	—	—	—	—	無	無	
蘇秀貞	3,003,286	1.33%	—	—	—	—	無	無	
花旗(台灣)託管新加坡政府投資專戶	2,678,000	1.18%	—	—	—	—	無	無	
台北富邦商業銀行(股)公司代表人：陳聖德	2,309,000	1.02%	—	—	—	—	無	無	
財團法人國家文化藝術基金會代表人：林淇瀾	2,153,000	0.95%	—	—	—	—	無	無	

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

日期：111 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	22,053	100%	—	—	22,053	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
MCU Holdings Ltd.	500	100%	—	—	500	100%
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	6	0.10%	6,479	99.90%	6,485	100%
盛凌投資股份有限公司	42,983	100%	—	—	42,983	100%

註：係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

註 1：89 年 5 月 15 日台財證(一)第 36989 號函核准。

註 2：90 年 4 月 3 日台財證(一)第 116941 號函核准。

註 3：91 年 5 月 17 日台財證(一)第 126989 號函核准。

註 4：92 年 6 月 27 日台財證(一)第 0920128586 號函核准。

註 5：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 6：94 年 6 月 24 日金管證(一)第 0940125322 號函核准。

註 7：92 年 4 月 1 日台財證(一)第 0920110590 號函核准。

註 8：92 年 8 月 22 日台財證(一)第 0920138382 號函核准。

註 9：95 年 6 月 29 日金管證(一)第 0950127323 號函核准。

註 10：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 11：96 年 6 月 25 日金管證(一)第 0960031838 號函核准。

註 12：97 年 7 月 9 日金管證(一)第 0970034273 號函核准。

註 13：98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。

註 14：94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。

註 15：96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

112 年 3 月 26 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合計
人 數	3	10	217	35,759	174	36,163
持有股數	2,313,671	6,323,897	40,999,362	137,330,556	39,200,714	226,168,200
持股比率(%)	1.02%	2.80%	18.13%	60.72%	17.33%	100%

(三)股權分散情形

1.普通股

112年3月26日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率%
1 至 999	8,341	872,240	0.39
1,000 至 5,000	23,793	44,516,207	19.68
5,001 至 10,000	2,267	17,746,427	7.85
10,001 至 15,000	614	7,784,678	3.44
15,001 至 20,000	387	7,212,785	3.19
20,001 至 30,000	267	6,774,219	2.99
30,001 至 40,000	126	4,541,209	2.01
40,001 至 50,000	83	3,886,054	1.72
50,001 至 100,000	121	8,468,648	3.74
100,001 至 200,000	66	8,920,193	3.94
200,001 至 400,000	43	12,000,100	5.31
400,001 至 600,000	16	8,135,728	3.60
600,001 至 800,000	4	2,753,000	1.22
800,001 至 1,000,000	4	3,739,045	1.65
1,000,001 股以上	31	88,817,667	39.27
合 計	36,163	226,168,200	100.00

2.特別股：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

112年3月26日；單位：股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79%
高國棟		6,701,176	2.96%
柏康投資股份有限公司		6,578,502	2.91%
柏鼎投資股份有限公司		4,597,841	2.03%
吳啟勇		3,932,905	1.74%
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金		3,275,000	1.45%
蘇秀貞		3,003,286	1.33%
花旗(台灣)託管新加坡政府投資專戶		2,678,000	1.18%
台北富邦商業銀行股份有限公司		2,309,000	1.02%
財團法人國家文化藝術基金會		2,153,000	0.95%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

年 度		110 年	111 年	當年度截至 112 年 3 月 31 日
項 目				
每 股 市 價	最 高	151.50	126.50	77.80
	最 低	70.30	59.50	68.00
	平 均	102.94	87.01	73.65
每 股 淨 值	分配前	25.25	20.98	—
	分配後	17.12	註 5	—
每 股 盈 餘	加權平均股數(仟股)	226,168	226,168	226,168
	每股盈餘	9.04	4.89	—
每 股 股 利	現金股利	8.1229	註 5	—
	無 償 配 股	盈餘配股	—	—
		資本公積配股	—	—
	累積未付股利(註 1)		—	—
投 資 報 酬 分 析	本益比(註 2)	11.39	17.79	—
	本利比(註 3)	12.67	註 5	—
	現金股利殖利率(註 4)	7.89%	註 5	—

註 1：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 2：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 3：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 4：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 5：111 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞之發給對象得包括符合董事會所訂一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股

利合計數之百分之五十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 111 年度盈餘分配中，配發股東紅利新台幣 904,672,800 元全數以現金發放，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金股利新台幣 4.0 元。

(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司章程第 24 條：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞之發給對象得包括符合董事會所訂一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依上述公司章程規定比例提供員工及董事酬勞，帳列當期費用項下，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，於決議年度將差異金額帳列當期費用項下調整之。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 經董事會通過分派 111 年度員工及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣 160,429,812 元及董事酬勞新台幣 19,098,787 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

110 年度員工酬勞提列金額為新台幣 299,874,570 元、董事酬勞提列金額為新台幣 35,499,354 元，與本公司董事會擬議內容並無差異。

(九) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司為國內專業微控制器 IC 設計領導廠商，營業範圍主要包括微控制器 IC 及其週邊 IC 之設計、研發與銷售，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

年度 產品別	111 年度
微控制器 IC	81%
週邊 IC	19%
合 計	100%

3. 目前產品及服務項目

本公司自有開發重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式標準型及嵌入式 MCU、螢幕顯示 IC 產品、電源管理 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、通訊 IC 產品、射頻 IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、觸控開關 IC 產品、語音 IC 產品、健康量測產品、安防產品、馬達控制產品、車用產品、物聯網及金融相關產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性的特殊需求。

另外，本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類之市場需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品之應用範圍擴大到 4C+MG(Medical & Green)領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) 24 位元 Delta Sigma A/D 型 Flash MCU。
- (2) Touch Key Flash MCU，增強 MCU 抗干擾能力達到 CS 動態 10V Pass 要求。
- (3) 接近感應專用 MCU 及 1D/2D 數字接近傳感器微型模塊。
- (4) 連續監測血糖儀專用 MCU 及解決方案。
- (5) 溫/濕度量測專用 MCU 及數字傳感器模組方案。
- (6) 變送器 MCU 及解決方案。
- (7) 半橋電磁爐降低 EMC 干擾專用 MCU 及解決方案。
- (8) NFC 通信&取電專用 MCU 及解決方案。
- (9) PD 快速充電與識別專用 MCU 及解決方案。
- (10) 鋰電池充放電與太陽能電池管理及解決方案。
- (11) 動力型電池充電器專用 MCU 及解決方案。
- (12) 直流無刷馬達 BLDC 專用 MCU 及解決方案。

- (13) 安防及消防產品專用 MCU 及解決方案。(例：CO / GAS 偵測器、煙感火災報警器、消防餘壓探測器)。
- (14) 超低功耗標準型 8 位元 Flash MCU。
- (15) 超音波測距/倒車雷達專用 MCU。
- (16) Sub-1GHz RF OOK+FSK 無線發射 Flash MCU SoC 方案。
- (17) 藍牙廣播 Bluetooth Beacon 發射接收方案。
- (18) 2.4GHz RF 高速傳輸芯片及 SoC Flash MCU 方案。
- (19) 32 位元 Music STREAM 專用 MCU 及平台解決方案。
- (20) 32 位元語音辨識專用 MCU 及平台解決方案。
- (21) 32 位元 MCU 之物聯網應用開發平台及解決方案。
- (22) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及解決方案。
- (23) 32 位元 MCU 產品以 Arm® Cortex® -M0+、M3 及 M4 核心之 Flash 微控制器。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 全球半導體產業市場

雖然新冠肺炎(COVID-19)疫情日漸掌握，然因俄烏戰爭、各國升息、地緣政治風險升高、中國封控加上內需疲弱與匯率等政經問題堆疊，引爆通膨壓力快速拉升，衝擊終端消費市況，加劇全球經濟衰退的憂慮。下游消費性電子需求全面放緩，成品庫存去化緩慢，半導體供應鏈於 2022 年下半年營運已明顯降溫。

世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計，2022 年全球半導體市場全年總銷售值達 5,801 億美元，較 2021 年(5,559 億美元)成長僅 4.4%，預期明年半導體整體產值將從今年的歷史新高水位下降。WSTS 指出，美國半導體市場年增約 17%，是全球半導體市場成長動能最大的地區，亞洲市場則衰退 2%，成為全球半導體市場表現最差的區域。

隨著中美貿易戰升溫，2022 年 8 月美國拜登總統正式簽署《晶片與科學法案》，設下對中國大陸投資設限的附加條款，加上 Chip 4 四方晶片聯盟的設立，讓中國大陸晶片產業供應鏈安全受到威嚇，2022 年 10 月美國再次對中國大陸祭出新的 4 項出口管控等，藉以阻擋中國獲取高階晶片技術與發展半導體產業。另外，由於先進國家國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國皆提倡晶片製造在地化，將帶動全球供應鏈重組，全球強化供應鏈議題仍是至關重要。

(2) 臺灣半導體產業市場

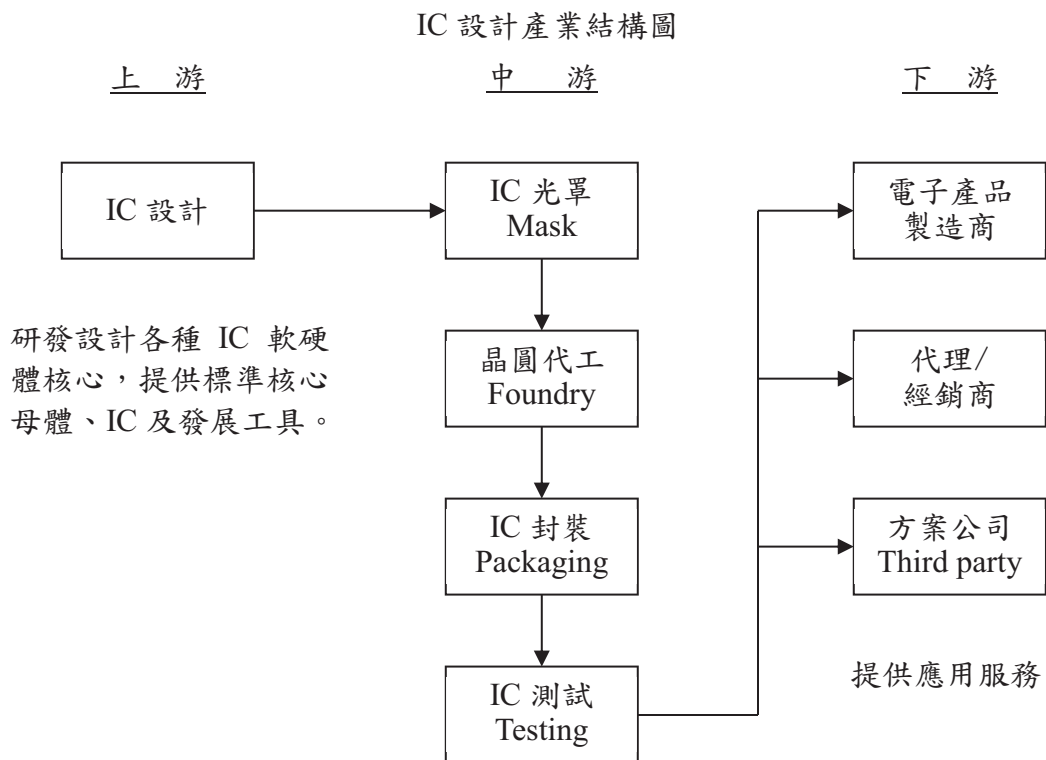
依據工研院產科國際所統計 2022 年臺灣 IC 產業產值達新台幣 47,204 億元，較 2021 年成長 15.6%。其中，IC 設計業產值為新台幣 12,370 億元，較 2021 年成長 1.8%；IC 製造業為新台幣 27,824 億元，較 2021 年成長 24.8%，其中，晶圓代工為新台幣 25,563 億元，較 2021 年成長 31.7%，記憶體與其他製造為新台幣 2,261 億元，較 2021 年衰退 21.5%；IC 封裝業為新台幣 4,795 億元，較 2021 年成長 10.1%；IC 測試業為新台幣 2,215 億元，較 2021 年成長 9.1%。台灣半導體產業的表現於 2022 年仍優於全球，但由於需求反轉與通膨、戰爭等因素影響，導致消費性終端需求的快速滑落，衝擊 2022 年下半年 IC 設計、IC 封測與記憶體產業營收成長，半導體產業已進入庫存

調整階段。展望 2023 年，由於外部環境因素尚未消除、消費市場買氣持續低迷、拉貨力道疲軟，供應鏈業者均庫存水位過高；庫存去化與記憶體產能過剩將延續至 2023 上半年，影響 2023 年臺灣半導體市場表現。

(3) 中國半導體產業市場

根據中國半導體行業協會統計，2022 年中國積體電路設計業銷售額為人民幣 5,345.7 億元，主因是中國龐大市場強而有力的支撐。依據中國半導體行業協會積體電路設計分會發布最新報告顯示，大陸 IC 設計企業已達 3,243 家，數量增加 15.4% (較去年增加 433 家)。中國半導體行業協會理事長魏少軍表示，雖然 2022 年中國大陸 IC 設計企業家數增速出現近年來首次下降，但產業仍處於高速增長階段，比 2021 年的銷售額人民幣 4,586.9 億元增長 16.5%。儘管受到美國晶片管制措施的影響，中國仍大力扶持晶片產業發展，預計在未來 5 年內推出其規模最大的財政激勵計劃之一，主要以補貼和稅收抵免的形式，以促進當地半導體生產和研究活動，以實現晶片自給自足。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、智能家電、工業設備、健康量測、BLDC 馬達控制產品、金融產品及物聯網產品等領域使用：

主要產品	用 途
微控制器(MCU)產品	1. Arm® Cortex® -M 為核心之系列 32 位元 Flash MCU。 2. HT8 為核心之系列 8 位元 Flash MCU。 3. BA 系列安防產品 MCU。 4. BC 系列射頻 MCU。

主要產品	用 途
	5. BD 系列 BLDC 馬達控制 MCU。 6. BH 系列健康量測 MCU。 7. BP 系列電源管理 MCU。 8. BS 系列觸控 MCU 與接近感應 MCU。
RF SoC 微控制器(MCU) 產品	1. 電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線遙控、無線門鈴及安全防盜等。 2. 低功耗藍牙及藍牙廣播健康量測產品、家電產品及智能設備偵測等應用。 3. Sub-1GHz、2.4GHz 無線加密通信產品、智能四錶、汽機車防盜遙控器及 IoT 等產品。
家電產品類	各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU 及各類家電觸控按鍵 MCU。
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge、PDF Data Logger 等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音 & 家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器、穿戴式產品顯示器及定電流 LED 顯示器等。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、感煙器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(刮鬍刀、鼻毛刀、潔面儀、電動剪髮器)及手電筒等 ASSP MCU。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、信用卡動態驗證碼(DCV)、NFC 儲值卡、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身分證等有掃描辨識需求之相關金融機具，例：點驗鈔機、清分機、ATM 機、EPD Flash MCU、Ultra-Low Power Flash MCU 及身分證鑑別儀等。
物聯網產品類	基於 Wi-Fi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 Flash MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。
安防產品類	感煙/感溫火災探測報警器、PM2.5 感測器、CO/GAS 探測報警器及 PIR/uWave 感測器、消防餘壓探測器等。
健康量測產品類	血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、紅外線測溫、溫濕度計、風速計、霧化器及接近感應器等。
BLDC 馬達產品類	電動工具、園林工具、空氣清淨機、吸塵器、吹風機、水泵、直流風扇、吊扇、散熱風扇、電動自行車及電動滑板車等。

4. 競爭情形

由於中國成立公司的門檻低，加上中國政府發布《國家積體電路產業發展推進綱要》和《十四五規劃》，為中國 IC 產業實現跨越式發展注入了強大動力，於此，中國小型或具創新力的設計公司能夠因此政策獲得支持，臺灣 IC 設計公司面對的同業競爭壓力將隨之升高。2022 年受到消費性終端需求下滑影響，中國 IC 設計公司也面臨砍單及庫存去化等問題，IC Insights 報告指出，全球半導體需求將在 2023 年出現週期性下滑，全年總銷量將減少 5%。

為了降低未來消費性市場帶來的營運衝擊，中國 MCU 企業意識到唯有提升晶片效能才是重要的質量市場。為滿足高性能運算應用的設計需求、各種電子產品需進

行智慧化升級及物聯網裝置擴充需求等因素，32 位元 MCU 符合此高性能低功耗之需求，將更快速地擴張至各應用領域。

本公司為提供客戶更具功能性之完整解決方案為產品發展目標，除持續發展目前各類產品外，基於半導體產業垂直分工之優勢，整合上下游相關資源，經由專業之積體電路設計、晶圓製造與封裝測試，提供客戶全方位之服務，進而大幅提昇其產業效能，在更具挑戰性的資訊時代，持續以穩健之腳步，邁向成長的高峰。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	111 年度
研發費用	1,136,791
營業收入	6,015,968
研發費用佔營業收入比率(%)	19%

2. 開發成功之技術或產品

本公司以每年約營業額的 15%~20%投入新產品與新技術研發，藉由新產品的持續導入來創造公司營業額的穩定成長與利潤的提升。

2022 年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下：

(1) 新一代 8 位元 MCU

- A. 1.8V ~ 5.5V 標準型 Flash 型系列：支援低工作電壓和工作電流，內建 ADC 及 LCD 功能，適用各式家電類、個人護理、消費性產品等。
- B. 內建多級運算放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器及自動感應水龍頭等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，Flash Touch MCU 系列可多次 ICP(In Circuit Programming) 燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 超低功耗標準型系列(TinyPower™ MCU)：本系列產品具備與國際大廠同等級之低耗電能力，符合環保潮流，適合於各種採用無源(Energy Harvesting)、一次性電池電源之可攜式產品。
- E. 健康量測產品：鎖定血壓、血糖儀、連續監測血糖儀、血氧、體溫、體重與體脂肪、保健與照護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與語音介面以及 BLE 通信，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。
- F. 完成伺服馬達(Servo Motor，或稱為舵機)專用 MCU 之開發，從控制方式可分成 PWM 舵機與 UART 舵機，皆已完成調參平台開發，用戶可使用該平台輕易達成舵機產品開發。在機器人之 UART 舵機的通訊協定也已開發完成，已

被智能機器人大廠評估。

- G. 無刷直流(Brushless DC, BLDC)馬達控制專用 MCU 及整合 Gate-driver/Driver 之 SoC MCU，導入方波無感測器驅動濾波器及 MDU，使無刷馬達運轉更穩定，鎖定園林工具、吸塵器、電動工具、冰箱除霜風扇、散熱風扇，皆達各產品所需之功能及效果並成功導入客戶量產。本系列也提供開發平台，加速客戶開發產品。
- H. 多路 RGB LED 彩燈 MCU 之開發：可恆流驅動 RGB LED，實現數百萬種 RGB 顏色變化，很適合應用在智能音箱、滑鼠墊、電競耳機、電競滑鼠等產品上，增加產品流光溢彩的絢麗效果。
- I. 安防產品：已經開發完成感煙探測報警器、CO/燃氣偵測報警器、PIR/微波感應專用 MCU，產品均整合多級運算放大器、雙通道 IR LED 驅動器、溫度傳感器、ADC、顯示驅動器等功能，可以大幅減少安防產品外部零器件的使用。感煙產品同時提供開發平台，加速客戶開發。

以上各系列 MCU 最低均達工業等級規格(寬溫運作範圍達到-40°C~+85°C)，抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛客戶的認可。

(2) Arm® Cortex® M series 32 位元 MCU

- A. Arm® Cortex®- M0+為核心寬工作電壓 2.5V~5.5V 之 Flash MCU。
- B. Arm® Cortex®- M3 為核心操作速度可達 72/96MHz 之 Flash MCU。
- C. Arm® Cortex®- M0+為核心操作速度可達 60MHz 之 Flash MCU。
- D. Arm® Cortex®- M4 為核心操作速度可達 240MHz 之 Flash MCU。整合 CAN Bus、USB 等多種介面。
- E. Arm® Cortex®- M0+為核心操作速度可達 60MHz 的 BLDC Motor Flash MCU。內置 Gate-driver/Driver，工作電壓 2.5V~5.5V，整合 OPA、CMP 及 2Msps 高速 ADC、與馬達專用 Timer，針對直流無刷馬達 FOC 控制做最佳化配置。同時推出不同電壓、不同功率的 SoC MCU，讓馬達模組最小化。已成功導入吊扇、吹風機、節能風扇、水泵、電動滑板車，適用多項家電及工業產品。

(3) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU：整合 16 位元 DAC，12 位元 ADC，等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與高精度 12-bit 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。
- C. 超聲波霧化器 Flash MCU：內建自動追頻、無水上電、缺水檢測等功能，能配合各種不同頻率之霧化片(100KHz、1.7MHz、2.4MHz 及 3MHz 等)，完整支援霧化器所需，有效降低客戶成本。
- D. 完成 2.0 代動力型充電器控制 Flash MCU：內建二組 OPA、DAC，經由軟體改變 DAC，MCU 透過 OPA 控制一次側 PWMIC，進行電池恆壓(CV)/恆流(CC)硬體控制，適用於 e-bike 或電動工具鉛酸/鋰電池充電器產品。

E. 電源管理暨驅動產品

- (A) 高耐壓/高精準度/低功耗/大電流驅動線性穩壓器：工作電壓高達 40V，超高 $\pm 1\%$ 精準度，低於 1 μ A 工作電流及最高達 500mA 相關線性穩壓產品，可廣泛使用於消防安全、工業控制、金融商品、車用電子等應用領域，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
 - (B) 低功耗/大電流驅動升壓型轉換器：超低 0.7V 工作電壓，最高達 3A 輸出電流，適用於乾電池及鋰電池相關應用產品，如電動刮鬍刀、健康醫療檢測、行動電源、無線聯網的水/電能/燃氣/熱能錶應用等，可延長電池壽命及提供系統穩定可靠電源。
 - (C) 高耐壓/大電流驅動降壓型轉換器：工作電壓高達 52V，最大 3A 輸出電流，可廣泛使用於智能電錶、電動機車、無線路由器等應用領域，提供系統穩定可靠電源。
 - (D) 低功耗/低成本交流-直流電壓轉換器：最大耐壓達 700V，精簡外圍線路提供具成本競爭力方案，廣泛使用於小家電領域產品，如電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲等。
 - (E) 直流馬達驅動 IC：可使用在水表、燃氣表、熱量錶的閥門控制以及電子門鎖等直流馬達驅動應用產品。達到馬達電壓最高 24V，驅動峰值電流最大 2.5A 能力，並提供完整 IC 自我保護功能。
 - (F) 多節鋰電池保護 MCU：應用於手持電動工具、吸塵器、噴水器等裝置，可提供低成本、高整合完整鋰電池保護方案。
- F. 高壓總線資料傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比 IP，提供解調變資料輸入及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，以提高產品的便利性及完整性。

(4) 電腦週邊產品

- A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
- B. USB Bridge 系列 IC。
- C. 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)系列。
- D. USB 2.0 Low Speed MCU 系列。
- E. PDF Data Logger MCU。
- F. 電競鍵盤及滑鼠 RGB LED ASSP Flash MCU。

(5) 無線產品

- A. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
- B. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 超外差收發電路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。
- C. 2.4GHz 無線 MCU：整合 2.4G RF 電路之 Flash MCU，適用於具備抗干擾能力、雙向傳輸等應用。

- D. 低功耗藍牙(BLE) MCU: 整合高性能的射頻、調製解調器及 32 位元 M0+Flash MCU, 並內建 DC/DC 及 LDO, 支援寬廣範圍的單電源供電, 適用於低功耗的健康醫療產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。
- E. NFC Tag Flash MCU & NFC Reader controller。
- F. 可支持最高至 5Mbit 的 CAN 2.0 及 CAN FD Controller 週邊 IC: 可應用到一般車用及工業產品。

(四)長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司經營團隊擁有約 40 年豐富的 IC 設計產業經驗, 熟知客戶及市場需求, 並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援, 同時在臺灣/中國/美國/印度建立當地銷售及技術服務據點。因此, 本公司擁有高產品競爭力在於提供客戶:

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

(2)生產策略

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係, 以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊, 以便即時掌控生產的進度及數量, 達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主, 加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上, 提供客戶多元化的組合選擇。滿足採購選擇便利性以及優異的性能與價格比, 讓客戶產品具有強大市場競爭力。
- B. 以策略性產品作為市場發展主軸, 與客戶密切互動, 導入利基型產品, 提供差異化服務。
- C. 以整體系統成本角度出發, 推出高度集成專用 ASSP MCU, 協助客戶降低整體產品成本, 以達雙贏目的。
- D. 推出數字傳感器及各樣模塊, 縮短客戶開發、調試時程及產品穩定度。

(4)研發策略

本公司以終端產品需求為導向, 將 MCU 核心架構於不同製程平台, 搭配特殊 IP 及重要關鍵技術, 達到小型化 SoC, 和晶圓廠及封裝廠密切配合產品開發 SoC 及 SiP 整合搭配, 在整合過程強化抗雜訊能力與靜電防護能力, 達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準, 已進行 105°C 高溫 AEC-Q100 認證, 並朝車用電子規範產品延伸, 另外針對較特定應用之產品, 或直接進行功能的改良,

提高產品良率，導入更多潛在市場。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略鎖定以智慧家電、健康量測、PC 相關周邊、安防、馬達控制與金融相關領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質及快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功地將 HOLTEK 微控制器順利導入全球著名大廠，建立起 HOLTEK 全球化的專業品牌形象。公司在 8 位元 MCU 已獲得大廠的認同並導入量產，並另積極布局 32 位元 MCU 以擴大全球市佔率，2022 年盛群 32 位元 MCU 出貨量約 2,900 萬顆，年減 31%，主係受到消費性電子產品需求下滑影響，未來 32 位元 MCU 應用範圍涵蓋的功能面將會更廣泛，並在各種不同的領域，搭配不同的專業合作方案夥伴，擴展生態系統，透過引入創新的設計方案，加速開發該應用之終端客戶所需產品。

(2)生產策略

- A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。
- B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢，提升良率及市場競爭力。

(3)產品策略

- A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。
- B. 切入更高階或高附加價值之應用領域，如高階大小家電、工業設備、安全防護、車用電子及物聯網等設備領域。
- C. 推出各類專業產品模塊(Module): 如 RF 2.4GHz/Sub1GHz/藍牙/NFC 射頻模塊、環境感測模塊、指紋辨識、接近感測、微型 PIR 感測、重量感測、觸摸感測、超聲波模塊…，降低專業產品開發門檻、研發投入，加速產品開發週期及量產測試，讓終端產品附加各類功能，維護產品穩定性。

(4)研發策略

提升產品設計能力，並因應市場應用需求，建立規格化與模組化之開發技術，自主研發各種開發平台，外部結盟專業廠商，提高產品的良率及可靠度，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市時間，以提高產品價值、產品競爭力。

(5)產品發展項目

- A. 開發 32 位元 Arm®核心 MCU 標準系列，搭配周邊包括 LCD 驅動、USB/UART /SPI/I²C/I2S 通訊介面、PWM 驅動、CMOS 感測器、高速高精度 A/D 和 D/A 轉換器、比較器、運算放大器等功能。
- B. 開發 32 位 Arm®核心 MCU 專用範圍，用於圖像識別、電機控制、指紋識別、健康測量、音樂合成。整合 CORDIC、AES 加解密功能、CRC 運算功能、24 位元高解析度 Delta-Sigma A/D 轉換器、多通道音樂合成器等周邊，適合多種應用領域如：物聯網終端裝置、指紋辨識、BLDC 高階控制、可穿戴設備、多媒體產品及無線應用、語音辨識、音樂合成器等領域。
- C. 強化低電壓、低功耗、高精度系列標準的 8 位元 Flash MCU，包括 A/D 和 D/A 轉換器、LCD 和 LED 驅動程式、24 位元高解析度 Delta-Sigma A/D 轉換器等應用。

- D. 增加 8 位 Flash 專用 MCU 的範圍，用於健康測量、個人護理、電機驅動、觸控開關、安防產品、物聯網產品、有線和無線充電器產品、家用電器、電腦週邊設備、超聲波應用等領域。
- E. 開發低功耗藍牙(BLE)、2.4GHz RF 雙向傳輸、Sub-1GHz RF SoC MCU、加密編解碼等無線設備。
- F. 擴大電源管理設備的範圍，包括低待機功耗 DC-DC 轉換器、高效率 AC-DC 轉換器、TWS 充電盒方案等。
- G. 開發低中高壓 3 相馬達門驅動器(Gate Driver)、驅動器(Driver) IC；鋰電池包管理 IC(BMS)、充電器 IC；BLDC 無刷馬達 MCU 等電動工具、風扇、電動自行車、滑板車等應用。
- H. 數字傳感器及模組專用 MCU 整合 AFE 電路，結合各類傳感器應用，開發 Smart Sensor 產品，拓展產品應用領域。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司銷售地區分佈如下表所示

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	110 年度		111 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
臺灣地區	771,966	11	739,501	12
中國地區	5,593,338	78	4,044,393	67
其他海外地區	762,446	11	1,232,074	21
合計	7,127,750	100	6,015,968	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、顯示驅動 IC、電源管理 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。

根據 IC Insights 預測，2022 年 MCU 營收約 215 億美元，依本公司 2022 年度 MCU 總銷貨金額為新台幣 48.42 億元，約 1.58 億美金(新台幣對美元匯率以 30.62 計算)，於 MCU 市場的營收占有率約 0.73%，主係受到消費性電子產品需求下滑影響另外，2022 年本公司 MCU 總出貨量 6.32 億顆，相對 2021 年減少 28%，預估 2023 年，隨著應用面廣度的拓展，將推升 MCU 需求面，持續提升既有的市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1)供需狀況

由於 MCU 的易用性、即時運行和低功耗特性，可為智慧、安全且不斷發展的 IoT 市場提供最高性能且經濟高效的嵌入式解決方案。由於 2022 上半年整體半導

體市場因新型冠狀病毒(COVID-19)因素造成個人電腦、電競相關及小家電等宅經濟市場升溫，加上防疫需求爆發的耳/額溫槍及血氧儀等，然因俄烏戰爭、各國升息、地緣政治風險升高、中國內需疲弱與匯率等政經問題堆疊，引爆通膨壓力快速拉升，衝擊終端消費市況，加劇全球經濟衰退的憂慮。

2023 年晶圓產能供給則無虞但價格並未如預期降低，公司將以庫存去化為優先，同時持續執行重點產品的開發，內部積極降低相關費用支出並加強開拓海外地區市場，提供全球客戶全方位的服務。

(2)未來成長性

根據 IC Insights 研究報告，2022 年全球 MCU 的市場銷售額將成長 10%，市場規模可望達到 215 億美元，再創歷史新高。未來五年，32 位元 MCU 的銷售額預計將以 9.4%的複合年成長率成長，到 2026 年將達到 285 億美元。

為因應物聯網之需求，本公司以 MCU、RF 及 Sensor 集成，透過 NFC(近距離無線通訊)、低功耗藍牙(BLE)模組以及 Sub-1GHz 等無線通訊模組，未來 IoT(物聯網)導入 AI(人工智慧)，面對所謂「AIoT」時代來臨，全球 MCU 廠商更是需要高階技術才能迎接如此龐大的市場挑戰，以迎向更多元之市場需求。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1)研發能力強，產品領先群倫

長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發更新更有競爭力的 IC。

(2)更新輔助設計器材與測試設備

藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。

(3)完整的全球行銷網路

擁有臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、青島、北京、成都、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(4)上游工廠關係穩固

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。

(5)管理制度良好：

本公司取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目前掌握之競爭優勢如下：

A. 領先且完整的產品系列

- (A) 由於自有 IP 日益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加 IC 功能與客戶產品的競爭力，提高對手競爭障礙。
- (B) 產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險。
- (C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。

B. 全球行銷網的建立

- (A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等。
- (B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。
- (C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。
- (D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。
- (E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。
- (F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

C. 產品開發能力

- (A) 多年經驗累積之優良研發技術。
- (B) 強大的研發團隊。
- (C) 藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，加速產品及技術升級。
- (D) 發展產品多元化，減少景氣波動度影響。

D. 整體環境支援

- (A) 產業支援集中，可增強經營效益。
- (B) 產業專業分工，可增高合作及依存性。
- (C) 產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。

(2) 不利因素及因應之道

- A. 國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，必須提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢。
- B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速

的服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。

- C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機。
- D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。
- E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，必須持續增加智財權實力，努力提升產品之主導性。
- F. 面臨大陸設計業的蓬勃發展，加上蓄意對智財權的忽視，臺灣 IC 設計同業均已受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。
- G. IC 設計人才普遍缺乏，且培訓時間較長，加上市場產品汰換迅速，經由與大專院校合作延攬優秀人才，定期舉辦教育訓練培訓研發人才，提供良好的工作環境及晉升管道，維持低人才流動率。
- H. 部份客戶對臺灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司選擇合適之客戶進行長期合作，達到量產階段，以提升本公司在此產業之知名度。另外，產品組合不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。

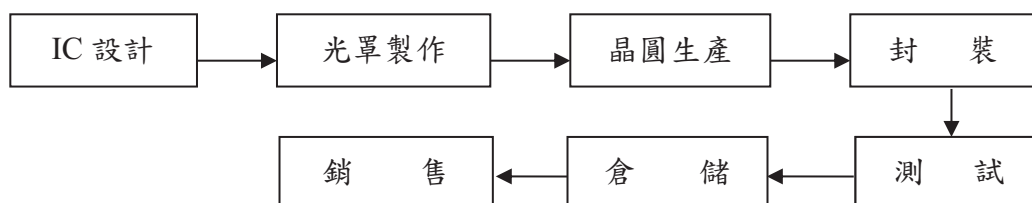
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、健康護理產品、汽機車、工業儀錶控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 LED。
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
記憶體產品	使用於電腦、通訊、消費電子、教育娛樂產品及智慧型金融卡等。

2. 產品產製過程

(1)本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2)晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3)封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰、日月光等，確保封裝產能無虞。

(4)測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5)倉儲作業

A. 主要儲存物品：

(A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。

(B) 測試狀態分為：已測/未測。

(C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

(A) 自動倉儲作業。

(B) 儲存物品之品質維護。

(C) 貨物進出的管理與正確性。

(D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三)主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏等半導體廠建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四)最近二年度任一年度中占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	110 年度				111 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	1,304,969	36	無	A	1,585,248	41	無
2	B	768,308	21	無	B	538,567	14	無
3	C	437,112	12	無	D	505,755	13	無
4	D	301,259	8	無	C	342,473	9	無
	其他	790,024	23	無	其他	895,988	23	無
	進貨淨額	3,601,672	100		進貨淨額	3,868,031	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2.最近二年度銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	110 年度				111 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	欣宏	1,229,732	17	(註 2)	欣宏	1,156,587	19	(註 2)
	其他	5,898,018	83		其他	4,859,381	81	
	銷貨淨額	7,127,750	100		銷貨淨額	6,015,968	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：本公司子公司採權益法評價之被投資公司。

(五) 最近二年度生產量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

生產量值 主要商品	110 年度			111 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
微控制器 IC	--	942,180	2,934,996	--	665,284	2,585,838
週邊 IC	--	485,704	669,361	--	238,428	487,786
開發工具及設計收入等其它	--	929	7,195	--	429	6,088
總 計	--	1,428,813	3,611,552	--	904,141	3,079,712

註：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自有產能限制，生產量的多寡係依據當年度之銷售預估。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

銷售量值 主要商品	110 年度				111 年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
微控制器 IC	63,306	564,264	813,424	5,072,325	56,149	567,101	575,698	4,275,880
週邊 IC	43,173	192,622	407,846	1,233,993	27,239	157,448	191,989	970,805
開發工具及設計收入等其它	35	15,080	870	49,466	55	14,952	432	29,782
總 計	106,514	771,966	1,222,140	6,355,784	83,443	739,501	768,119	5,276,467

三、從業員工：最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		110 年底	111 年底	當年度截至 112 年 3 月 31 日
員工 人數	工 程 人 員	674	704	697
	管 理 人 員	159	158	155
	生產測試人員	47	40	39
	合 計	880	902	891
平 均 年 歲		36.12	36.04	36.27
平均服務年資		7.60 年	8.25 年	8.46 年
學歷 分布 比率	博 士	0.4%	0.4%	0.4%
	碩 士	28.9%	28.0%	28.2%
	大 專	64.9%	66.6%	66.6%
	高中(含以下)	5.8%	5.0%	4.8%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施、如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

(1)公司福利

本公司設有餐廳、員工休閒活動區、運動健身器材區、韻律教室、醫務休息室等設施，並舉辦團體保險、定期員工健康檢查等活動，且設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(2)職工福利

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院等皆有補助。為促進各種康樂社團，以增進員工團結及情誼，成立各類型之社團活動，並提供社團經費補助，例：桌球社、羽球社、瑜珈社、桌遊社、游泳社、太極拳社等，鼓勵同仁利用工作之餘也能平衡生活，藉以養成運動風氣、提高生活樂趣。

2.進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政管理處及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1)職前訓練(新人訓練)

A.公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解本公司企業文化及經營理念、人事規章、智慧財產權、品質政策、環保政策、工業安全與衛生及消防安全等實施之訓練。

B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2)在職訓練

A.部門自辦訓練：各部門針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。

B.公司內部訓練：內部設有教育訓練委員會依據各部門專業需求，聘請專業講師至公司進行長期的專業訓練課程，包括專業技術培訓課程、管理技能培訓課程、品質培訓課程、安全衛生培訓課程、法務智權培訓課程、電腦培訓及工作與生活等多元而充實的訓練課程。

C.線上學習課程：建立教育訓練平台，整合所有課程訊息、訓練系統及資料查詢，發展 e-learning 及知識管理系統，建立網路教學滿意度調查機制。

D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。

E.111 年員工內、外教育訓練實際執行情形：

	總時數	總人數
一般管理	1,986	1,647
專業技術	1,861	655
新人訓練	624	39

(3)在職進修

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4)自我發展

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3.退休制度與其實施情形

(1)退休金提繳

A.本公司訂有退休辦法並設置退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之 15%提撥勞退舊制退休準備金，並以專戶存於臺灣銀行。

B.本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6%之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

(2)實施情形

本公司勞資雙方依法組織「退休準備金監督委員會」，每季定期由勞資雙方召開勞工退休準備金監督委員會議，負責管理監督及審核退休準備金之提撥、存儲、支用等事宜。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司每季定期召開勞資會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障

員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

5. 員工行為與倫理守則

本公司訂定「道德行為準則」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範全體同仁對於經管或監督之業務，不得利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，定期對全體新進人員作宣導。

6. 工作環境與員工安全保護措施

本公司 95 年取得國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統認證，並於 108 年完成 ISO 45001：2018 轉版認證(Valid until 2024/11/26)，管理系統範圍涵蓋新竹總部。

為落實職業安全衛生管理訂定安全衛生政策，並定期會同高階主管召開職業安全衛生管理審查委員會及每季召開職業安全衛生委員會(簡稱安委會)，檢視、追蹤執行情況、持續改善活動，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全。

(1) 教育訓練

每年擬定「環境與安全衛生教育訓練計畫」及「勞工健康服務計畫」經安委會同意後實施，涵蓋一般安全衛生、化學品危害通識、專業證照、健康講座、員工衛生教育等。111 年度參加教育訓練逾 1200 人次，總時數逾 1381.50 時數。

(2) 健康管理

依據職安法推動「勞工健康服務計畫」、「人因性危害預防計畫書」、「母性健康保護計畫」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫」等，設有護理人員進行健康管理及服務，定期請專業醫生至本公司進行健康評估及舉辦健康講座，每年度亦委託醫療機構進行各項身體健康檢查，注重員工身心健康。

(3) 職業災害

111 年度無工作場所之職業災害發生(包括員工與承攬商)，亦無經職業醫學科專科醫師判定確診職業病者。針對員工零星發生之交通事故，依據發生原因進行檢討，並加強全體員工安全意識提升，如「公司內外交通安全注意事項」、「雨天行車安全守則」之宣導等。

(4) 環境安全衛生管理

- A. 除大樓之保全人員 24 小時守衛外，各出入口及角落地區設有監視攝影器，並加強夜間、假日保安全管理，以保障員工人身安全。
- B. 定期委請廠商進行保養及維修消防設備(例：消防警報器、滅火器)，並責請專人定期檢視後做成記錄。
- C. 為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季抽樣檢測飲水機之大腸桿菌群、飲水機廠商定期維護保養。
- D. 定期實施辦公室清潔與消毒作業，並於坐式廁所提供 75%酒精，以確保工作環境衛生。
- E. 因應 COVID-19 疫情帶來的健康危機，成立『防疫指揮小組』視疫情發展隨時滾動式調整防疫措施，確保公司同仁健康並落實各項防疫政策的執行及執行相關防疫行動方案。

- (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無重大影響。

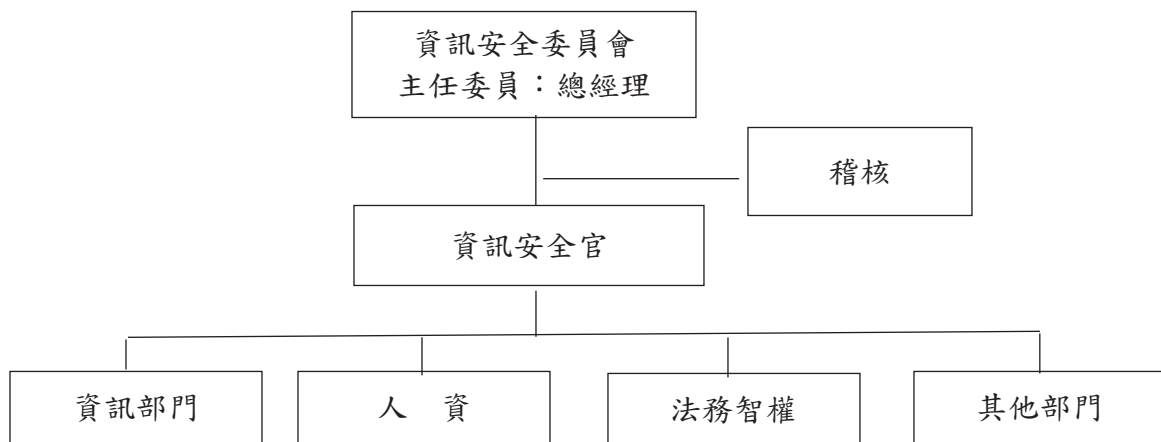
六、資通安全管理

- (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1.資通安全風險管理架構

本公司成立資訊安全委員會，由總經理擔任主任委員，並由稽核、資訊部門、人資、法務智權及相關部門組成，負責建置與推動資訊安全政策的建立、執行及持續改善，確保公司智慧財產、營業祕密及內部資訊安全，每年定期召開資訊安全委員會議，並由總經理每年定期向董事會報告資訊安全執行的成效。

資訊安全委員會組織圖如下：



2.資訊安全政策

公司的資安相關資產分為五大類：設備(Devices)、應用程式(Application)、網路(Network)，資料(Data)與人員(User)，針對這五大類來規劃資訊安全策略。

- (1)設備(Devices)：控管公司端點的硬體，許可的裝置才能接入網路，以降低不明裝置所引發的風險；作業系統即時更新，以阻擋漏洞攻擊；作業系統安裝防毒軟體，阻絕病毒與惡意程式；監控端點安裝的軟體，以便做軟體盤點。
- (2)應用程式(Application)：採用多因子驗證，以確保身分識別(Identify)；引進 Web Application Firewall(網站應用程式防火牆)，以有效阻擋針對應用程式的攻擊；建立叢集架構(Cluster)以確保應用程式的服務。
- (3)網路(Network)：遠端連線，採用多因子認證以確保身分識別(Identify)；引進新世代防火牆，依應用程式來進行管理；入侵偵測系統以及早發現攻擊；採用進階威脅偵測、防護技術，以防止未知威脅。
- (4)資料(Data)：機密資料，進行加密，以防止資料外洩；資料存放在專門的儲存設備，以免資料因硬體故障流失；專業備份軟體與設備，每天進行資料備份，並同時備份一份至遠端。
- (5)人員(User)：分為一般員工與資訊人員

A.一般員工：新人教育訓練，以提高資訊安全意識，提升整體的防禦能力；不定期進行社交工程演練，以加強資訊安全意識，並找出資安意識較弱的同仁，以進一步的教育訓練。

B.資訊人員：參加資訊安全教育訓練、資訊安全大會以提升資訊安全能力；引進特權帳號管理系統，以降低風險。

資訊安全策略的執行：

採用規劃—執行—檢查—行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）模型，並整合風險管理週期來進行。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1)資安風險與因應措施

資安控制項	風險說明	對應措施	預期效益
設備/端點硬體	不明設備接入網路，引發資安漏洞	許可的裝置才能接入公司網路	強化端點安全
設備/端點軟體	作業系統未及時更新，導致資安漏洞未修補	派送更新與監控更新狀態	強化端點安全性
應用程式/認證	應用程式密碼可能洩漏或被破解	採用多因子認證	降低系統被他人登入的機會
網路/認證	網域密碼可能洩漏或被破解	採用多因子認證	降低系統被他人登入的機會
網路/控制連線	不必要的連線服務，導致伺服器受攻擊	採用新世代防火牆控管連線	確保僅提供必要連線服務
資料/機密資料	資料洩漏的可能	採用加密管理系統，限制特定使用者只能在公司內部存取機密資料	只能在公司內讀取機密資料
資料/漏失	因儲存設備故障導致資料流失	本地備份與異地備份	如有資料流失，可從備份系統還原
人員/一般員工	缺乏資安意識，成為破口	加強內部員工教育訓練	提高資安意識，員工成為最佳防線
人員/資訊人員	無法掌握最新資安技術	參加資安大會；參加外部教育訓練	掌握最新資安情報與技術

(2)資訊安全教育訓練

A.資訊安全認知宣導：定期對員工進行資訊安全相關訊息公告，以提高員工資訊安全意識。

B.資訊安全教育訓練：每位新進人員到職時接受資安相關教育訓練，以瞭解公司資訊安全政策與要求；每年指派專責人員參加 SSCP 資安專業人員認證課程；111 年計 41 人次、合計 320 時數。

(3)資訊安全稽核機制

稽核室定期查核資訊安全管理實務之落實情形，並依查核結果採取改善措施，以確保資安管理持續且有效的運作；會計師定期進行資訊作業查核，若發現缺失，將要求改善並追蹤改善結果。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學園區管理局	110/01/01~129/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術授權	Arm Limited	96/06/25~永久	Arm® Cortex®-M3 技術授權	不得違反相關法令規定
技術授權	Arm Limited	102/09/24~永久	Arm® Cortex®-M0+技術授權	不得違反相關法令規定
技術授權	晶心科技	104/04/01~114/05/21	Andestech D10 CPU Softcore 技術授權	不得違反相關法令規定
技術授權	Arm Limited	107/12/28~永久	Arm® Cortex®-M4 with FPU 及 system IP products Corstone-101 技術授權	不得違反相關法令規定
供應契約	某晶圓廠	本公司負保密義務	晶圓產品之供應	保密條款

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 國際財務報導準則-合併資訊

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
流 動 資 產		4,322,111	3,984,290	4,478,921	6,438,279	5,208,350
不 動 產、廠 房 及 設 備		398,515	358,515	343,343	343,793	326,243
使 用 權 資 產		—	92,073	100,047	108,902	85,802
無 形 資 產		35,153	66,751	62,501	39,211	23,498
其 他 資 產		799,721	872,039	1,202,512	1,613,648	1,176,103
資 產 總 額		5,555,500	5,373,668	6,187,324	8,543,833	6,819,996
流 動 負 債	分 配 前	1,079,483	932,568	1,248,920	2,239,032	1,509,818
	分 配 後	2,142,474	1,848,549	2,280,247	4,076,173	(註 2)
非 流 動 負 債		251,918	361,677	456,001	594,553	565,537
負 債 總 額	分 配 前	1,331,401	1,294,245	1,704,921	2,833,585	2,075,355
	分 配 後	2,394,392	2,210,226	2,736,248	4,670,726	(註 2)
歸屬於母公司業主之 權 益		4,199,170	4,052,665	4,441,796	5,656,852	4,678,997
股 本		2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資 本 公 積		142,309	142,309	142,309	142,309	142,309
保 留 盈 餘	分 配 前	1,832,565	1,680,336	1,785,003	2,794,950	2,072,434
	分 配 後	769,574	764,355	753,676	957,809	(註 2)
其 他 權 益		(37,386)	(31,662)	252,802	457,911	202,572
庫 藏 股 票		—	—	—	—	—
非 控 制 權 益		24,929	26,758	40,607	53,396	65,644
權 益 總 額	分 配 前	4,224,099	4,079,423	4,482,403	5,710,248	4,744,641
	分 配 後	3,161,108	3,163,442	3,451,076	3,873,107	(註 2)

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
營 業 收 入	4,862,807	4,584,105	5,614,539	7,127,750	6,015,968
營 業 毛 利	2,406,974	2,235,715	2,626,935	3,815,846	3,086,195
營 業 損 益	1,110,730	986,738	1,124,132	1,774,341	1,231,897
營 業 外 收 入 及 支 出	134,859	81,078	137,276	816,808	159,063
稅 前 淨 利	1,245,589	1,067,816	1,261,408	2,591,149	1,390,960
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	1,070,366	922,313	1,048,117	2,069,002	1,132,307
停 業 單 位 損 失	—	—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)	1,070,366	922,313	1,048,117	2,069,002	1,132,307
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(76,197)	1,233	274,378	202,440	(246,624)
本 期 綜 合 損 益 總 額	994,169	923,546	1,322,495	2,271,442	885,683
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	1,063,990	914,902	1,031,063	2,044,064	1,106,374
淨利歸屬於非控制權益	6,376	7,411	17,054	24,938	25,933
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	987,931	916,486	1,305,112	2,246,383	859,286
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	6,238	7,060	17,383	25,059	26,397
每 股 盈 餘	4.70	4.05	4.56	9.04	4.89

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

(二)國際財務報導準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
流 動 資 產		3,546,143	3,077,656	3,279,472	4,837,370	3,238,720
不 動 產、廠 房 及 設 備		151,248	135,756	126,132	136,830	127,558
使 用 權 資 產		—	78,084	84,442	94,399	79,295
無 形 資 產		34,376	66,727	61,701	38,630	22,384
其 他 資 產		1,715,068	1,858,693	2,464,593	3,147,626	3,158,604
資 產 總 額		5,446,835	5,216,916	6,016,340	8,254,855	6,626,561
流 動 負 債	分 配 前	1,002,792	813,085	1,133,068	2,015,984	1,397,529
	分 配 後	2,065,783	1,729,066	2,164,395	3,853,125	(註 2)
非 流 動 負 債		244,873	351,166	441,476	582,019	550,035
負 債 總 額	分 配 前	1,247,665	1,164,251	1,574,544	2,598,003	1,947,564
	分 配 後	2,310,656	2,080,232	2,605,871	4,435,144	(註 2)
歸屬於母公司業主之 權 益		4,199,170	4,052,665	4,441,796	5,656,852	4,678,997
股 本		2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資 本 公 積		142,309	142,309	142,309	142,309	142,309
保 留 盈 餘	分 配 前	1,832,565	1,680,336	1,785,003	2,794,950	2,072,434
	分 配 後	769,574	764,355	753,676	957,809	(註 2)
其 他 權 益		(37,386)	(31,662)	252,802	457,911	202,572
庫 藏 股 票		—	—	—	—	—
非 控 制 權 益		—	—	—	—	—
權 益 總 額	分 配 前	4,199,170	4,052,665	4,441,796	5,656,852	4,678,997
	分 配 後	3,136,179	3,136,684	3,410,469	3,819,711	(註 2)

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
營 業 收 入	4,358,758	4,052,932	4,606,133	6,631,977	4,891,641
營 業 毛 利	2,084,309	1,851,161	1,983,698	3,457,625	2,129,674
營 業 損 益	1,051,333	852,499	809,885	1,413,402	1,121,239
營 業 外 收 入 及 支 出	181,577	194,313	384,350	1,109,761	227,135
稅 前 淨 利	1,232,910	1,046,812	1,194,235	2,523,163	1,348,374
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	1,063,990	914,902	1,031,063	2,044,064	1,106,374
停 業 單 位 損 失	—	—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)	1,063,990	914,902	1,031,063	2,044,064	1,106,374
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(76,059)	1,584	274,049	202,319	(247,088)
本 期 綜 合 損 益 總 額	987,931	916,486	1,305,112	2,246,383	859,286
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	1,063,990	914,902	1,031,063	2,044,064	1,106,374
淨利歸屬於非控制權益	—	—	—	—	—
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	987,931	916,486	1,305,112	2,246,383	859,286
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	—	—	—	—	—
每 股 盈 餘	4.70	4.05	4.56	9.04	4.89

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
107	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
108	游萬淵、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
109	游萬淵、呂倩慧	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
110	呂倩慧、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
111	呂倩慧、鄭安志	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一) 國際財務報導準則—合併資訊

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)				
		107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	24	24	28	33	30
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,060	905	1,011	1,261	1,151
償債能力 (%)	流動比率	400	427	359	288	345
	速動比率	339	353	311	248	222
	利息保障倍數	—	775	938	1,766	674
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.66	5.60	6.11	7.34	6.65
	平均收現日數	64	65	60	50	55
	存貨週轉率(次)	3.93	3.51	4.74	4.61	2.19
	應付款項週轉率(次)	4.04	4.28	5.16	4.21	3.75
	平均銷貨日數	93	104	77	79	167
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	11.96	10.8	12.56	15.91	13.91
	總資產週轉率(次)	0.88	0.85	0.91	0.83	0.78
獲利能力	資產報酬率(%)	19	17	18	28	15
	權益報酬率(%)	26	22	24	40	22
	稅前純益占實收資本額比率(%)	55	47	56	115	62
	純益率(%)	22	20	18	29	19
	每股盈餘 (元)	4.70	4.05	4.56	9.04	4.89
現金流量	現金流量比率(%)	114	96	90	121	35
	現金流量允當比率(%)	104	94	102	124	88
	現金再投資比率(%)	6	(3)	4	25	(22)
槓桿度	營運槓桿度	1.85	1.91	2.03	1.92	2.02
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析) 1、流動比率較110年度增加，主要係111年度流動負債減少所致。 2、利息保障倍數較110年度減少，主要係111年度稅前純益減少所致。 3、存貨週轉率(次)較110年度減少，主要係111年度存貨增加所致。 4、平均銷貨日數較110年度增加，主要係111年度存貨增加所致。 5、獲利能力較110年度減少，主要係111年度營業利益及稅後純益減少所致。 6、現金流量較110年度減少，主要係111年度營業活動淨現金流入減少所致。						

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

(二) 國際財務報導準則—個體資訊

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)				
		107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	23	22	26	31	29
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	2,776	1,895	2,109	2,446	2,262
償債能力 %	流動比率	354	379	289	240	232
	速動比率	300	321	255	216	136
	利息保障倍數	—	891	1,063	2,076	705
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.68	5.11	5.13	6.62	5.35
	平均收現日數	64	71	71	55	68
	存貨週轉率(次)	4.46	4.42	6.14	7.35	3.06
	應付款項週轉率(次)	4.02	4.44	4.93	4.32	3.79
	平均銷貨日數	82	83	59	50	119
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	27.56	22.20	21.71	30.02	22.33
	總資產週轉率(次)	0.80	0.78	0.77	0.80	0.66
獲利能力	資產報酬率(%)	20	17	18	29	15
	權益報酬率(%)	26	22	24	40	21
	稅前純益占實收資本額比率(%)	55	46	53	112	60
	純益率(%)	24	23	22	31	23
	每股盈餘 (元)	4.70	4.05	4.56	9.04	4.89
現金流量	現金流量比率(%)	116	85	80	124	33
	現金流量允當比率(%)	97	97	90	118	83
	現金再投資比率(%)	5	(8)	(0)	22	(25)
槓桿度	營運槓桿度	1.72	1.84	2.08	2.20	1.57
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)

- 1、速動比率較110年度減少，主要係111年度流動資產減少所致。
- 2、利息保障倍數較110年度減少，主要係111年度稅前純益減少所致。
- 3、平均收現日數較110年度增加，主要是111年銷貨淨額減少所致。
- 4、存貨週轉率(次)較110年度減少，主要係111年度存貨增加所致。
- 5、平均銷貨日數較110年度增加，主要係111年度存貨增加所致。
- 6、不動產、廠房及設備週轉率(次)較110年度減少，主要係銷貨淨額減少所致。
- 7、獲利能力較110年度減少，主要係111年度營業利益及稅後純益減少所致。
- 8、現金流量較110年度減少，主要係111年度營業活動淨現金流入減少所致。
- 9、營運槓桿度較110年度減少，主要係111年度營業收入減少所致。

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。 註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：請參閱本年報第 78 頁。

四、最近年度財務報告：請參閱本年報附錄一，第 91 頁~第 148 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：

請參閱本年報附錄二，第 149 頁~第 200 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

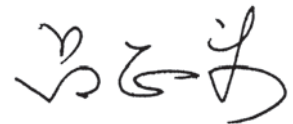
盛群半導體股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及鄭安志會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核竣事，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

盛群半導體股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：呂正樂



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 八 日

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	110 年度	111 年度	增 減 變 動	
			金額	%
流 動 資 產	6,438,279	5,208,350	(1,229,929)	(19)
不 動 產 、 廠 房 及 設 備	343,793	326,243	(17,550)	(5)
使 用 權 資 產	108,902	85,802	(23,100)	(21)
其 他 資 產	1,652,859	1,199,601	(453,258)	(27)
資 產 總 額	8,543,833	6,819,996	(1,723,837)	(20)
流 動 負 債	2,239,032	1,509,818	(729,214)	(33)
非 流 動 負 債	594,553	565,537	(29,016)	(5)
負 債 總 額	2,833,585	2,075,355	(758,230)	(27)
股 本	2,261,682	2,261,682	0	0
資 本 公 積	142,309	142,309	0	0
保 留 盈 餘	2,794,950	2,072,434	(722,516)	(26)
股 東 權 益 總 額	5,710,248	4,744,641	(965,607)	(17)
重大變動項目說明： 1、使用權資產較 110 年度期末減少，主要係子公司廠房租賃到期除帳所致。 2、其他資產較 110 年度期末減少，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資減少所致。 3、流動負債較 110 年度期末減少，主要係所得稅負債減少所致。 4、保留盈餘較 110 年度期末減少，主要係本期淨利減少所致。				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	110 年度	111 年度	增(減)金額	變 動 比例%
營業收入淨額	7,127,750	6,015,968	(1,111,782)	(15.60)
營業成本	3,311,904	2,929,773	(382,131)	(11.54)
	—	—	—	-
營業毛利	3,815,846	3,086,195	(729,651)	(19.12)
減:未實現銷貨利益之變動	174,147	41,826	(132,321)	(75.98)
	—	—	—	-
已實現營業毛利	3,641,699	3,044,369	(597,330)	(16.40)
營業費用	1,867,358	1,812,472	(54,886)	(2.94)
	—	—	—	-
營業利益	1,774,341	1,231,897	(542,444)	(30.57)
營業外收入及利益	816,808	159,063	(657,745)	(80.53)
	—	—	—	-
稅前淨利	2,591,149	1,390,960	(1,200,189)	(46.32)
所得稅費用	522,147	258,653	(263,494)	(50.46)
	—	—	—	-
本期淨利	2,069,002	1,132,307	(936,695)	(45.27)
其他綜合損益(稅後淨額)	202,440	(246,624)	(449,064)	(221.83)
	—	—	—	-
本期綜合損益總額	<u>2,271,442</u>	<u>885,683</u>	<u>(1,385,759)</u>	(61.01)
本期淨利歸屬母公司業主	2,044,064	1,106,374	(937,690)	(45.87)
本期淨利歸屬非控制權益	24,938	25,933	995	3.99
綜合損益歸屬母公司業主	2,246,383	859,286	(1,387,097)	(61.75)
綜合損益歸屬非控制權益	25,059	26,397	1,338	5.34

增減比例變動分析說明：

- 1、聯屬公司間未實現銷貨利益較 110 年度減少，主要係 111 年度出貨至轉投資公司，而轉投資公司未出貨至終端客戶之未實現銷貨利益較 110 年度減少所致。
- 2、營業外收入及利益較 110 年度減少，主要係 111 年度其他利益減少所致。
- 3、所得稅費用較 110 年度減少，主要係 111 年度稅前淨利減少所致。
- 4、其他綜合損益較 110 年度減少，主要係 111 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失增加所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 111 年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,199,759	530,412	(796,193)	933,978	—	—
111 年度現金流量變動情形分析：					
1、營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2、投資活動：存放三個月以上定存減少，致產生投資活動淨現金流入。					
3、籌資活動：發放股東現金紅利，致產生籌資活動淨現金流出。					

(二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
933,978	700,000	(900,000)	733,978	—	—
112 年現金流量情形分析：					
1、營業活動：係預期營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2、籌資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利，致產生籌資活動淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，111 年度依權益法認列之投資收益淨額為 26,294 仟元。

1. 轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
2. 未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。
- 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：
 - (1) 業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
 - (2) 除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
 - (3) 開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。
- 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務，而若從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波動之變動風險，因係避險性質，並未對公司損益造成重大影響之虞。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，每年以投入約營業額之 15%~20%作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 15%~20%作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

在資通安全風險控管上，本公司成立資訊安全委員會定期檢視資訊安全政策的建立、執行及持續改善、對員工進行資訊安全認知宣導及教育訓練、稽核室定期查

核資訊安全管理實務之落實情形，確保資安管理持續且有效的運作。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝測試之代工廠商合作，並無進貨過度集中之情形。

2.本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1.Heritage IP LLC 於民國 111 年 11 月 30 日向美國加州中部聯邦地方法院(CDCA)對本公司之子公司 Holtek Semiconductor USA Inc.提起專利侵權訴訟，主張侵害其美國專利權(專利號碼：7,221,200)，目前依相關程序進行中，本案業經評估，對本公司及子公司 Holtek Semiconductor USA Inc.之營運，尚不致產生重大影響。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

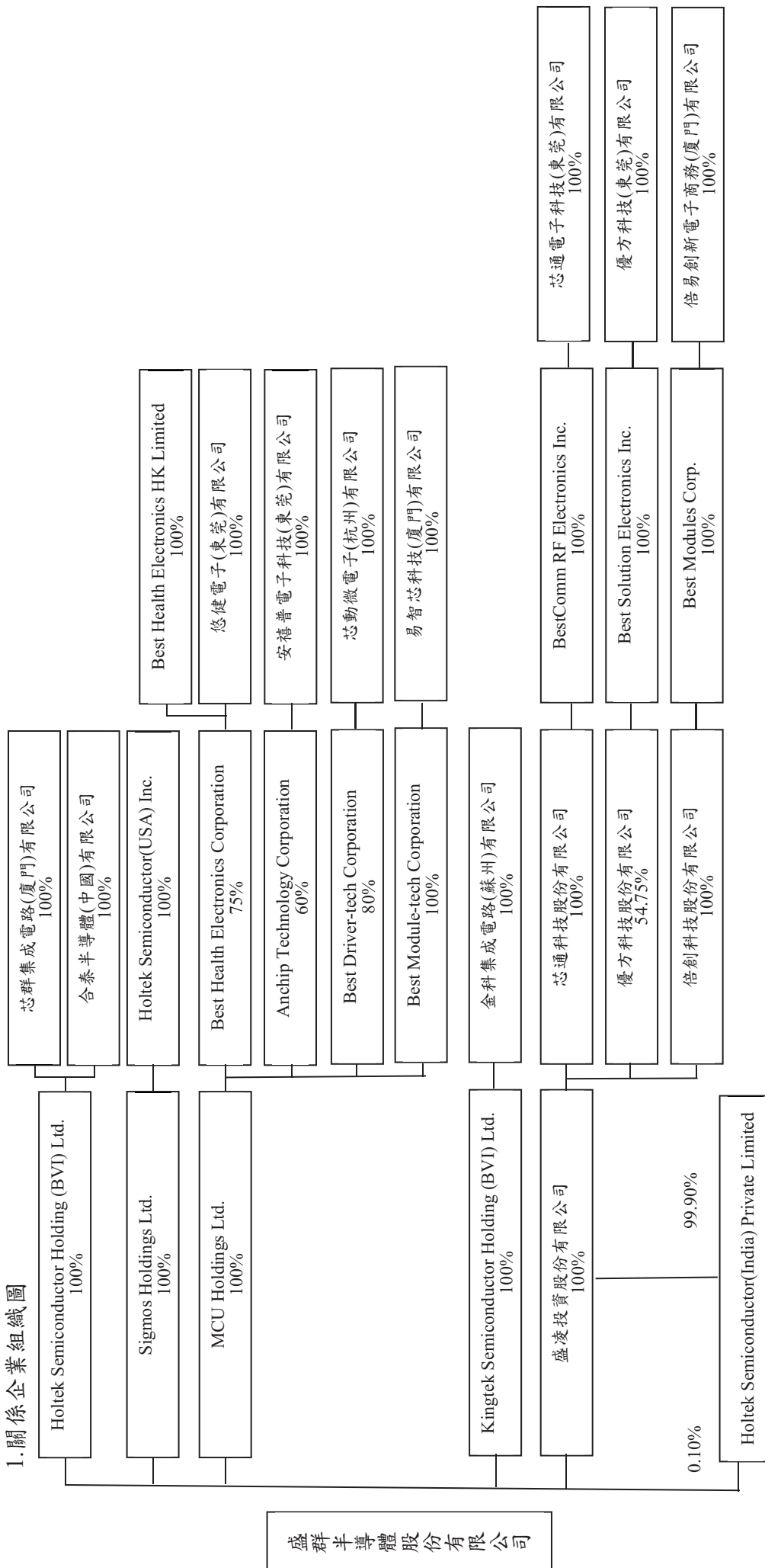
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1.關係企業組織圖



(二)關係企業基本資料

日期：111 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	88.10	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 22,053,360	投資業務
芯群集成電路(廈門)有限公司	97.01	中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室	USD 11,000,000	單片機芯片及其應用工具的技術服務
合泰半導體(中國)有限公司	101.06	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)	CNY 62,000,000	積體電路銷售及技術服務
Sigmos Holdings Ltd.	89.12	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 200,000	投資業務
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	90.05	19 Hammond, Suite 513, Irvine, CA 92618, USA	USD 200,000	積體電路銷售及技術服務
MCU Holdings Ltd.	91.05	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 500,000	投資業務
Best Health Electronics Corporation	106.04	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	CNY 6,000,000	投資業務
Best Health Electronics HK Limited	108.09	15/F, BOC Group Life Assurance Tower, 136 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong	CNY 300,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
悠健電子(東莞)有限公司	106.07	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 301	CNY 5,000,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
Anchip Technology Corporation	104.10	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	CNY 1,000,000	投資業務
安禧普電子科技(東莞)有限公司	105.02	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 401	CNY 300,000	安防應用 IC 銷售及技術服務
Best Driver-tech Corporation	109.02	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	CNY 2,000,000	投資業務
芯動微電子(杭州)有限公司	109.09	杭州市濱江區長河街道江虹路 333 號研祥科技大廈 A 幢 12 層 1203 室	CNY 1,500,000	馬達應用 IC 銷售及技術服務
Best Module-tech Corporation	109.04	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	CNY 3,000,000	投資業務
易智芯科技(廈門)有限公司	109.09	廈門市軟體園二期觀日路 34 號 203 室	CNY 2,500,000	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	91.01	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 2,000,000	投資業務
金科集成電路(蘇州)有限公司	91.04	蘇州工業園區星漢街 5 號 D 幢 3 樓 7/8 單元	USD 2,000,000	積體電路銷售及技術服務
盛凌投資股份有限公司	92.03	新竹市大同路 136 號 2 樓	NTD 429,826,000	投資業務
芯通科技股份有限公司	103.01	新竹市大同路 136 號 2 樓	NTD 40,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
BestComm RF Electronics Inc.	103.02	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway,	CNY 3,000,000	投資業務

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
		Road Town, Tortola, British Virgin Islands		
芯通電子科技(東莞)有限公司	107.01	中國東莞市松山湖新竹路4號新竹苑10幢辦公201	CNY 3,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
優方科技股份有限公司	97.05	臺北市南港區園區街3之2號4樓之2	NTD 20,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
Best Solution Electronics Inc.	97.06	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 200,000	投資業務
優方科技(東莞)有限公司	108.10	中國東莞市松山湖園區新竹路4號9棟407室、408室	CNY 1,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
倍創科技股份有限公司	105.05	新竹市金山十一街20巷18號1樓	NTD 105,000,000	MCU 模組之銷售及技術服務
Best Modules Corp.	109.08	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	CNY 6,500,000	投資業務
倍易創新電子商務(廈門)有限公司	110.08	廈門市集美區兌英路11號1304單元	CNY 6,500,000	MCU 模組之銷售及技術服務
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	107.03	Room 1004, 10th Floor, Prestige Meridian Building 1, 29/30, M.G Road, Bengaluru 560001	INR 6,485,000	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務及投資業務。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：111年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：吳啟勇	22,053,360	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟		
芯群集成電路(廈門)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：吳啟勇	-	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：張 治		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：廖明通		
	總經理	張家志	-	-
合泰半導體(中國)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：吳啟勇	-	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：蔡榮宗		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：廖明通		
	總經理	李修銘	-	-
Sigmos Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟	200,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：林正鋒		
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	董 事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：高國棟	2,000,000	100%
	董 事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：蔡榮宗		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
	總經理	王耀德	-	-
MCU Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟	500,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：林正鋒		
Best Health Electronics Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：林正鋒	4,500	75%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤		
Best Health Electronics HK Limited	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：王明坤	300,000	100%
悠健電子(東莞)有限公司	董事長	Best Health Electronics Corporation 代表人：洪祥歲	-	100%
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：高國棟		
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：王明坤		
	監察人	Best Health Electronics Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	洪祥歲	-	-
Anchip Technology Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤	600	60%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：周玲娜		
	董 事	毛強	400	40%
安禧普電子科技(東莞)有限公司	董事長	Anchip Technology Corporation 代表人：毛強	-	100%
	董 事	Anchip Technology Corporation 代表人：王明坤		
	董 事	Anchip Technology Corporation 代表人：周玲娜		
	監察人	Anchip Technology Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	毛強	-	-
Best Driver-tech Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤	1,600	80%
	董 事	潘健章	400	20%
芯動微電子(杭州)有限公司	董事長	Best Driver-tech Corporation 代表人：潘健章	-	100%
	董 事	Best Driver-tech Corporation 代表人：高國棟		
	董 事	Best Driver-tech Corporation 代表人：王明坤		
	監察人	Best Driver-tech Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	潘健章	-	-
Best Module-tech Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：高國棟	3,000	100%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤		
易智芯科技(廈門)有限公司	董事長	Best Module-tech Corporation 代表人：劉宏裕	-	100%
	董 事	Best Module-tech Corporation 代表人：高國棟		
	董 事	Best Module-tech Corporation 代表人：王明坤		
	監察人	Best Module-tech Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	劉宏裕	-	-
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟		
金科集成電路(蘇州)有限公司	董事長	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：高國棟	-	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：吳啟勇		
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：張 治		
	監察人	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.代表人：廖明通		
	總經理	高國棟	-	-
盛凌投資股份有限公司	董事長	盛群半導體股份有限公司代表人：吳啟勇	42,982,600	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：張 治		
	監察人	盛群半導體股份有限公司代表人：廖明通		
芯通科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司代表人：吳啟勇	4,000,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：王明坤		
	監察人	盛凌投資股份有限公司代表人：廖明通		
	總經理	蕭見通	-	-
BestComm RF Electronics Inc.	董 事	芯通科技股份有限公司代表人：吳啟勇	30,000	100%
	董 事	芯通科技股份有限公司代表人：王明坤		
芯通電子科技(東莞)有限公司	董事長	BestComm RF Electronics Inc.代表人：蕭見通	-	100%
	董 事	BestComm RF Electronics Inc.代表人：高國棟		
	董 事	BestComm RF Electronics Inc.代表人：王明坤		
	監察人	BestComm RF Electronics Inc.代表人：廖明通		
	總經理	蕭見通	-	-
優方科技股份有限公司	董事長	正優有限公司公司代表人：樂正平	167,500	8.375%
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：王明坤	800,000	40%
	董 事	欣宏電子股份有限公司代表人：林既貴	737,500	36.875%
	監察人	吳能結	-	-
	總經理	樂正平	-	-
Best Solution Electronics Inc.	董 事	優方科技股份有限公司代表人：王明坤	200,000	100%
優方科技(東莞)有限公司	董事長	Best Solution Electronics Inc.代表人：樂正平	-	100%
	董 事	Best Solution Electronics Inc.代表人：王明坤		
	董 事	Best Solution Electronics Inc.代表人：林既貴		
	監察人	Best Solution Electronics Inc.代表人：廖明通		
	總經理	樂正平	-	-
倍創科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司代表人：吳啟勇	10,500,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資股份有限公司代表人：蔡榮宗		
	監察人	盛凌投資股份有限公司代表人：廖明通		
	總經理	葉秉霖	-	-
Best Modules Corp.	董 事	倍創科技股份有限公司代表人：高國棟	6,500	100%
	董 事	倍創科技股份有限公司代表人：蔡榮宗		
倍易創新電子商務(廈門)有限公司	董事長	Best Modules Corp.代表人：葉秉霖	-	100%
	董 事	Best Modules Corp.代表人：高國棟		
	董 事	Best Modules Corp.代表人：蔡榮宗		
	監察人	Best Modules Corp.代表人：廖明通		
	總經理	葉秉霖	-	-
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：高國棟	6,485,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：蔡榮宗		
	董 事	盛群半導體股份有限公司代表人：古旭納		
	總經理	蔡榮宗	-	-

(六)關係企業營運概況

日期：111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	665,449	1,341,014	-	1,341,014	-	(123)	61,814	2.8
芯群集成電路(廈門)有限公司	322,726	930,650	512,668	417,982	1,225,204	(54,655)	(45,513)	註 2
合泰半導體(中國)有限公司	292,423	996,449	157,870	838,579	1,981,383	83,057	87,295	註 2
Sigmos Holdings Ltd.	6,898	23,034	-	23,034	-	-	1,556	7.78
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	6,898	25,145	2,111	23,034	19,286	1,756	1,556	0.78
MCU Holdings Ltd.	16,333	1,224,832	-	1,224,832	-	(214)	62,178	124.36
Best Health Electronics Corporation	26,410	63,932	-	63,932	-	(36)	23,221	3,870.21
Best Health Electronics HK Limited	1,299	18,559	54	18,505	29,889	16,548	14,897	49.66
悠健電子(東莞)有限公司	23,057	51,114	10,586	40,528	188,228	7,987	8,305	註 2
Anchip Technology Corporation	5,071	55,495	-	55,495	-	(38)	28,298	28,297.85
安禧普電子科技(東莞)有限公司	1,521	122,707	71,542	51,165	335,106	30,019	28,311	註 2
Best Driver-tech Corporation	8,441	23,616	-	23,616	-	(39)	10,807	5,403.67
芯動微電子(杭州)有限公司	6,361	22,844	1,993	20,851	24,662	10,645	10,803	註 2
Best Module-tech Corporation	12,426	13,470	-	13,470	-	(38)	144	47.83
易智芯科技(廈門)有限公司	10,573	11,013	1	11,012	-	(5)	141	註 2
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	69,542	193,416	-	193,416	-	-	(22,601)	(11.30)
金科集成電路(蘇州)有限公司	69,712	223,626	30,251	193,375	265,170	(23,837)	(22,605)	註 2
盛凌投資股份有限公司	429,826	794,353	-	794,353	-	(1)	68,910	1.60
芯通科技股份有限公司	40,000	22,397	784	21,613	13,365	4,697	6,539	1.63
BestComm RF Electronics Inc.	14,054	13,841	-	13,841	-	(39)	1,813	60.44
芯通電子科技(東莞)有限公司	13,634	15,556	2,485	13,071	30,518	1,733	1,773	註 2
優方科技股份有限公司	20,000	87,392	37,137	50,255	169,174	9,204	16,193	8.10
Best Solution Electronics Inc.	6,140	41,416	-	41,416	-	(55)	9,872	49.36

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
優方科技(東莞) 有限公司	4,285	107,078	67,837	39,241	492,009	8,506	9,948	註 2
倍創科技股份有限公司	105,000	97,991	2,470	95,521	5,706	(4,916)	(3,508)	(0.33)
Best Modules Corp.	28,236	12,124	-	12,124	-	(4)	1,086	167.06
倍易創新電子商務 (廈門)有限公司	28,307	13,190	1,061	12,129	5,023	1,123	1,126	註 2
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	2,948	2,736	420	2,316	2,572	(986)	(1,237)	(0.19)

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，111.12.31 兌美元 30.66、人民幣 4.3843、印度盧比 0.3713。

註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。

(七)關係企業合併財務報表：請參閱本年報第 92 頁。

(八)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

附錄一：

111 年度合併財務報告及會計師查核報告

聲 明 書

本公司民國一一一年度(自一一一年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：盛群半導體股份有限公司



董 事 長：吳啟勇



日 期：民國一一二年二月十六日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司及其子公司(盛群集團)民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛群集團民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群集團民國一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳合併財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列一關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函證發函詢證；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群集團是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

其他事項

盛群半導體股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群集團不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群集團民國一一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂倩慧



鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號
民國 一 一 二 年 二 月 十 六 日

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%		
資產									
流動資產：									
現金及約當現金(附註六(一))	\$	933,978	14	1,199,759	14	2150	2	235,294	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))		242,418	3	970,068	11	2170	8	661,967	8
應收票據及帳款淨額(附註六(四))		94,178	1	114,000	1	2180	-	56	-
應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)		819,670	12	780,971	9	2201	8	616,740	7
存貨(附註六(五))		1,822,934	27	858,202	10	2230	1	439,049	5
其他金融資產－流動(附註六(六)、七及八)		1,226,291	18	2,399,794	28	2280	-	24,048	-
其他流動資產－其他		68,881	1	115,485	2	2310	-	111,860	1
		5,208,350	76	6,438,279	75	2399	3	150,018	2
非流動資產：							22	2,239,032	26
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 (附註六(三))		503,111	8	773,946	9	2570	6	400,251	5
採用權益法之投資(附註六(七)及七)		422,000	6	615,409	7	2580	1	86,719	1
不動產、廠房及設備(附註六(八))		326,243	5	343,793	4	2640	1	81,503	1
使用權資產(附註六(九))		85,802	1	108,902	1	2645	-	26,080	-
無形資產(附註六(十))		23,498	-	39,211	1		8	594,553	7
遞延所得稅資產(附註六(十三))		146,803	2	201,838	3		30	2,833,585	33
其他非流動資產		104,189	2	22,455	-				
		1,611,646	24	2,105,554	25				
負債及權益總計	\$	6,819,996	100	8,543,833	100				
負債：									
流動負債：									
應付票據									
應付帳款									
應付帳款－關係人(附註七)									
應付薪資及獎金									
本期所得稅負債									
租賃負債－流動(附註六(十一))									
預收款項									
其他流動負債－其他									
非流動負債：									
遞延所得稅負債(附註六(十三))									
租賃負債－非流動(附註六(十一))									
淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))									
存入保證金									
負債總計									
權益(附註六(十四))：									
歸屬母公司業主之權益：									
普通股股本									
資本公積									
保留盈餘									
其他權益									
歸屬母公司業主之權益總計									
非控制權益									
權益總計									
負債及權益總計	\$	6,819,996	100	8,543,833	100				



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 6,015,968	100	7,127,750	100
5000	營業成本(附註六(五)、(十)、(十二)、(十六)、七及十二)	2,929,773	49	3,311,904	46
	營業毛利	3,086,195	51	3,815,846	54
5910	未實現銷貨利益之變動	41,826	1	174,147	3
	已實現營業毛利	3,044,369	50	3,641,699	51
	營業費用(附註六(十)、(十二)、(十六)及十二)：				
6100	推銷費用	171,493	3	186,391	3
6200	管理費用	391,188	6	473,216	6
6300	研究發展費用	1,136,791	19	1,207,751	17
6450	預期信用減損損失(附註六(四))	113,000	2	-	-
		1,812,472	30	1,867,358	26
	營業淨利	1,231,897	20	1,774,341	25
	營業外收入及支出：				
7020	其他利益及損失(附註六(十八)及七)	70,094	2	434,923	6
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(七))	26,294	-	342,454	5
7100	利息收入	28,818	-	12,807	-
7130	股利收入(附註六(三))	35,923	1	28,092	-
7510	利息費用(附註六(十一))	(2,066)	-	(1,468)	-
		159,063	3	816,808	11
	稅前淨利	1,390,960	23	2,591,149	36
7950	所得稅費用(附註六(十三))	258,653	4	522,147	7
	本期淨利	1,132,307	19	2,069,002	29
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	10,314	-	(3,487)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(283,835)	(4)	196,601	3
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	2,063	-	(697)	-
	不重分類至損益之項目合計	(275,584)	(4)	193,811	3
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	23,689	-	6,494	-
8371	採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(七))	12,395	-	4,262	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	7,124	-	2,127	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	28,960	-	8,629	-
8300	本期其他綜合損益	(246,624)	(4)	202,440	3
	本期綜合損益總額	\$ 885,683	15	2,271,442	32
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 1,106,374	19	2,044,064	29
8620	非控制權益	25,933	-	24,938	-
		\$ 1,132,307	19	2,069,002	29
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 859,286	15	2,246,383	32
8720	非控制權益	26,397	-	25,059	-
		\$ 885,683	15	2,271,442	32
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.89		9.04	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.83		8.93	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	允價值衡量之金融資產未實現評價損	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損	其他權益	合計	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制權益	權益總計
					未分配盈餘	合計								
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	732,672	31,662	1,020,669	1,785,003	(66,714)	319,516	-	-	252,802	4,441,796	40,607	4,482,403
本期淨利	-	-	-	-	2,044,064	2,044,064	-	-	-	-	-	2,044,064	24,938	2,069,002
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,790)	(2,790)	8,508	196,601	196,601	-	205,109	202,319	121	202,440
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,041,274	2,041,274	8,508	196,601	196,601	-	205,109	2,246,383	25,059	2,271,442
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	102,065	-	(102,065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(29,020)	29,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(83,705)	-	(947,622)	(1,031,327)	-	-	-	-	-	(1,031,327)	-	(1,031,327)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,270)	(12,270)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	751,032	2,642	2,041,276	2,794,950	(58,206)	516,117	516,117	-	457,911	5,656,852	53,396	5,710,248
本期淨利	-	-	-	-	1,106,374	1,106,374	-	-	-	-	-	1,106,374	25,933	1,132,307
本期其他綜合損益	-	-	-	-	8,251	8,251	28,496	(283,835)	(283,835)	-	(255,339)	(247,088)	464	(246,624)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,114,625	1,114,625	28,496	(283,835)	(283,835)	-	(255,339)	859,286	26,397	885,683
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	204,128	-	(204,128)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,837,141)	(1,837,141)	-	-	-	-	-	(1,837,141)	-	(1,837,141)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,829)	(16,829)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,680	2,680
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	955,160	2,642	1,114,632	2,072,434	(29,710)	232,282	232,282	-	202,572	4,678,997	65,644	4,744,641

董事長：吳啟勇

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟

會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,390,960	2,591,149
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	80,730	79,305
攤銷費用	61,940	68,530
預期信用減損損失	113,000	-
利息費用	2,066	1,468
利息收入	(28,818)	(12,807)
股利收入	(35,923)	(28,092)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(26,294)	(342,454)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	41,826	174,147
其他不影響現金流量之損費淨額	9,261	5,517
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	724,359	(187,460)
應收票據及帳款(含關係人)	(101,480)	159,037
存貨	(956,002)	(282,040)
其他營業資產	45,231	(50,036)
應付票據及帳款(含關係人)	(298,285)	258,633
預收款項	(93,208)	106,779
淨確定福利負債	(23,182)	(12,735)
其他營業負債	23,357	242,457
營運產生之現金之流入	929,538	2,771,398
收取之利息	24,204	11,727
收取之股利	147,053	78,525
支付之利息	(1,391)	(1,468)
支付之所得稅	(568,992)	(155,122)
營業活動之淨現金流入	530,412	2,705,060
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,000)	-
取得採用權益法之投資	-	(15,603)
採用權益法之被投資公司減資及清算退還股款	40,676	22,387
取得不動產、廠房及設備	(34,938)	(55,047)
存出保證金增加	(44,290)	(9,821)
取得無形資產	(46,105)	(45,236)
其他金融資產減少(增加)	1,177,528	(1,558,173)
其他非流動資產增加	(38,319)	(2,953)
收取之股利	35,923	28,092
投資活動之淨現金流入(出)	1,077,475	(1,636,354)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(3,363)	14,095
租賃本金償還	(24,743)	(22,612)
發放股東現金股利	(1,837,141)	(1,031,327)
非控制權益變動	(14,149)	(12,270)
籌資活動之淨現金流出	(1,879,396)	(1,052,114)
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,728	(15,426)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(265,781)	1,166
期初現金及約當現金餘額	1,199,759	1,198,593
期末現金及約當現金餘額	\$ 933,978	1,199,759

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇

經理人：高國棟

會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一一一年度及一一〇年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一一二年二月十六日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一一一年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第十六號之修正「不動產、廠房及設備－達到預定使用狀態前之價款」
- 國際會計準則第三十七號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」
- 國際財務報導準則2018-2020週期之年度改善
- 國際財務報導準則第三號之修正「對觀念架構之引述」

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

合併公司評估適用下列自民國一一二年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則，將不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際會計準則第一號之修正「會計政策之揭露」
- 國際會計準則第八號之修正「會計估計值之定義」
- 國際會計準則第十二號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

合併公司預期下列尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第十號及國際會計準則第二十八號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第十七號「保險合約」及國際財務報導準則第十七號之修正
- 國際會計準則第一號之修正「將負債分類為流動或非流動」
- 國際會計準則第一號之修正「具合約條款之非流動負債」
- 國際財務報導準則第十七號之修正「初次適用IFRS 17及IFRS 9比較資訊」
- 國際財務報導準則第十六號之修正「售後租回交易之規定」

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；
- (2)依公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產；及
- (3)淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2.功能性貨幣及表達貨幣

合併公司每一個體均係以各營運所處主要經濟環境之貨幣為其功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及本公司之子公司。

自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。歸屬於子公司非控制權益之損益歸屬於非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司間之重大交易、餘額及未實現收益與費用，於編製合併財務報告時均已消除。

2. 列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			111.12.31	110.12.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100 %	100 %
MCU	Best Health Electronics Corp. (Best Health)	投資控股公司	75 % (註1)	80 % (註1)
Best Health	悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Best Health	Best Health Electronics HK Limited (Best Health HK)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
MCU	Anchip Technology Corporation (Anchip)	投資控股公司	60 %	60 %
Anchip	安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
MCU	Best Power Electronics Corp. (Best Power)	投資控股公司	- % (註5)	100 % (註5)
MCU	Best Driver-tech Corporation (Best Driver-tech)	投資控股公司	80 %	80 %
Best Driver-tech	芯動微電子(杭州)有限公司(芯動微)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
MCU	Best Module-tech Corporation(Best Module-tech)	投資控股公司	100 %	100 %
Best Module-tech	易智芯科技(廈門)有限公司(易智芯)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
本公司及盛凌投資	Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	製造及銷售與技術服務	100 % (註2)	100 % (註2)

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			111.12.31	110.12.31
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售與技術服務	54.75 % (註3)	54.75 % (註3)
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	投資控股公司	100 %	100 %
Best Solution	優方科技(東莞)有限公司(優方東莞)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	倍創科技股份有限公司(倍創)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
倍創	Best Modules Corp.(Best Modules)	投資控股公司	100 %	100 %
Best Modules	倍易創新電子商務(廈門)有限公司(倍易創新)	製造及銷售與技術服務	100 % (註4)	100 % (註4)
盛凌投資	芯通科技股份有限公司(芯通)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
芯通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	投資控股公司	100 %	100 %
BestComm	芯通電子科技(東莞)有限公司	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %

註1：合併公司於民國一一年五月出售5%股權，至持股比例下降至75%。

註2：係盛凌投資持有99.9%股權及盛群持有0.1%股權。

註3：係盛凌投資直接持有40%股權及透過關聯企業持有36.875%股權所計算之綜合持股比例。

註4：合併公司於民國一〇年第三季設立之100%子公司。

註5：Best Power民國一一年第四季進行清算並退回股款。

3.未列入合併財務報告之子公司：無。

(四)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。於後續每一報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、聯合控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

對國外營運機構之貨幣性應收或應付項目，若尚無清償計畫且不可能於可預見之未來予以清償時，其所產生之外幣兌換損益視為對該國外營運機構淨投資之一部分而認列為其他綜合損益。

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

(六)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七)金融工具

應收帳款及所發行之債務證券原始係於產生時認列。所有其他金融資產及金融負債原始係於合併公司成為金融工具合約條款之一方時認列。非透過損益按公允價值衡量之金融資產(除不包含重大財務組成部分之應收帳款外)或金融負債原始係按公允價值加計直接可歸屬於該取得或發行之交易成本衡量。不包含重大財務組成部分之應收帳款原始係按交易價格衡量。

1.金融資產

金融資產之購買或出售符合慣例交易者，合併公司對以相同方式分類之金融資產，其所有購買及出售一致地採交易日或交割日會計處理。

原始認列時，金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資或透過損益按公允價值衡量之金融資產。合併公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始自下一個報導期間之首日起重分類所有受影響之金融資產。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(1)按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

該等資產後續以原始認列金額加減計採有效利息法計算之累積攤銷數，並調整任何備抵損失之攤銷後成本衡量。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。

(2)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

合併公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資後續公允價值變動列報於其他綜合損益。前述選擇係按逐項工具基礎所作成。

權益投資之股利收入於合併公司有權利收取股利之日認列(通常係除息日)。

(3)透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬上述按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。合併公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量條件之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

該等資產後續按公允價值衡量，其淨利益或損失(包含利息收入)係認列為損益。

持有供交易及以公允價值基礎管理並評估績效之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。

(4)金融資產減損

合併公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、應收票據及應收帳款、存出保證金及其他金融資產等)之預期信用損失認列備抵損失。

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，合併公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據合併公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若合約款項逾期超過九十天，合併公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過一百八十天，或借款人不太可能履行其信用義務支付全額款項予合併公司時，合併公司視為該金融資產發生違約。

若金融工具之信用風險評等相當於全球所定義之「投資等級」(為標準普爾之投資等級BBB-、穆迪之投資等級Baa3或中華信評之投資等級twA，或高於該等級者)，合併公司視為該債務證券之信用風險低。

存續期間預期信用損失係指金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

十二個月預期信用損失係指金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失(或較短期間，若金融工具之預期存續期間短於十二個月時)。

衡量預期信用損失之最長期間為合併公司暴露於信用風險之最長合約期間。

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即合併公司依據合約可收取之現金流量與合併公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除。

當合併公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。對公司戶，合併公司係以是否合理預期可回收之基礎個別分析沖銷之時點及金額。合併公司預期已沖銷金額將不會重大迴轉。然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合合併公司回收逾期金額之程序。

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業，或既未移轉亦未保留所有權之幾乎所有風險及報酬且未保留該金融資產之控制時，始將金融資產除列。

合併公司簽訂移轉金融資產之交易，若保留已移轉資產所有權之所有或幾乎所有風險及報酬，則仍持續認列於資產負債表。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.金融負債

(1)負債之分類

合併公司發行之債務係依據合約協議之實質與金融負債定義分類為金融負債。

(2)金融負債

金融負債係分類為攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。金融負債若屬持有供交易、衍生工具或於原始認列時指定，則分類為透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係以公允價值衡量，且相關淨利益及損失，包括任何利息費用，係認列於損益。

其他金融負債後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。利息費用及兌換損益係認列於損益。除列時之任何利益或損失亦係認列於損益。

(3)金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。當金融負債條款修改且修改後負債之現金流量有重大差異，則除列原金融負債，並以修改後條款為基礎按公允價值認列新金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額(包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債)間之差額認列為損益。

(4)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司目前於法律上有可執行之權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(八)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(九)投資關聯企業

關聯企業係指合併公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。合併公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

合併財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與合併公司會計政策一致性之調整後，合併公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，僅在非關係人投資者對關聯企業之權益範圍內，認列於企業財務報表。

當合併公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

合併公司自其投資不再為關聯企業之日起停止採用權益法，並按公允價值衡量保留權益，保留權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，認列於當期損益。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備項目係依成本(包括資本化之借款成本)減累計折舊及任何累計減損衡量。

不動產、廠房及設備之重大組成部分耐用年限不同時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分利益或損失係認列於損益。

2.後續成本

後續支出僅於其未來經濟效益很有可能流入合併公司時始予以資本化。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值計算，並採直線法於每一組成部分之估計耐用年限內認列於損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築：20~40年

(2)機器設備：3~5年

(3)其他設備：2~8年

合併公司於每一報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，並於必要時適當調整。

(十一)租賃

合併公司係於合約成立日評估合約是否係屬或包含租賃，若合約轉讓對已辨認資產之使用之控制權一段時間以換得對價，則合約係屬或包含租賃。

1.承租人

合併公司於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債，使用權資產係以成本為原始衡量，該成本包含租賃負債之原始衡量金額，調整租賃開始日或之前支付之任何租賃給付，並加計所發生之原始直接成本及為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點或標的資產之估計成本，同時減除收取之任何租賃誘因。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

使用權資產後續於租賃開始日至使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者以直線法提列折舊。此外，合併公司定期評估使用權資產是否發生減損並處理任何已發生之減損損失，並於租賃負債發生再衡量的情況下配合調整使用權資產。

租賃負債係以租賃開始日尚未支付之租賃給付之現值為原始衡量。若租賃隱含利率容易確定，則折現率為該利率，若並非容易確定，則使用合併公司之增額借款利率。一般而言，合併公司係採用其增額借款利率為折現率。

計入租賃負債衡量之租賃給付包括：

- (1) 固定給付，包括實質固定給付；
- (2) 取決於某項指數或費率之變動租賃給付，採用租賃開始日之指數或費率為原始衡量；
- (3) 預期支付之殘值保證金額；及
- (4) 於合理確定將行使購買選擇權或租賃終止選擇權時之行使價格或所須支付之罰款。

租賃負債後續係以有效利息法計提利息，並於發生以下情況時再衡量其金額：

- (1) 用以決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動；
- (2) 預期支付之殘值保證金額有變動；
- (3) 標的資產購買選擇權之評估有變動；
- (4) 對是否行使延長或終止選擇權之估計有所變動，而更改對租賃期間之評估；
- (5) 租賃標的、範圍或其他條款之修改。

租賃負債因前述用以決定租賃給付之指數或費率變動、殘值保證金額有變動以及購買、延長或終止選擇權之評估變動而再衡量時，係相對應調整使用權資產之帳面金額，並於使用權資產之帳面金額減至零時，將剩餘之再衡量金額認列於損益中。

對於減少租賃範圍之租賃修改，則係減少使用權資產之帳面金額以反映租賃之部分或全面終止，並將其與租賃負債再衡量金額間之差額則認列於損益中。

合併公司將不符合投資性不動產定義之使用權資產及租賃負債分別以單行項目表達於資產負債表中。

針對公務車及員工宿舍租賃之短期租賃及低價值標的資產租賃，合併公司選擇不認列使用權資產及租賃負債，而係將相關租賃給付依直線基礎於租賃期間內認列為費用。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.出租人

合併公司為出租人之交易，係於租賃成立日將租賃合約依其是否移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬分類，若是則分類為融資租賃，否則分類為營業租賃。於評估時，合併公司考量包括租賃期間是否涵蓋標的資產經濟年限之主要部分等相關特定指標。

若協議包含租賃及非租賃組成部分，合併公司使用國際財務報導準則第十五號之規定分攤合約中之對價。

(十二)無形資產

1.認列及衡量

研究活動相關支出於發生時認列為損益。

發展支出僅於其能可靠衡量、產品或流程之技術或商業可行性已達成、未來經濟效益很有可能流入合併公司，及合併公司意圖且具充足資源以完成該發展且加以使用或出售該資產時，始予以資本化。其他發展支出則於發生時認列於損益。原始認列後，資本化之發展支出以其成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。

合併公司取得其他有限耐用年限之無形資產，係以成本減除累計攤銷與累計減損後之金額衡量。

2.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產之未來經濟效益時始予以資本化。

3.攤銷

攤銷係依資產成本減除估計殘值計算，並自無形資產達可供使用狀態起，按直線法於其估計耐用年限內認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)電腦軟體：1~5年

(2)專門技術：1~5年

合併公司於每一報導日檢視無形資產之攤銷方法、耐用年限及殘值，並於必要時，適當調整。

(十三)非金融資產減損

合併公司於每一報導日評估是否有跡象顯示非金融資產(除存貨及遞延所得稅資產外)之帳面金額可能有減損。若有任一跡象存在，則估計該資產之可回收金額。

為減損測試之目的，係將現金流入大部分獨立於其他個別資產或資產群組之現金流入之一組資產作為最小可辨認資產群組。企業合併取得之商譽係分攤至預期可自合併綜效受益之各現金產生單位或現金產生單位群組。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則認列減損損失。

商譽以外之非金融資產僅在不超過該資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)之範圍內迴轉。

(十四)負債準備

負債準備之認列係因過去事件而負有現時義務，使合併公司未來很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計。負債準備係以反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險評估之稅前折現率予以折現，折現之攤銷則認列為利息費用。

(十五)收入之認列

客戶合約之收入

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。合併公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。合併公司依主要收入項目說明如下：

1.銷售商品

合併公司研究、開發、生產、製造及銷售各種積體電路。合併公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售訂單接受產品，驗收條款已失效，或合併公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

合併公司於交付商品時認列應收帳款，因合併公司在該時點具無條件收取對價之權利。

2.財務組成部分

合併公司預期所有客戶合約移轉商品或勞務予客戶之時間與客戶為該商品或勞務付款之時間間隔皆不超過一年，因此，合併公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

(十六)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供服務期間內認列為費用。

2.確定福利計畫

合併公司對確定福利計畫之淨義務係分別針對各項福利計畫以員工當期或以前期間服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算，並減除任何計畫資產之公允價值。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

確定福利義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司可能有利時，認列資產係以從該計畫退還提撥金或對該計畫減少未來提撥金之形式可得之任何經濟效益之現值為限。計算經濟效益現值時，係考量任何最低資金提撥要求。

淨確定福利負債之再衡量數包含精算損益、計畫資產報酬(不包括利息)，及資產上限影響數之任何變動(不包括利息)係立即認列於其他綜合損益，並累計於保留盈餘。合併公司決定淨確定福利負債之淨利息費用，係使用年度報導期間開始時所決定之淨確定福利負債及折現率。確定福利計畫之淨利息費用及其他費用係認列於損益。

計畫修正或縮減時，所產生與前期服務成本或縮減利益或損失相關之福利變動數，係立即認列為損益。合併公司於清償發生時，認列確定福利計畫之清償損益。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係於服務提供時認列為費用。若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十七)所得稅

所得稅包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括依據當年度課稅所得(損失)計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅或應收退稅款之調整。其金額係按報導日之法定稅率或實質性立法之稅率衡量預期將支付或收取款項之最佳估計值。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期暫時性差異迴轉時之稅率衡量，採用報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減；或在變成很有可能有足夠課稅所得之範圍內迴轉原已減少之金額。

(十八)每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

會計政策涉及重大判斷，且對本合併財務報告已認列金額有重大影響之資訊如下：

對關聯企業是否具實質控制之判斷

合併公司持有關聯企業20%~41%之有表決權股份，其餘持股集中於特定股東，且合併公司無法取得該等關聯企業過半之董事席次，亦未取得股東會出席股東過半之表決權，故判定合併公司對該等關聯企業不具實質控制。

合併公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。合併公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，合併公司係於報導日認列該移轉。

衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十九)金融工具。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	111.12.31	110.12.31
現金及活期存款	\$ 784,175	836,654
定期存款	149,803	363,105
	<u>\$ 933,978</u>	<u>1,199,759</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	111.12.31	110.12.31
受益憑證	<u>\$ 242,418</u>	<u>970,068</u>

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(十九)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

(三)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動

	111.12.31	110.12.31
未上市(櫃)公司股票		
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	\$ 453,828	667,747
Unitech Capital Inc. (Unitech)	45,697	104,669
精匠微電子股份有限公司(精匠微電子)	3,485	-
金佶科技股份有限公司(金佶科技)	101	1,530
	<u>\$ 503,111</u>	<u>773,946</u>

合併公司持有該等權益工具投資為長期策略性投資且非為交易目的所持有，故已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(十九)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

3.合併公司因上列指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，於民國一一一年度及一一〇年度認列之股利收入分別為35,923千元及28,092千元。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	111.12.31	110.12.31
應收票據	\$ 357	8,648
應收帳款	98,483	112,745
應收關係人款	935,755	780,971
	1,034,595	902,364
減：備抵損失	(120,747)	(7,393)
	<u>\$ 913,848</u>	<u>894,971</u>

民國一一〇年一月一日應收票據及帳款淨額(含關係人)為1,048,268千元。

合併公司針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。合併公司應收款項之預期信用損失分析如下：

	111.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 757,376	0.5%~2.5%	17,567
逾期90天以下	192,478	9.58%	18,439
逾期90天以上	84,741	100%	84,741
合計	<u>\$ 1,034,595</u>		<u>120,747</u>

	110.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 837,105	0.5%~1.5%	4,130
逾期90天以下	65,259	5%	3,263
合計	<u>\$ 902,364</u>		<u>7,393</u>

合併公司應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	111年度	110年度
期初餘額	\$ 7,393	7,393
認列之減損損失	113,000	-
匯率變動之影響數	354	-
期末餘額	<u>\$ 120,747</u>	<u>7,393</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(五)存貨

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
原料及物料	\$ 616,123	82,573
在製品	522,963	341,666
製成品及商品	<u>683,848</u>	<u>433,963</u>
	<u>\$ 1,822,934</u>	<u>858,202</u>

營業成本組成明細如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
銷貨成本	\$ 2,924,894	3,305,548
報廢成本	<u>4,879</u>	<u>6,356</u>
	<u>\$ 2,929,773</u>	<u>3,311,904</u>

上述合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(六)其他金融資產－流動

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 1,202,926	2,386,863
受限制銀行存款	8,918	8,913
其他	<u>14,447</u>	<u>4,018</u>
	<u>\$ 1,226,291</u>	<u>2,399,794</u>

合併公司於民國一一一年度及一一〇年度，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十九)。

(七)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 754,290	905,873
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(332,290)</u>	<u>(290,464)</u>
	<u>\$ 422,000</u>	<u>615,409</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，其彙總財務資訊如下，該等財務資訊係於合併公司之合併財務報告中所包含之金額：

	111年度	110年度
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之金額：		
本期淨利	\$ 26,294	342,454
其他綜合損益	12,395	4,262
綜合損益總額	<u>\$ 38,689</u>	<u>346,716</u>

Risintek於民國一一一年度進行清算並退還股款15,603千元。

鈺威科技股份有限公司於民國一一一年度及一一〇年度進行減資並退還股款分別為25,073千元及22,387千元。

上述合併公司之採用權益法之投資均未有提供作質押擔保之情形。

(八)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國111年1月1日餘額	\$ 26,676	519,226	365,198	110,827	1,021,927
增 添	-	833	29,600	4,505	34,938
減 少	-	-	(3,400)	(2,873)	(6,273)
匯率變動之影響	-	3,594	2,027	801	6,422
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>523,653</u>	<u>393,425</u>	<u>113,260</u>	<u>1,057,014</u>
民國110年1月1日餘額	\$ 26,676	510,818	345,923	112,985	996,402
增 添	-	6,992	39,233	8,822	55,047
減 少	-	-	(20,755)	(11,283)	(32,038)
匯率變動之影響	-	1,416	797	303	2,516
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>519,226</u>	<u>365,198</u>	<u>110,827</u>	<u>1,021,927</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
累計折舊：					
民國111年1月1日 餘額	\$ -	302,003	288,870	87,261	678,134
本期折舊	-	12,676	31,634	11,223	55,533
減 少	-	-	(3,369)	(2,830)	(6,199)
匯率變動之影響	-	1,196	1,469	638	3,303
民國111年12月31日 餘額	<u>\$ -</u>	<u>315,875</u>	<u>318,604</u>	<u>96,292</u>	<u>730,771</u>
民國110年1月1日 餘額	\$ -	289,421	280,152	83,486	653,059
本期折舊	-	12,121	28,758	14,786	55,665
減 少	-	-	(20,581)	(11,249)	(31,830)
匯率變動之影響	-	461	541	238	1,240
民國110年12月31日 餘額	<u>\$ -</u>	<u>302,003</u>	<u>288,870</u>	<u>87,261</u>	<u>678,134</u>
帳面價值：					
民國111年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>207,778</u>	<u>74,821</u>	<u>16,968</u>	<u>326,243</u>
民國110年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>217,223</u>	<u>76,328</u>	<u>23,566</u>	<u>343,793</u>
民國110年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>221,397</u>	<u>65,771</u>	<u>29,499</u>	<u>343,343</u>

上述合併公司不動產、廠房及設備均未有提供作質押擔保之情形。

(九)使用權資產

合併公司承租土地與房屋及建築等之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	總 計
成本：			
民國111年1月1日 餘額	\$ 67,341	75,454	142,795
增 添	263	1,834	2,097
減 少	-	(16,689)	(16,689)
民國111年12月31日 餘額	<u>\$ 67,604</u>	<u>60,599</u>	<u>128,203</u>
民國110年1月1日 餘額	\$ 67,341	72,106	139,447
增 添	-	34,431	34,431
減 少	-	(31,083)	(31,083)
民國110年12月31日 餘額	<u>\$ 67,341</u>	<u>75,454</u>	<u>142,795</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	土 地	房屋及 建 築	總 計
折舊：			
民國111年1月1日餘額	\$ 9,183	24,710	33,893
本期折舊	3,069	22,128	25,197
減 少	-	(16,689)	(16,689)
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 12,252</u>	<u>30,149</u>	<u>42,401</u>
民國110年1月1日餘額	\$ 6,122	33,278	39,400
本期折舊	3,061	20,579	23,640
減 少	-	(29,147)	(29,147)
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 9,183</u>	<u>24,710</u>	<u>33,893</u>
帳面價值：			
民國111年12月31日	<u>\$ 55,352</u>	<u>30,450</u>	<u>85,802</u>
民國110年12月31日	<u>\$ 58,158</u>	<u>50,744</u>	<u>108,902</u>
民國110年1月1日	<u>\$ 61,219</u>	<u>38,828</u>	<u>100,047</u>

(十)無形資產

合併公司無形資產之成本及累計攤銷變動明細如下：

	電腦軟體	專利權	總 計
成本：			
民國111年1月1日餘額	\$ 205,416	106,759	312,175
增 添	46,105	-	46,105
減 少	(51,676)	(18,609)	(70,285)
重分類	112	-	112
匯率變動影響數	11	-	11
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 199,968</u>	<u>88,150</u>	<u>288,118</u>
民國110年1月1日餘額	\$ 206,642	117,222	323,864
增 添	45,236	-	45,236
減 少	(46,490)	(10,463)	(56,953)
匯率變動影響數	28	-	28
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 205,416</u>	<u>106,759</u>	<u>312,175</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	電腦軟體	專利權	總 計
攤銷：			
民國111年1月1日餘額	\$ 183,283	89,681	272,964
本期攤銷	51,523	10,417	61,940
減 少	(51,676)	(18,609)	(70,285)
匯率變動影響數	1	-	1
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 183,131</u>	<u>81,489</u>	<u>264,620</u>
民國110年1月1日餘額	\$ 178,680	82,683	261,363
本期攤銷	51,069	17,461	68,530
減 少	(46,490)	(10,463)	(56,953)
匯率變動影響數	24	-	24
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 183,283</u>	<u>89,681</u>	<u>272,964</u>
帳面價值：			
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 16,837</u>	<u>6,661</u>	<u>23,498</u>
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 22,133</u>	<u>17,078</u>	<u>39,211</u>
民國110年1月1日	<u>\$ 27,962</u>	<u>34,539</u>	<u>62,501</u>

上述合併公司之無形資產均未有提供作質押擔保之情形。

(十一)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	111.12.31	110.12.31
流動	<u>\$ 16,484</u>	<u>24,048</u>
非流動	<u>\$ 71,637</u>	<u>86,719</u>

到期分析請詳附註六(十九)。

認列於損益之金額如下：

	111年度	110年度
租賃負債之利息費用	<u>\$ 1,391</u>	<u>1,468</u>
短期租賃之費用	<u>\$ 4,950</u>	<u>5,481</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	<u>\$ 680</u>	<u>725</u>

認列於現金流量表之金額如下：

	111年度	110年度
租賃之現金流出總額	<u>\$ 31,764</u>	<u>30,286</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司承租土地、房屋及建築作為辦公處所，土地之租賃期間通常為二十年，辦公處所之租賃期間通常為二至二十年，部份租賃包含在租賃期間屆滿時得延長與原合約相同期間之選擇權。

部分土地及辦公室之租賃合約包含租賃延長之選擇權，該等合約係由各地區分別管理，因此所約定之個別條款及條件於公司內部有所不同。該等選擇權僅合併公司具有可執行之權利，出租人並無此權利。在無法合理確定將行使可選擇之延長租賃期間之情況下，與選擇權所涵蓋期間之相關給付並不計入租賃負債。

另，科學園區管理局土地合約之租賃給付取決於當地公告地價，並加計各園區再投入之公共設施建設費經攤算後辦理調整。

(十二)員工福利

1.確定福利計畫

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	111.12.31	110.12.31
確定福利義務現值	\$ 52,256	146,707
計畫資產之公允價值	(3,759)	(65,204)
淨確定福利負債	<u>\$ 48,497</u>	<u>81,503</u>

合併公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

合併公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計3,759千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)確定福利義務現值之變動

合併公司確定福利義務現值變動如下：

	111年度	110年度
1月1日確定福利義務	\$ 146,707	146,956
計畫支付之福利	(89,695)	(4,999)
當期服務成本及利息	1,027	436
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損失	(3,336)	(6,307)
— 因人口假設變動所產生之精算損失	-	3,844
— 因經驗變動所產生之精算損失	(2,447)	6,777
12月31日確定福利義務	<u>\$ 52,256</u>	<u>146,707</u>

(3)計畫資產公允價值之變動

合併公司確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	111年度	110年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 65,204	56,468
計畫支付之福利	(89,534)	(2,008)
利息收入	537	173
已提撥至計畫之金額	23,021	9,744
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計畫資產報酬(不含當期利息)	4,531	827
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 3,759</u>	<u>65,204</u>

(4)認列為損益之費用

合併公司認列為損益之費用如下：

	111年度	110年度
淨確定福利負債之淨利息	<u>\$ 490</u>	<u>263</u>
營業成本	\$ 31	17
推銷費用	34	19
管理費用	67	36
研究發展費用	358	191
	<u>\$ 490</u>	<u>263</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)精算假設

合併公司於財務報導結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	111.12.31	110.12.31
折現率	1.30 %	0.70 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

合併公司預計於民國一一一年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為11,296千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為10年。

(6)敏感度分析

當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加0.1%	減少0.1%
111年12月31日		
折現率	\$ (526)	534
未來薪資成長率	\$ 488	(482)
110年12月31日		
折現率	\$ (1,521)	1,543
未來薪資成長率	\$ 1,386	(1,371)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2.確定提撥計畫

合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。合併公司民國一一一年度及一一〇年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為31,307千元及27,329千元，已提撥至勞工保險局。

除上所述，民國一一一年度及一一〇年度國外分公司及合併子公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為40,815千元及31,274千元。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十三)所得稅

1.所得稅費用

合併公司所得稅費用明細如下：

	111年度	110年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 197,587	494,528
調整前期之當期所得稅	(7,238)	6,231
	<u>190,349</u>	<u>500,759</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	68,304	21,388
	<u>\$ 258,653</u>	<u>522,147</u>

合併公司認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	111年度	110年度
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ <u>2,063</u>	<u>(697)</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ 4,738	1,299
採用權益法認列關聯企業之國外營運機構 財務報表換算之兌換差額	<u>\$ 2,386</u>	<u>828</u>
	<u>\$ 7,124</u>	<u>2,127</u>

合併公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	111年度	110年度
稅前淨利	\$ 1,390,960	2,591,149
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	\$ 278,192	518,230
外國轄區稅率差異影響數	(13,755)	(14,013)
永久性差異調整	(42,704)	(67,696)
採用權益法認列之子公司損益之份額淨額	47,589	100,725
投資抵減之所得稅影響數	(5,381)	(19,878)
未認列暫時性差異之變動	4,383	(956)
前期(高)低估	(7,238)	6,231
其他	<u>(2,433)</u>	<u>(496)</u>
	<u>\$ 258,653</u>	<u>522,147</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	110.1.1	認列於 損益表	認列於 其他綜合 損益表	110.12.31	認列於 損益表	認列於 其他綜合 損益表	111.12.31
存貨跌價損失	\$ 12,000	-	-	12,000	-	-	12,000
未實現聯屬公司間利益	48,300	112,855	-	161,155	(46,933)	-	114,222
備抵呆帳超限數	-	-	-	-	6,898	-	6,898
淨確定福利負債	18,098	(2,494)	697	16,301	(4,539)	(2,063)	9,699
國外營運機構財務報表 換算之兌換損失	12,892	-	(2,127)	10,765	-	(7,124)	3,641
其他	2,387	(770)	-	1,617	(1,274)	-	343
	<u>\$ 93,677</u>	<u>109,591</u>	<u>(1,430)</u>	<u>201,838</u>	<u>(45,848)</u>	<u>(9,187)</u>	<u>146,803</u>

遞延所得稅負債

	110.1.1	認列於 損益表	認列於 其他綜合 損益表	110.12.31	認列於 損益表	認列於 其他綜合 損益表	111.12.31
採權益法認列之國外投 資利益	\$ 268,281	130,635	-	398,916	20,705	-	419,621
其他	991	344	-	1,335	1,751	-	3,086
	<u>\$ 269,272</u>	<u>130,979</u>	<u>-</u>	<u>400,251</u>	<u>22,456</u>	<u>-</u>	<u>422,707</u>

3.本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇九年度。

(十四)資本及其他權益

1.股本

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度),實收股本均為2,261,682千元,每股面額10元。

2.資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	111.12.31	110.12.31
普通股股本溢價	<u>\$ 142,309</u>	<u>142,309</u>

依公司法規定,資本公積需優先填補虧損後,始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積,包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定,得撥充資本之資本公積,每年撥充之合計金額,不得超過實收資本額百分之十。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

3.保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會規定應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。

本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依金管會規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一一一年及一一〇年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

另，依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(3)盈餘分派

本公司民國一一〇年度及一〇九年度盈餘分派案，分別於民國一一一年五月二十四日及一一〇年七月十五日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	110年度		109年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 8.1229	1,837,141	4.56	1,031,327

(十五)每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	111年度	110年度
基本每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ 1,106,374	2,044,064
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
基本每股盈餘(元)	\$ 4.89	9.04
稀釋每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ 1,106,374	2,044,064
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)：		
員工酬勞	2,737	2,815
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	228,905	228,983
稀釋每股盈餘(元)	\$ 4.83	8.93

(十六)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一・五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一一一年度及一一〇年度員工酬勞估列金額分別為160,430千元及299,875千元，董事酬勞估列金額分別為19,099千元及35,499千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為299,875千元及35,499千元，與本公司董事會擬議內容並無差異，民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為125,414千元及13,735千元，皆係以現金發放，與實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十七)客戶合約之收入

1.收入之細分

收入之細分請詳附註十四。

2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(四)。

(十八)營業外收入及支出

合併公司綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	111年度	110年度
外幣兌換淨利益	\$ 8,586	16,380
其他	61,508	418,543
	<u>\$ 70,094</u>	<u>434,923</u>

其他主要係合併公司向客戶收取之服務費，民國一一一年度及一一〇年度金額分別為27,748千元及394,778千元。

(十九)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一一一年及一一〇年十二月三十一日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為344,065千元及215,170千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(3)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(四)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(六)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(合併公司如何判定信用風險低之說明請詳附註四(七))。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.流動性風險

金融負債之合約到期日分析如下：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
111年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 664,347	664,347	664,347	-
應付薪資及獎金	529,177	529,177	529,177	-
應付費用(帳列其他流動負債)	69,980	69,980	69,980	-
存入保證金	22,696	22,696	-	22,696
租賃負債(流動及非流動)	88,121	97,853	17,581	80,272
	<u>\$ 1,374,321</u>	<u>1,384,053</u>	<u>1,281,085</u>	<u>102,968</u>
110年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 897,317	897,317	897,317	-
應付薪資及獎金	616,740	616,740	616,740	-
應付費用(帳列其他流動負債)	95,776	95,776	95,776	-
存入保證金	26,080	26,080	-	26,080
租賃負債(流動及非流動)	110,767	121,830	25,421	96,409
	<u>\$ 1,746,680</u>	<u>1,757,743</u>	<u>1,635,254</u>	<u>122,489</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險—匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	111.12.31			110.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 13,719	30.66	420,627	12,597	27.63	348,048
人民幣	114,009	4.3843	499,849	88,149	4.3196	380,770
<u>非貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 19,382	30.66	594,239	25,022	27.63	691,360
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 15,126	30.66	463,752	13,635	27.63	376,733
人民幣	3,481	4.3843	15,260	8,702	4.3196	37,589

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2) 敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一一年及一一〇年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一一年度及一一〇年度之稅後淨利將分別增加或減少3,532千元及2,516千元。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一一年度及一一〇年度外幣兌換淨利益(含已實現及未實現)分別為8,586千元及16,380千元。

(4) 其他價格風險

如報導日金融資產－價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)稅後損益之影響如下：

報導日公允價值	111年度		110年度	
	其他綜合損益稅後金額	稅後損益	其他綜合損益稅後金額	稅後損益
上漲1%	\$ 4,025	1,939	6,192	7,761
下跌1%	\$ (4,025)	(1,939)	(6,192)	(7,761)

4. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

合併公司之非衍生性短期金融工具以其在合併資產負債表上之帳面價值估計其公允價值，因為此類金融工具到期日甚近，故其帳面價值應屬估計公允價值之合理基礎。此方法應用於按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債，包含現金及約當現金、應收票據及帳款(含關係人)、應付票據及帳款(含關係人)、其他金融資產-流動、存出保證金及存入保證金等。

除上述金融工具及租賃負債依規定無須揭露公允價值資訊外，各財務報導日合併公司其餘各項金融工具之帳面價值及公允價值彙總如下：

	111.12.31				
	公 允 價 值				合 計
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	\$ 242,418	242,418	-	-	242,418
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	503,111	-	-	503,111	503,111
	<u>\$ 745,529</u>	<u>242,418</u>	<u>-</u>	<u>503,111</u>	<u>745,529</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	110.12.31				
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 970,068	970,068	-	-	970,068
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	773,946	-	-	773,946	773,946
	<u>\$ 1,744,014</u>	<u>970,068</u>	<u>-</u>	<u>773,946</u>	<u>1,744,014</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

A.合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

B.合併公司持有之金融工具屬無活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

- 無公開報價之權益工具：屬投資公司者，係使用淨資產價值法估算公允價值，資產法係經由評估評價標的涵蓋之個別資產及個別負債之總價值，以反映企業整體價值。
- 無公開報價之權益工具：其他投資標的，則係使用市場可比公司法估算公允價值，按同業之股價淨值比評估。

(3)民國一一一年度及一一〇年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(4)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—權益證券投資。

合併公司歸類為第三等級之無活絡市場權益工具投資具有複數重大不可觀察輸入值。無活絡市場之權益工具投資之重大不可觀察輸入值因彼此獨立，故不存在相互關聯性。

重大不可觀察輸入值之量化資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—無活絡市場之權益工具投資	市場法(可類比上市櫃公司同業股價淨值比)	• 股價淨值比乘數(111.12.31及110.12.31分別為1.20~1.44及2.31) • 缺乏市場流通性折價(111.12.31及110.12.31皆為25%)	• 股價淨值比乘數愈高，公允價值愈高 • 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—無活絡市場之權益工具投資	淨資產價值法	• 淨資產價值 • 缺乏市場流通性折價(111.12.31及110.12.31均為10%)	• 不適用 • 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)第三等級間之變動明細

	透過其他綜合損益按公允價值衡量— 無公開報價之權益工具	
	111年度	110年度
1月1日餘額	\$ 773,946	577,345
新增	13,000	-
認列於其他綜合損益	(283,835)	196,601
12月31日餘額	<u>\$ 503,111</u>	<u>773,946</u>

上述總利益，係列報於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益」。

(二十)財務風險管理

1.概要

合併公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達合併公司上述各項風險之暴險資訊、合併公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十九)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管合併公司之風險管理政策。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係合併公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於合併公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十九)。另，截至民國一一一年及一一〇年十二月三十一日止，合併公司均無提供任何背書保證。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.流動性風險

流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督合併公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控合併公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保合併公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一一一年十二月三十一日止，合併公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度154,700千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

合併公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

- (1)合併公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。
- (2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(廿一)資本管理

董事會管理資本之目標係確保合併公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據合併公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定合併公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對合併公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據合併公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定合併公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一一一年十二月三十一日止，合併公司資本管理之方式並未改變。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司於報導日之負債權益比率如下：

	111.12.31	110.12.31
負債總額	\$ <u>2,075,355</u>	<u>2,833,585</u>
權益總額	\$ <u>4,744,641</u>	<u>5,710,248</u>
負債權益比率	<u>44%</u>	<u>50%</u>

(廿二)非現金交易之籌資活動

合併公司非現金交易籌資活動如下：

1.以租賃方式取得使用權資產，請詳附註六(九)。

2.來自籌資活動之負債之調節如下表：

	111.1.1	現金流量	其他	111.12.31
租賃負債(流動及非流動)	\$ 110,767	(24,743)	2,097	88,121
存入保證金	26,080	(3,363)	(21)	22,696
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 136,847</u>	<u>(28,106)</u>	<u>2,076</u>	<u>110,817</u>

	110.1.1	現金流量	其他	110.12.31
租賃負債(流動及非流動)	\$ 100,893	(22,612)	32,486	110,767
存入保證金	11,985	14,095	-	26,080
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 112,878</u>	<u>(8,517)</u>	<u>32,486</u>	<u>136,847</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本合併財務報告之涵蓋期間內 與合併公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與合併公司之關係
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	合併公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	合併公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	合併公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	合併公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	合併公司之關聯企業
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	合併公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	合併公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	合併公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	合併公司之關聯企業
Bestway Electronic Inc.(Bestway)	合併公司之關聯企業

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

關係人名稱	與合併公司之關係
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	合併公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	合併公司之關聯企業
浚達科技有限公司(浚達)	合併公司之關聯企業
鈺威科技股份有限公司(鈺威)	合併公司之關聯企業

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	111年度	110年度
欣宏	\$ 1,156,587	1,229,732
關聯企業	2,681,949	3,995,799
	<u>\$ 3,838,536</u>	<u>5,225,531</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一一年及一一〇年十二月三十一日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為332,290千元及290,464千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項(含備抵損失)明細如下：

	111.12.31	110.12.31
欣宏	\$ 241,551	215,170
TRUETEK	102,514	76,134
關聯企業	475,605	489,667
	<u>\$ 819,670</u>	<u>780,971</u>

2.進貨

合併公司向關係人進貨金額如下：

	111年度	110年度
關聯企業	<u>\$ 23,349</u>	<u>86</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司因上述交易產生之應付關係人款項明細如下：

	111年度	110年度
關聯企業	\$ <u>178</u>	<u>56</u>

3.其他交易

民國一一一年度及一一〇年度合併公司向關聯企業收取人力支援等服務性質之收入分別為21,782千元及197,546千元。合併公司因前述交易及代墊等所產生之應收款項餘額，於民國一一一年及一一〇年十二月三十一日分別為2,349千元及1,350千元，帳列其他金融資產－流動項下。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	111年度	110年度
短期員工福利	\$ 37,612	47,007
退職後福利	432	432
	\$ <u>38,044</u>	<u>47,439</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	111.12.31	110.12.31
定期存款(帳列其他金融資產－流動)	其他保證金	\$ <u>8,918</u>	<u>8,913</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)合併公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

(二)合併公司與一供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金(帳列其他非流動資產項下)，約定合併公司需購買之相關年限及最低數量。合併公司考量市場需求，依合約估列相關合約負債準備，帳列其他流動負債及營業成本項下。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	111年度			110年度		
	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	36,885	1,028,101	1,064,986	45,789	1,261,431	1,307,220
勞健保費用	2,872	62,617	65,489	2,801	56,498	59,299
退休金費用	1,826	70,786	72,612	1,732	57,134	58,866
其他員工福利費用	1,721	24,313	26,034	1,884	25,055	26,939
折舊費用	5,614	75,116	80,730	7,667	71,638	79,305
攤銷費用	23	61,917	61,940	561	67,969	68,530

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一年度合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高 持股比率	備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值		
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	7,422	115,414	-	115,414	-	
本公司	統一強棒貨幣市場 基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	7,495	127,004	-	127,004	-	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	2,500	45,697	5.00 %	45,697	5.00 %	
盛凌投資股份 有限公司	諧永投資股份有限 公司	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	48,736	453,828	3.03 %	453,828	3.03 %	
盛凌投資股份 有限公司	金佑科技股份有限 公司	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	127	101	2.49 %	101	6.08 %	
盛凌投資股份 有限公司	精匠微電子股份有 限公司	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	650	3,485	17.81 %	3,485	17.81 %	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣 之公司	有價證券 種類及 名稱	帳列 科目	交易 對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面 成本	處分 損益	單位數	金額
本公司	統一強棒貨幣市場基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	28,354	476,558	40,805	690,220	61,664	1,042,764	1,039,778	2,986	7,495	127,000 (註)
本公司	元大得寶貨幣市場基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	元大投信	-	28,039	339,029	8,233	100,000	36,272	440,779	439,029	1,749	-	- (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳附註十三(一)。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額 (註3)	佔總應收 (付)票 據、帳款 之比率	
本公司	合泰	本公司之子公司	銷貨	1,343,653	27 %	月結120天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	64,023	8 %	註1
本公司	芯群	本公司之子公司	銷貨	792,360	16 %	月結120天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	448,424	57 %	註1
本公司	欣宏	合併公司之關聯 企業	銷貨	258,936	5 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	54,175	7 %	
本公司	金科	本公司之子公司	銷貨	173,727	4 %	月結120天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	5,220	1 %	註1
本公司	Truetek	合併公司之關聯 企業	銷貨	167,083	3 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	27,921	4 %	
本公司	Tech Wave	合併公司之關聯 企業	銷貨	160,576	3 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	46,581	6 %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	148,526	3 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	24,835	3 %	註1
合泰	Anchip	合併公司之子公司	銷貨	285,044	14 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	68,609	23 %	註1
合泰	New Wave	合併公司之關聯 企業	銷貨	140,155	7 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	9,403	4 %	
合泰	優方東莞	合併公司之子公司	銷貨	466,351	24 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	63,344	21 %	註1
合泰	Newtek	合併公司之關聯 企業	銷貨	113,176	6 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	27,585	8 %	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額 (註3)	佔總應收 (付)票 據、帳款 之比率	
合泰	欣宏	合併公司之關聯 企業	銷貨	224,014	11 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	50,962	18 %	
芯群	Crown Rich	合併公司之關聯 企業	銷貨	126,140	10 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	22,865	7 %	
芯群	Newwave	合併公司之關聯 企業	銷貨	140,794	11 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	57,653	15 %	
芯群	欣宏	合併公司之關聯 企業	銷貨	276,895	23 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	93,841	29 %	
優方東 莞	Crown Rich	合併公司之關聯 企業	銷貨	175,844	36 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	26,811	29 %	
Anchip	欣宏	合併公司之關聯 企業	銷貨	140,008	42 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著 不同	15,648	15 %	

註1：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中消除。

註2：僅就認列收益及資產之公司作單向表達。

註3：應收票據及帳款餘額含備抵損失。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項 之 公 司	交易對象 名 稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 損失金額
					金 額	處理方式		
本公司	芯群	子公司	450,059	2.07	-	即期收款	81,948 (註)	1,635

註1：係截至民國一一二年二月十日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9.從事衍生性商品交易：無。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科 目	金 額	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
0	本公司	合泰	母公司對子公司	銷貨收入	1,343,653	月結120天	22 %
0	本公司	合泰	母公司對子公司	應收帳款	64,023	月結120天	1 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	銷貨收入	792,360	月結120天	13 %
0	本公司	芯群	母公司對子公司	應收帳款	448,424	月結120天	7 %
0	本公司	金科	母公司對子公司	銷貨收入	173,727	月結120天	3 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	148,526	月結60天	2 %
0	合泰	Anchip	子公司對子公司	銷貨收入	285,044	月結60天	5 %
0	合泰	Anchip	子公司對子公司	應收帳款	68,609	月結60天	1 %
0	合泰	悠建	子公司對子公司	銷貨收入	92,815	月結60天	2 %

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
0	合泰	優方東莞	子公司對子公司	銷貨收入	466,351	月結60天	8 %
0	合泰	優方東莞	子公司對子公司	應收帳款	63,344	月結60天	1 %

註1：僅揭露銷貨及應收帳款佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易，其相對之進貨及應付款項不再贅述。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：應收帳款及票據餘額含備抵損失。

(二)轉投資事業相關資訊：

合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	665,449	665,449	22,053	100.00 %	1,341,014	100.00 %	61,814	61,814 註2	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	193,416	100.00 %	(22,601)	(22,601) 註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	23,034	100.00 %	1,556	1,556 註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA), INC.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	23,034	100.00 %	1,556	註1,2	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	1,224,832	100.00 %	62,178	62,178 註2	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	9,733	9,733	300	40.00 %	41,409	40.00 %	(11,515)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd.(BVI)	B.V.I.	投資海外各項投資	9,473	9,473	300	100.00 %	16,436	100.00 %	1,894	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	ForIC Electronics HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術支持與諮詢服務	866	866	200	100.00 %	34,424	100.00 %	5,244	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	70,189	40.00 %	6,019	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Truetek Technology Ltd.	Truetek Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機器件的技術研發與諮詢服務	34,652	34,652	8,000	100.00 %	89,547	100.00 %	13,623	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	31,124	31,124	1,045	40.00 %	52,276	40.00 %	5,939	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Quanding Technology Holding Ltd.	Quanding Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機蕊片的技術研發與諮詢服務	2,137	2,137	500	100.00 %	24,494	100.00 %	225	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,758	3,758	180	40.00 %	67,829	40.00 %	12,451	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Santek Holdings Ltd.	Santek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	8,662	2,000	100.00 %	92,934	100.00 %	23,133	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,470	3,470	800	40.00 %	6,909	40.00 %	(73,061)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newwave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	24,784	24,784	800	40.00 %	90,908	40.00 %	23,551	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	8,105	8,105	1,501	40.61 %	77,569	40.61 %	(14,271)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Newtek Electronics Ltd.	Newtek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	8,662	2,000	100.00 %	22,045	100.00 %	3,308	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	2,641	2,641	80	40.00 %	141,239	40.00 %	23,396	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	7,039	7,039	1	40.00 %	(140)	40.00 %	(7,209)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	2,937	2,937	1	60.00 %	33,297	60.00 %	28,298	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	26,835	40.00 %	3,058	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	滙達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	9,115	33.33 %	1,639	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項投資	6,405	6,405	1	40.00 %	10,102	40.00 %	(1,401)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	19,808	20,965	5	75.00 %	47,949	80.00 %	23,221	註1、2	本公司之孫公司
Best Health Electronics Corporation	Best Health Electronics HK Limited	香港	電子元器件與單片機芯片之技術支持與諮詢服務	1,299	1,299	300	100.00 %	18,505	100.00 %	14,897	註1、2	本公司之孫公司投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Best Power Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	-	8,844	-	- %	-	100.00 %	72	註1、2、3	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Driver-Tech Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,753	6,753	2	80.00 %	18,893	80.00 %	10,807	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Module-Tech Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	12,426	12,426	3	100.00 %	13,470	100.00 %	144	註1、2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Risingtek Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	-	15,603	-	- %	-	40.00 %	(97)	註1、4	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務	3	3	6	0.10 %	3	0.10 %	1,237	(1) 註2	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	429,826	42,983	100.00 %	794,353	100.00 %	68,910	68,910 註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,941	95,941	7,880	40.00 %	142,845	40.00 %	66,713	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	59,204	59,204	2,000	100.00 %	138,567	100.00 %	10,254	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	79,680	79,680	2,000	100.00 %	159,923	100.00 %	56,247	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	18,531	36.88 %	16,193	註1、2	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
盛凌投資 股份有限 公司	鈺威科技股份 有限公司	新北市	一般投資業	11,191	15,113	1,119	22.38 %	24,618	22.38 %	55,916	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資 股份有限 公司	優方科技股份 有限公司	台北市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 腦及其週邊設 備製造、資訊 軟體服務及國 際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	20,102	40.00 %	16,193	註1、2	本公司之 孫公司
優方科技 股份有限 公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項 事業	6,140	6,140	200	100.00 %	41,416	100.00 %	9,872	註1、2	本公司之 孫公司投 資之子公司
盛凌投資 股份有限 公司	天字微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 信器材批發零 售、智慧財產 權業、資訊軟 體服務及國際 貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	20.00 %	662	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資 股份有限 公司	芯通科技股份 有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、國 際貿易業及資 訊軟體服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	21,613	100.00 %	6,539	註1、2	本公司之 孫公司
芯通科技 股份有限 公司	Bestcomm RF Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項 事業	14,054	14,054	30	100.00 %	13,841	100.00 %	1,813	註1、2	本公司之 孫公司投 資之子公司
盛凌投資 股份有限 公司	倍創科技股份 有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發、無店面 零售業、國際 貿易業	105,000	25,000	10,500	100.00 %	95,521	100.00 %	(3,508)	註1、2	本公司之 孫公司
倍創科技 股份有限 公司	Best Modules Corp.	B.V.I.	投資海外各項 事業	28,236	10,789	7	100.00 %	12,124	100.00 %	1,086	註1、2	本公司之 孫公司投 資之子公司
盛凌投資 股份有限 公司	Holtek Semiconductor (India)Private Limited	INDIA	電子元器件及 單片機蕊片之 技術支持與諮 詢服務業務	2,945	2,945	6,479	99.90 %	2,313	99.90 %	(1,237)	註1、2	本公司之 孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

註3：Best Power Electronics Corporation 於民國一一年十一月進行清算並退回股款。

註4：Risingtek Corporation 於民國一一年三月進行清算並退回股款。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	322,726	(註1)	290,645	-	-	290,645	(45,513)	100 %	100 %	(45,513) (註5)	417,982	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路及電子元件及單片機芯片的批發與進出口業務並提供技術諮詢服務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	87,295	100 %	100 %	87,295 (註5)	838,579	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(44,468)	40 %	40 %	(17,787)	11,803	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元件及單片機器件的技術支持與諮詢服務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	(11,188)	40 %	40 %	(4,475)	75,063	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	21,479	40 %	40 %	8,591 (註5)	184,757	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(18,636)	40 %	40 %	(7,454)	30,703	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	1,893	40 %	40 %	757	16,042	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	65,860	(註1)	2,647	-	-	2,647	(17,563)	40.61 %	40.61 %	(7,132) (註5)	131,130	-
信霖微智電子(上海)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	(7,654)	40 %	40 %	(3,061)	79,617	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	18,446	(註1)	1,964	-	-	1,964	22,954	40 %	40 %	9,182 (註5)	341,039	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元件及單片機器件技術支持與諮詢服務業務	21,670	(註1)	1,600	-	-	1,600	5,939	40 %	40 %	2,376	79,878	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	(22,605)	100 %	100 %	(22,605) (註5)	193,375	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(7,197)	40 %	40 %	(2,879)	(1,375)	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	28,311	60 %	60 %	16,987	51,165	-
集芯源電子科技(深圳)有限公司	電子元件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	11,974	(註1)	-	-	-	-	(1,416)	40 %	40 %	(567)	23,953	-
悠健電子(東莞)有限公司	電子元件及單片機芯片的技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	8,305	75 %	80 %	6,229	40,528	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	13,634	(註1)	9,392	-	-	9,392	1,773	100 %	100 %	1,773	13,071	-
優方科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	4,285	(註1)	-	-	-	-	9,948	54.75 %	54.75 %	5,446 (註5)	39,241	-
芯動微電子(杭州)有限公司	集成電路、電子元件、單片機芯片的技術開發、技術服務及銷售	6,361	(註1)	-	-	-	-	10,803	80.00 %	80.00 %	8,642	20,851	-
易智芯科技(廈門)有限公司	設計、開發、生產集成電路、電子元件及單片機芯片及其所需的組件及軟件產品，並提供相關技術諮詢及售後服務	10,573	(註1)	-	-	-	-	141	100.00%	100.00%	141	11,012	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
倍易創新電子商務(廈門)有限公司	從事互聯網銷售、集成電路、電子元器件、單片機芯片及其所需的組件及軟件產品的技術開發、技術服務及銷售	28,307	(註1)	10,806	17,501	-	28,307	1,126	100.00%	100.00%	1,126	12,129	-

2.轉投資大陸地區限額：

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額(註4)
盛群	658,752 (美金21,851千元)	825,634 (美金26,929千元)	2,807,398
倍創	28,307 (美金962千元)	11,997 (美金391千元)	80,000
芯通	9,392 (美金314千元)	13,962 (美金455千元)	80,000
優方	-	4,378 (美金143千元)	80,000

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；盛群經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計670,033千元(美金21,854千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計155,601千元(美金5,075千元)；芯通經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計9,612千元(美金314千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計4,350千元(美金141千元)；優方經核准之金額係核准第三地區之盈餘轉增資金額計4,378千元(美金143千元)；倍創經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計11,997千元(美金391千元)及民國一一年十二月自台灣匯出17,501千元(美金571千元)尚待經經濟部投審會核備。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。本公司之限額計算為淨值4,678,997千元 $\times 60\% = 2,807,398$ 千元；因芯通、優方及倍創符合在大陸地區從事投資或技術合作審查原則規定屬中小企業標準，限額為80,000千元或淨值其較高者。

註5：係依同期間經台灣母公司會計師查核之財務報告認列投資損益。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一一年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

(四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79 %

十四、部門資訊

(一)一般性資訊及部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報告一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	111年度		110年度	
	金額	佔當期 營業收入 淨額之%	金額	佔當期 營業收入 淨額之%
積體電路銷貨收入	\$ 5,989,804	99	7,084,106	99
設計及燒錄收入	26,164	1	43,644	1
	<u>\$ 6,015,968</u>	<u>100</u>	<u>7,127,750</u>	<u>100</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

	111年度		110年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
來自外部客戶收入：				
中國	\$ 4,044,393	67	5,593,338	78
台灣	739,501	12	771,966	11
其他國家	1,232,074	21	762,446	11
	<u>\$ 6,015,968</u>	<u>100</u>	<u>7,127,750</u>	<u>100</u>
	111.12.31		110.12.31	
	金 額	佔當期總 資產之%	金 額	佔當期總 資產之%
非流動資產：				
台灣	\$ 226,067	3	254,794	3
中國	311,771	5	257,549	3
其他國家	1,894	-	2,018	-
	<u>\$ 539,732</u>	<u>8</u>	<u>514,361</u>	<u>6</u>

(四)主要客戶

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	111年度		110年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
欣宏	<u>\$ 1,156,587</u>	<u>19</u>	<u>1,229,732</u>	<u>17</u>

附錄二：

111 年度個體財務報告及會計師查核報告

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群半導體股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳個體財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列－關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函證發函詢證；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群半導體股份有限公司是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群半導體股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成盛群半導體股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群半導體股份有限公司民國一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂倩慧



鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號
民國一一年二月十六日

盛祥牛車水股份有限公司

資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31			111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產：					負債及權益：				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 214,847	3	258,575	3	2150 應付票據	\$ 104,072	2	235,294	3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動					2170 應付帳款	524,280	8	578,795	7
(附註六(二))					2180 應付帳款－關係人(附註七)	8,136	-	8,092	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	242,418	4	970,068	12	2201 應付薪資及獎金	484,906	7	567,312	7
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	84,371	1	89,525	1	2230 本期所得稅負債	46,138	1	423,029	5
130X 存貨(附註六(四))	697,794	11	956,945	12	租賃負債－流動(附註六(十))	11,471	-	14,880	-
1476 其他金融資產－流動(附註六(五)、七及八)	1,332,326	20	473,526	6	預收款項	6,896	-	47,017	-
1479 其他流動資產－其他	633,858	10	2,054,567	25	其他流動負債－其他(附註七)	211,630	3	141,565	2
	33,106	-	34,164	-		1,397,529	21	2,015,984	24
	3,238,720	49	4,837,370	59					
非流動資產：					非流動負債：				
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	3,005,542	46	2,939,919	36	遞延所得稅負債(附註六(十二))	415,651	6	393,448	5
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	127,558	2	136,830	2	租賃負債－非流動(附註六(十))	69,767	1	80,988	1
1755 使用權資產(附註六(八))	79,295	1	94,399	1	淨確定福利負債－非流動(附註六(十一))	48,497	1	81,503	1
1780 無形資產(附註六(九))	22,384	-	38,630	-	存入保證金	16,120	-	26,080	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	146,734	2	201,647	2		550,035	8	582,019	7
1900 其他非流動資產	6,328	-	6,060	-		1,947,564	29	2,598,003	31
	3,387,841	51	3,417,485	41	負債總計				
					權益(附註六(十三))：				
					普通股股本	2,261,682	34	2,261,682	27
					資本公積	142,309	2	142,309	2
					保留盈餘	2,072,434	32	2,794,950	34
					其他權益	202,572	3	457,911	6
					權益總計	4,678,997	71	5,656,852	69
					負債及權益總計	6,626,561	100	8,254,855	100
	\$ 6,626,561	100	8,254,855	100					
資產總計									
	\$ 6,626,561	100	8,254,855	100					



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通

(請詳閱後附個體財務報告附註)

盛群半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,891,641	100	6,631,977	100
5000	營業成本(附註六(四)、(九)、(十一)、(十五)、七及十二)	2,761,967	57	3,174,352	48
	營業毛利	2,129,674	43	3,457,625	52
5910	未實現銷貨利益之變動	(234,666)	(5)	564,276	8
	已實現營業毛利	2,364,340	48	2,893,349	44
	營業費用(附註六(九)、(十一)、(十五)及十二)：				
6100	推銷費用	129,091	2	154,728	3
6200	管理費用	237,619	5	311,378	5
6300	研究發展費用	841,037	17	1,013,841	15
6450	預期信用減損損失(附註六(三))	35,354	1	-	-
		1,243,101	25	1,479,947	23
	營業淨利	1,121,239	23	1,413,402	21
	營業外收入及支出：				
7020	其他利益及損失(附註六(十七)及七)	43,758	1	348,186	5
7070	採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	171,856	4	757,278	12
7100	利息收入	13,437	-	5,513	-
7510	利息費用(附註六(十))	(1,916)	-	(1,216)	-
		227,135	5	1,109,761	17
	稅前淨利	1,348,374	28	2,523,163	38
7950	所得稅費用(附註六(十二))	242,000	5	479,099	7
	本期淨利	1,106,374	23	2,044,064	31
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	10,314	-	(3,487)	-
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	(283,835)	(6)	196,601	3
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	2,063	-	(697)	-
	不重分類至損益之項目合計	(275,584)	(6)	193,811	3
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8381	採用權益法認列子公司及關聯企業之國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	35,620	1	10,635	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	7,124	-	2,127	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	28,496	1	8,508	-
8300	本期其他綜合損益	(247,088)	(5)	202,319	3
	本期綜合損益總額	\$ 859,286	18	2,246,383	34
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.89		9.04	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.83		8.93	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司

權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益 透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現評 估損益	合 計	權益總計
					未分配 盈餘	合 計				
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	732,672	31,662	1,020,669	1,785,003	(66,714)	319,516	252,802	4,441,796
本期淨利	-	-	-	-	2,044,064	2,044,064	-	-	-	2,044,064
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,790)	(2,790)	8,508	196,601	205,109	202,319
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,041,274	2,041,274	8,508	196,601	205,109	2,246,383
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	102,065	-	(102,065)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(29,020)	29,020	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(83,705)	-	(947,622)	(1,031,327)	-	-	-	(1,031,327)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	751,032	2,642	2,041,276	2,794,950	(58,206)	516,117	457,911	5,656,852
本期淨利	-	-	-	-	1,106,374	1,106,374	-	-	-	1,106,374
本期其他綜合損益	-	-	-	-	8,251	8,251	28,496	(283,835)	(255,339)	(247,088)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,114,625	1,114,625	28,496	(283,835)	(255,339)	859,286
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	204,128	-	(204,128)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,837,141)	(1,837,141)	-	-	-	(1,837,141)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	955,160	2,642	1,114,632	2,072,434	(29,710)	232,282	202,572	4,678,997

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司

現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,348,374	2,523,163
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	47,736	44,432
攤銷費用	61,205	68,045
預期信用減損損失	35,354	-
利息費用	1,916	1,216
利息收入	(13,437)	(5,513)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(171,856)	(757,278)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	(234,666)	564,276
其他不影響現金流量之損費淨額	9,159	5,310
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	724,359	(187,460)
應收票據及帳款(含關係人)	228,951	(88,754)
存貨	(864,178)	(89,529)
其他營業資產	732	(11,128)
應付票據及帳款(含關係人)	(185,693)	175,242
預收款項	(40,121)	43,161
淨確定福利負債	(23,182)	(12,735)
其他營業負債	(13,016)	298,241
營運產生之現金之流入	911,637	2,570,689
收取之利息	11,607	4,876
收取之股利	92,684	15,390
支付之利息	(1,241)	(1,216)
支付之所得稅	(550,962)	(97,995)
營業活動之淨現金流入	463,725	2,491,744
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(189,618)
取得不動產、廠房及設備	(23,097)	(42,338)
存出保證金減少(增加)	36	(45)
取得無形資產	(44,848)	(44,974)
其他金融資產減少(增加)	1,422,895	(1,414,289)
其他非流動資產增加	(445)	(454)
投資活動之淨現金流入(出)	1,354,541	(1,691,718)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	(9,960)	14,095
租賃本金償還	(14,893)	(12,271)
發放股東現金股利	(1,837,141)	(1,031,327)
籌資活動之淨現金流出	(1,861,994)	(1,029,503)
本期現金及約當現金減少數	(43,728)	(229,477)
期初現金及約當現金餘額	258,575	488,052
期末現金及約當現金餘額	\$ 214,847	258,575

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一一一年度及一一〇年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一一二年二月十六日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

本公司自民國一一一年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則，且對個體財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第十六號之修正「不動產、廠房及設備－達到預定使用狀態前之價款」
- 國際會計準則第三十七號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」
- 國際財務報導準則2018-2020週期之年度改善
- 國際財務報導準則第三號之修正「對觀念架構之引述」

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

本公司評估適用下列自民國一一二年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則，將不致對個體財務報告造成重大影響。

- 國際會計準則第一號之修正「會計政策之揭露」
- 國際會計準則第八號之修正「會計估計值之定義」
- 國際會計準則第十二號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

本公司預期下列尚未認可之新發布及修正準則不致對個體財務報告造成重大影響。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

- 國際財務報導準則第十號及國際會計準則第二十八號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第十七號「保險合約」及國際財務報導準則第十七號之修正
- 國際會計準則第一號之修正「將負債分類為流動或非流動」
- 國際會計準則第一號之修正「具合約條款之非流動負債」
- 國際財務報導準則第十七號之修正「初次適用IFRS 17及IFRS 9比較資訊」
- 國際財務報導準則第十六號之修正「售後租回交易之規定」

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」（以下稱編製準則）編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1) 依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；及
- (2) 淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2. 功能性貨幣及表達貨幣

本公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三) 外幣

1. 外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。於後續每一報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2. 國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

當處分國外營運機構致喪失控制、聯合控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

對國外營運機構之貨幣性應收或應付項目，若尚無清償計畫且不可能於可預見之未來予以清償時，其所產生之外幣兌換損益視為對該國外營運機構淨投資之一部分而認列為其他綜合損益。

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具

應收帳款及所發行之債務證券原始係於產生時認列。所有其他金融資產及金融負債原始係於本公司成為金融工具合約條款之一方時認列。非透過損益按公允價值衡量之金融資產(除不包含重大財務組成部分之應收帳款外)或金融負債原始係按公允價值加計直接可歸屬於該取得或發行之交易成本衡量。不包含重大財務組成部分之應收帳款原始係按交易價格衡量。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

1.金融資產

金融資產之購買或出售符合慣例交易者，本公司對以相同方式分類之金融資產，其所有購買及出售一致地採交易日或交割日會計處理。

原始認列時，金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產或透過損益按公允價值衡量之金融資產。本公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始自下一個報導期間之首日起重分類所有受影響之金融資產。

(1)按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

該等資產後續以原始認列金額加減計採有效利息法計算之累積攤銷數，並調整任何備抵損失之攤銷後成本衡量。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。

(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬上述按攤銷後成本衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。本公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量條件之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

該等資產後續按公允價值衡量，其淨利益或損失(包含利息收入)係認列為損益。

持有供交易及以公允價值基礎管理並評估績效之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。

(3)金融資產減損

本公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、應收票據及應收帳款、存出保證金及其他金融資產等)之預期信用損失認列備抵損失。

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，本公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據本公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若合約款項逾期超過九十天，本公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過一百八十天，或借款人不太可能履行其信用義務支付全額款項予本公司時，本公司視為該金融資產發生違約。

若金融工具之信用風險評等相當於全球所定義之「投資等級」(為標準普爾之投資等級BBB-、穆迪之投資等級Baa3或中華信評之投資等級twA，或高於該等級者)，本公司視為該債務證券之信用風險低。

存續期間預期信用損失係指金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

十二個月預期信用損失係指金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失(或較短期間，若金融工具之預期存續期間短於十二個月時)。

衡量預期信用損失之最長期間為本公司暴露於信用風險之最長合約期間。

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即本公司依據合約可收取之現金流量與本公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除。

當本公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。對公司戶，本公司係以是否合理預期可回收之基礎個別分析沖銷之時點及金額。本公司預期已沖銷金額將不會重大迴轉。然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合本公司回收逾期金額之程序。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業，或既未移轉亦未保留所有權之幾乎所有風險及報酬且未保留該金融資產之控制時，始將金融資產除列。

本公司簽訂移轉金融資產之交易，若保留已移轉資產所有權之所有或幾乎所有風險及報酬，則仍持續認列於資產負債表。

2.金融負債

(1)負債之分類

本公司發行之債務係依據合約協議之實質與金融負債定義分類為金融負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)金融負債

金融負債係分類為攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。金融負債若屬持有供交易、衍生工具或於原始認列時指定，則分類為透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係以公允價值衡量，且相關淨利益及損失，包括任何利息費用，係認列於損益。

其他金融負債後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。利息費用及兌換損益係認列於損益。除列時之任何利益或損失亦係認列於損益。

(3)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。當金融負債條款修改且修改後負債之現金流量有重大差異，則除列原金融負債，並以修改後條款為基礎按公允價值認列新金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額(包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債)間之差額認列為損益。

(4)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司目前於法律上有可執行之權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(七)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(八)投資關聯企業

關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

個體財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，僅在非關係人投資者對關聯企業之權益範圍內，認列於企業財務報表。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

本公司自其投資不再為關聯企業之日起停止採用權益法，並按公允價值衡量保留權益，保留權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，認列於當期損益。

(九)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備項目係依成本(包括資本化之借款成本)減累計折舊及任何累計減損衡量。

不動產、廠房及設備之重大組成部分耐用年限不同時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分利益或損失係認列於損益。

2.後續成本

後續支出僅於其未來經濟效益很有可能流入本公司時始予以資本化。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值計算，並採直線法於每一組成部分之估計耐用年限內認列於損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築：20~30年

(2)機器設備：3~5年

(3)其他設備：2~8年

本公司於每一報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，並於必要時適當調整。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十一)租賃

本公司係於合約成立日評估合約是否係屬或包含租賃，若合約轉讓對已辨認資產之使用之控制權一段時間以換得對價，則合約係屬或包含租賃。

1.承租人

本公司於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債，使用權資產係以成本為原始衡量，該成本包含租賃負債之原始衡量金額，調整租賃開始日或之前支付之任何租賃給付，並加計所發生之原始直接成本及為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點或標的資產之估計成本，同時減除收取之任何租賃誘因。

使用權資產後續於租賃開始日至使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者以直線法提列折舊。此外，本公司定期評估使用權資產是否發生減損並處理任何已發生之減損損失，並於租賃負債發生再衡量的情況下配合調整使用權資產。

租賃負債係以租賃開始日尚未支付之租賃給付之現值為原始衡量。若租賃隱含利率容易確定，則折現率為該利率，若並非容易確定，則使用本公司之增額借款利率。一般而言，本公司係採用其增額借款利率為折現率。

計入租賃負債衡量之租賃給付包括：

- (1)固定給付，包括實質固定給付；
- (2)取決於某項指數或費率之變動租賃給付，採用租賃開始日之指數或費率為原始衡量；
- (3)預期支付之殘值保證金額；及
- (4)於合理確定將行使購買選擇權或租賃終止選擇權時之行使價格或所須支付之罰款。

租賃負債後續係以有效利息法計提利息，並於發生以下情況時再衡量其金額：

- (1)用以決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動；
- (2)預期支付之殘值保證金額有變動；
- (3)標的資產購買選擇權之評估有變動；
- (4)對是否行使延長或終止選擇權之估計有所變動，而更改對租賃期間之評估；
- (5)租賃標的、範圍或其他條款之修改。

租賃負債因前述用以決定租賃給付之指數或費率變動、殘值保證金額有變動以及購買、延長或終止選擇權之評估變動而再衡量時，係相對應調整使用權資產之帳面金額，並於使用權資產之帳面金額減至零時，將剩餘之再衡量金額認列於損益中。

對於減少租賃範圍之租賃修改，則係減少使用權資產之帳面金額以反映租賃之部分或全面終止，並將其與租賃負債再衡量金額間之差額則認列於損益中。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司將不符合投資性不動產定義之使用權資產及租賃負債分別以單行項目表達於資產負債表中。

針對公務車及員工宿舍租賃之短期租賃及低價值標的資產租賃，本公司選擇不認列使用權資產及租賃負債，而係將相關租賃給付依直線基礎於租賃期間內認列為費用。

2.出租人

本公司為出租人之交易，係於租賃成立日將租賃合約依其是否移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬分類，若是則分類為融資租賃，否則分類為營業租賃。於評估時，本公司考量包括租賃期間是否涵蓋標的資產經濟年限之主要部分等相關特定指標。

若協議包含租賃及非租賃組成部分，本公司使用國際財務報導準則第十五號之規定分攤合約中之對價。

(十二)無形資產

1.認列及衡量

研究活動相關支出於發生時認列為損益。

發展支出僅於其能可靠衡量、產品或流程之技術或商業可行性已達成、未來經濟效益很有可能流入本公司，及本公司意圖且具充足資源以完成該發展且加以使用或出售該資產時，始予以資本化。其他發展支出則於發生時認列於損益。原始認列後，資本化之發展支出以其成本減除累計攤銷及累計減損後之金額衡量。

本公司取得其他有限耐用年限之無形資產，係以成本減除累計攤銷與累計減損後之金額衡量。

2.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產之未來經濟效益時始予以資本化。

3.攤銷

攤銷係依資產成本減除估計殘值計算，並自無形資產達可供使用狀態起，按直線法於其估計耐用年限內認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)電腦軟體：1~5年

(2)專門技術：1~5年

本公司於每一報導日檢視無形資產之攤銷方法、耐用年限及殘值，並於必要時，適當調整。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十三)非金融資產減損

本公司於每一報導日評估是否有跡象顯示非金融資產(除存貨及遞延所得稅資產外)之帳面金額可能有減損。若有任一跡象存在，則估計該資產之可回收金額。

為減損測試之目的，係將現金流入大部分獨立於其他個別資產或資產群組之現金流入之一組資產作為最小可辨認資產群組。企業合併取得之商譽係分攤至預期可自合併綜效受益之各現金產生單位或現金產生單位群組。

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則認列減損損失。

商譽以外之非金融資產僅在不超過該資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額(減除折舊或攤銷)之範圍內迴轉。

(十四)負債準備

負債準備之認列係因過去事件而負有現時義務，使本公司未來很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計。負債準備係以反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險評估之稅前折現率予以折現，折現之攤銷則認列為利息費用。

(十五)收入之認列

客戶合約之收入

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。本公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。本公司依主要收入項目說明如下：

1.銷售商品

本公司研究、開發、生產、製造及銷售各種積體電路。本公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售訂單接受產品，驗收條款已失效，或本公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

本公司於交付商品時認列應收帳款，因本公司在該時點具無條件收取對價之權利。

2.財務組成部分

本公司預期所有客戶合約移轉商品或勞務予客戶之時間與客戶為該商品或勞務付款之時間間隔皆不超過一年，因此，本公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

(十六)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供服務期間內認列為費用。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.確定福利計畫

本公司對確定福利計畫之淨義務係分別針對各項福利計畫以員工當期或以前期間服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算，並減除任何計畫資產之公允價值。

確定福利義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司可能有利時，認列資產係以從該計畫退還提撥金或對該計畫減少未來提撥金之形式可得之任何經濟效益之現值為限。計算經濟效益現值時，係考量任何最低資金提撥要求。

淨確定福利負債之再衡量數包含精算損益、計畫資產報酬(不包括利息)，及資產上限影響數之任何變動(不包括利息)係立即認列於其他綜合損益，並累計於保留盈餘。本公司決定淨確定福利負債之淨利息費用，係使用年度報導期間開始時所決定之淨確定福利負債及折現率。確定福利計畫之淨利息費用及其他費用係認列於損益。

計畫修正或縮減時，所產生與前期服務成本或縮減利益或損失相關之福利變動數，係立即認列為損益。本公司於清償發生時，認列確定福利計畫之清償損益。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係於服務提供時認列為費用。若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十七)所得稅

所得稅包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括依據當年度課稅所得(損失)計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅或應收退稅款之調整。其金額係按報導日之法定稅率或實質性立法之稅率衡量預期將支付或收取款項之最佳估計值。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期暫時性差異迴轉時之稅率衡量，採用報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(1)同一納稅主體；或

(2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減；或在變成很有可能有足夠課稅所得之範圍內迴轉原已減少之金額。

(十八)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

本公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。本公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

本公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，本公司係於報導日認列該移轉。

衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十八)金融工具。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	111.12.31	110.12.31
現金及活期存款	\$ 138,197	44,818
定期存款	76,650	213,757
	<u>\$ 214,847</u>	<u>258,575</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	111.12.31	110.12.31
受益憑證	<u>\$ 242,418</u>	<u>970,068</u>

1.敏感度分析、公允價值及市場風險資訊請詳附註六(十八)。

2.上述金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

(三)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	111.12.31	110.12.31
應收票據	\$ 342	8,082
應收帳款	85,425	88,836
應收關係人款	<u>739,145</u>	<u>956,945</u>
	824,912	1,053,863
減：備抵損失	<u>(42,747)</u>	<u>(7,393)</u>
	<u>\$ 782,165</u>	<u>1,046,470</u>

民國一一〇年一月一日應收票據及帳款淨額(含關係人)為957,716千元。

本公司針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。本公司應收款項之預期信用損失分析如下：

	111.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 751,882	0.3%-1.5%	3,709
逾期90天以下	37,333	8.95%	3,341
逾期90天以上	<u>35,697</u>	100%	<u>35,697</u>
合計	<u>\$ 824,912</u>		<u>42,747</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	110.12.31		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,051,102	0.5%~1.5%	7,255
逾期90天以下	2,761	5%	138
合計	<u>\$ 1,053,863</u>		<u>7,393</u>

本公司應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	111年度	110年度
期初餘額	\$ 7,393	7,393
認列之減損損失	35,354	-
期末餘額	<u>\$ 42,747</u>	<u>7,393</u>

(四)存貨

	111.12.31	110.12.31
原料及物料	\$ 549,622	73,645
在製品	469,605	190,085
製成品及商品	313,099	209,796
	<u>\$ 1,332,326</u>	<u>473,526</u>

營業成本組成明細如下：

	111年度	110年度
銷貨成本	\$ 2,756,589	3,167,797
報廢成本	5,378	6,555
	<u>\$ 2,761,967</u>	<u>3,174,352</u>

上述本公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)其他金融資產－流動

	111.12.31	110.12.31
定期存款(三個月以上)	\$ 619,500	2,042,400
受限制銀行存款(附註八)	8,818	8,813
其他	5,540	3,354
	<u>\$ 633,858</u>	<u>2,054,567</u>

本公司於民國一一一年度及一一〇年度，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十八)。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(六)採用權益法之投資

本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
子公司	\$ 3,576,652	3,745,695
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(571,110)</u>	<u>(805,776)</u>
	<u><u>\$ 3,005,542</u></u>	<u><u>2,939,919</u></u>

子公司相關資訊，請參閱民國一一一年度合併財務報告。

本公司民國一一一年度及一一〇年度所享有子公司利益之份額分別為171,856千元及757,278千元。

上述本公司採用權益法之投資均未有提供作質押擔保之情形。

(七)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>機 器 設 備</u>	<u>其 他 設 備</u>	<u>總 計</u>
成本：					
民國111年1月1日餘額	\$ 26,676	279,253	229,209	56,006	591,144
增 添	-	833	20,980	1,284	23,097
減 少	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,096)</u>	<u>(2,429)</u>	<u>(5,525)</u>
民國111年12月31日餘額	<u><u>\$ 26,676</u></u>	<u><u>280,086</u></u>	<u><u>247,093</u></u>	<u><u>54,861</u></u>	<u><u>608,716</u></u>
民國110年1月1日餘額	\$ 26,676	272,261	219,822	60,012	578,771
增 添	-	6,992	28,408	6,938	42,338
減 少	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(19,021)</u>	<u>(10,944)</u>	<u>(29,965)</u>
民國110年12月31日餘額	<u><u>\$ 26,676</u></u>	<u><u>279,253</u></u>	<u><u>229,209</u></u>	<u><u>56,006</u></u>	<u><u>591,144</u></u>
累計折舊：					
民國111年1月1日餘額	\$ -	220,439	190,561	43,314	454,314
本期折舊	-	4,399	20,938	7,032	32,369
減 少	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3,096)</u>	<u>(2,429)</u>	<u>(5,525)</u>
民國111年12月31日餘額	<u><u>\$ -</u></u>	<u><u>224,838</u></u>	<u><u>208,403</u></u>	<u><u>47,917</u></u>	<u><u>481,158</u></u>
民國110年1月1日餘額	\$ -	216,421	192,031	44,187	452,639
本期折舊	-	4,018	17,551	10,071	31,640
減 少	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(19,021)</u>	<u>(10,944)</u>	<u>(29,965)</u>
民國110年12月31日餘額	<u><u>\$ -</u></u>	<u><u>220,439</u></u>	<u><u>190,561</u></u>	<u><u>43,314</u></u>	<u><u>454,314</u></u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機器設備	其他設備	總 計
帳面價值：					
民國111年12月31日	\$ 26,676	55,248	38,690	6,944	127,558
民國110年12月31日	\$ 26,676	58,814	38,648	12,692	136,830
民國110年1月1日	\$ 26,676	55,840	27,791	15,825	126,132

上述本公司不動產、廠房及設備均未有提供作質押擔保之情形。

(八)使用權資產

本公司承租土地與房屋及建築等之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房屋及 建 築	總 計
成本：			
民國111年1月1日餘額	\$ 67,341	41,233	108,574
增 添	263	-	263
民國111年12月31日餘額	\$ 67,604	41,233	108,837
民國110年1月1日餘額	\$ 67,341	41,006	108,347
增 添	-	22,749	22,749
減 少	-	(22,522)	(22,522)
民國110年12月31日餘額	\$ 67,341	41,233	108,574
使用權資產之折舊：			
民國111年1月1日餘額	\$ 9,183	4,992	14,175
本期折舊	3,069	12,298	15,367
民國111年12月31日餘額	\$ 12,252	17,290	29,542
民國110年1月1日餘額	\$ 6,122	17,783	23,905
本期折舊	3,061	9,731	12,792
減 少	-	(22,522)	(22,522)
民國110年12月31日餘額	\$ 9,183	4,992	14,175
帳面價值：			
民國111年12月31日	\$ 55,352	23,943	79,295
民國110年12月31日	\$ 58,158	36,241	94,399
民國110年1月1日	\$ 61,219	23,223	84,442

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(九)無形資產

本公司無形資產之成本及累計攤銷變動明細如下：

	電腦軟體	專利權	總 計
成本：			
民國111年1月1日餘額	\$ 202,218	106,759	308,977
增 添	44,848	-	44,848
減 少	(51,676)	(18,609)	(70,285)
重 分 類	111	-	111
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 195,501</u>	<u>88,150</u>	<u>283,651</u>
民國110年1月1日餘額	\$ 201,421	117,222	318,643
增 添	44,974	-	44,974
減 少	(44,177)	(10,463)	(54,640)
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 202,218</u>	<u>106,759</u>	<u>308,977</u>
攤銷：			
民國111年1月1日餘額	\$ 180,666	89,681	270,347
本期攤銷	50,788	10,417	61,205
減 少	(51,676)	(18,609)	(70,285)
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 179,778</u>	<u>81,489</u>	<u>261,267</u>
民國110年1月1日餘額	\$ 174,259	82,683	256,942
本期攤銷	50,584	17,461	68,045
減 少	(44,177)	(10,463)	(54,640)
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 180,666</u>	<u>89,681</u>	<u>270,347</u>
帳面價值：			
民國111年12月31日餘額	<u>\$ 15,723</u>	<u>6,661</u>	<u>22,384</u>
民國110年12月31日餘額	<u>\$ 21,552</u>	<u>17,078</u>	<u>38,630</u>
民國110年1月1日	<u>\$ 27,162</u>	<u>34,539</u>	<u>61,701</u>

無形資產之攤銷費用列報於綜合損益表之下列項目：

	111年度	110年度
營業成本	<u>\$ 23</u>	<u>561</u>
營業費用	<u>\$ 61,182</u>	<u>67,484</u>

上述本公司之無形資產均未有提供作質押擔保之情形。

(十)租賃負債

本公司租賃負債之帳面金額如下：

	111.12.31	110.12.31
流動	<u>\$ 11,471</u>	<u>14,880</u>
非流動	<u>\$ 69,767</u>	<u>80,988</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

到期分析請詳附註六(十八)。

認列於損益之金額如下：

	111年度	110年度
租賃負債之利息費用	\$ <u>1,241</u>	<u>1,216</u>
短期租賃之費用	\$ <u>579</u>	<u>738</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	\$ <u>440</u>	<u>442</u>

認列於現金流量表之金額如下：

	111年度	110年度
租賃之現金流出總額	\$ <u>17,153</u>	<u>14,667</u>

本公司承租土地、房屋及建築作為辦公處所，土地之租賃期間通常為二十年，辦公處所之租賃期間通常為二至二十年，部份租賃包含在租賃期間屆滿時得延長與原合約相同期間之選擇權。

部分土地及辦公室之租賃合約包含租賃延長之選擇權，該等合約係由各地區分別管理，因此所約定之個別條款及條件於公司內部有所不同。該等選擇權僅本公司具有可執行之權利，出租人並無此權利。在無法合理確定將行使可選擇之延長租賃期間之情況下，與選擇權所涵蓋期間之相關給付並不計入租賃負債。

另，科學園區管理局土地合約之租賃給付取決於當地公告地價，並加計各園區再投入之公共設施建設費經攤算後辦理調整。

(十一)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	111.12.31	110.12.31
確定福利義務現值	\$ 52,256	146,707
計畫資產之公允價值	(3,759)	(65,204)
淨確定福利負債	\$ <u>48,497</u>	<u>81,503</u>

本公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(1) 計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計3,759千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2) 確定福利義務現值之變動

本公司確定福利義務現值變動如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ 146,707	146,956
計畫支付之福利	(89,695)	(4,999)
當期服務成本及利息	1,027	436
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損失	(3,336)	(6,307)
— 因人口假設變動所產生之精算損失	-	3,844
— 因經驗變動所產生之精算損失	(2,447)	6,777
12月31日確定福利義務	<u>\$ 52,256</u>	<u>146,707</u>

(3) 計畫資產公允價值之變動

本公司確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 65,204	56,468
計畫支付之福利	(89,534)	(2,008)
利息收入	537	173
已提撥至計畫之金額	23,021	9,744
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計畫資產報酬(不含當期利息)	4,531	827
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 3,759</u>	<u>65,204</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(4)認列為損益之費用

本公司認列為損益之費用如下：

	111年度	110年度
淨確定福利負債之淨利息	\$ <u>490</u>	<u>263</u>
營業成本	\$ 31	17
推銷費用	34	19
管理費用	67	36
研究發展費用	<u>358</u>	<u>191</u>
	\$ <u>490</u>	<u>263</u>

(5)精算假設

本公司於財務報導結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	111.12.31	110.12.31
折現率	1.30 %	0.70 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

本公司預計於民國一一一年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為11,296千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為10年。

(6)敏感度分析

當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加0.1%	減少0.1%
111年12月31日		
折現率	\$ <u>(526)</u>	<u>534</u>
未來薪資成長率	\$ <u>488</u>	<u>(482)</u>
110年12月31日		
折現率	\$ <u>(1,521)</u>	<u>1,543</u>
未來薪資成長率	\$ <u>1,386</u>	<u>(1,371)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。本公司民國一一一年度及一一〇年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為30,591千元及26,604千元，已提撥至勞工保險局。

除上所述，民國一一一年度及一一〇年度國外分公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為559千元及544千元。

(十二)所得稅

1.所得稅費用

本公司所得稅費用明細如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 181,402	442,468
調整前期之當期所得稅	<u>(7,331)</u>	<u>14,969</u>
	<u>174,071</u>	<u>457,437</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	<u>67,929</u>	<u>21,662</u>
	<u>\$ 242,000</u>	<u>479,099</u>

本公司認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	<u>\$ 2,063</u>	<u>(697)</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
採用權益法認列子公司之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>\$ 7,124</u>	<u>2,127</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
稅前淨利	\$ 1,348,374	2,523,163
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	269,675	504,633
永久性差異調整	(14,929)	(20,612)
投資抵減之所得稅影響數	(5,381)	(19,878)
前期高低估	(7,331)	14,969
其他	(34)	(13)
	<u>\$ 242,000</u>	<u>479,099</u>

2. 遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	<u>110.1.1</u>	<u>認列於 損益表</u>	<u>認列於 其他綜合 損益表</u>	<u>110.12.31</u>	<u>認列於 損益表</u>	<u>認列於 其他綜合 損益表</u>	<u>111.12.31</u>
存貨跌價損失	\$ 12,000	-	-	12,000	-	-	12,000
未實現聯屬公司間利益	48,300	112,855	-	161,155	(46,933)	-	114,222
備抵呆帳超限數	-	-	-	-	6,898	-	6,898
淨確定福利負債	18,098	(2,494)	697	16,301	(4,539)	(2,063)	9,699
國外營運機構財務報表 換算之兌換損失	12,892	-	(2,127)	10,765	-	(7,124)	3,641
其他	2,289	(863)	-	1,426	(1,152)	-	274
	<u>\$ 93,579</u>	<u>109,498</u>	<u>(1,430)</u>	<u>201,647</u>	<u>(45,726)</u>	<u>(9,187)</u>	<u>146,734</u>

遞延所得稅負債

	<u>110.1.1</u>	<u>認列於 損益表</u>	<u>認列於 其他綜合 損益表</u>	<u>110.12.31</u>	<u>認列於 損益表</u>	<u>認列於 其他綜合 損益表</u>	<u>111.12.31</u>
採權益法認列之國外投 資利益	\$ 261,347	130,859	-	392,206	20,589	-	412,795
其他	941	301	-	1,242	1,614	-	2,856
	<u>\$ 262,288</u>	<u>131,160</u>	<u>-</u>	<u>393,448</u>	<u>22,203</u>	<u>-</u>	<u>415,651</u>

3. 本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇九年度。

(十三) 資本及其他權益

1. 股本

民國一一一年及一一〇年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2. 資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	111.12.31	110.12.31
普通股股本溢價	\$ 142,309	142,309

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1) 法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2) 特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會規定應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。

本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依金管會規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一一一年及一一〇年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

另，依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3) 盈餘分派

本公司民國一一〇年度及一〇九年度盈餘分派案，分別於民國一一一年五月二十四日及一一〇年七月十五日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	110年度		109年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ <u>8.1229</u>	<u>1,837,141</u>	<u>4.56</u>	<u>1,031,327</u>

(十四) 每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	111年度	110年度
基本每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>1,106,374</u>	<u>2,044,064</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>226,168</u>	<u>226,168</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>4.89</u>	<u>9.04</u>
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>1,106,374</u>	<u>2,044,064</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)：		
員工酬勞	<u>2,737</u>	<u>2,815</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>228,905</u>	<u>228,983</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.83</u>	<u>8.93</u>

(十五) 員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一・五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司民國一一一年度及一一〇年度員工酬勞估列金額分別為160,430千元及299,875千元，董事酬勞估列金額分別為19,099千元及35,499千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為299,875千元及35,499千元，與本公司董事會擬議內容並無差異，民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為125,414千元及13,735千元，皆係以現金發放，與實際分派情形並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十六)客戶合約之收入

1.收入之細分

	111年度	110年度
主要地區市場		
中國	\$ 2,994,507	5,182,619
臺灣	684,871	707,331
其他國家	1,212,263	742,027
	<u>\$ 4,891,641</u>	<u>6,631,977</u>
主要產品		
積體電路銷售	\$ 4,878,095	6,612,795
設計收入	13,546	19,182
	<u>\$ 4,891,641</u>	<u>6,631,977</u>

2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(十七)營業外收入及支出

本公司綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	111年度	110年度
外幣兌換淨利益	\$ 1,042	30,949
其他	42,716	317,237
	<u>\$ 43,758</u>	<u>348,186</u>

其他主要係本公司向客戶收取之服務費，民國一一一年度及一一〇年度金額分別為26,617千元及305,461千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十八)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

本公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一一年及一一〇年十二月三十一日佔本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為448,424千元及674,980千元，使本公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(3)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(三)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(五)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(本公司如何判定信用風險低之說明請詳附註四(六))。

2.流動性風險

金融負債之合約到期日分析如下：

	<u>帳面金額</u>	<u>合 約 現金流量</u>	<u>1年以內</u>	<u>超過1年</u>
111年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 636,488	636,488	636,488	-
應付薪資及獎金	484,906	484,906	484,906	-
應付費用(帳列其他流動負債)	64,144	64,144	64,144	-
存入保證金	16,120	16,120	-	16,120
租賃負債(流動及非流動)	81,238	90,907	12,513	78,394
	<u>\$ 1,282,896</u>	<u>1,292,565</u>	<u>1,198,051</u>	<u>94,514</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
110年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 822,181	822,181	822,181	-
應付薪資及獎金	567,312	567,312	567,312	-
應付費用(帳列其他流動負債)	91,131	91,131	91,131	-
存入保證金	26,080	26,080	-	26,080
租賃負債(流動及非流動)	95,868	106,742	16,118	90,624
	\$ 1,602,572	1,613,446	1,496,742	116,704

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險—匯率風險

(1)匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	111.12.31			110.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 6,363	30.66	195,083	5,883	27.63	162,553
人民幣	162,862	4.3843	714,037	218,667	4.3196	944,551
<u>非貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 90,747	30.66	2,782,299	97,848	27.63	2,703,546
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 15,126	30.66	463,752	13,635	27.63	376,733
人民幣	3,481	4.3843	15,260	8,702	4.3196	37,589

(2)敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一一年及一一〇年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一一年度及一一〇年度之稅後淨利將分別增加或減少3,441千元及5,542千元。

(3)貨幣性項目之兌換損益

由於本公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一一年度及一一〇年度外幣兌換淨利益(含已實現及未實現)分別為1,042千元及30,949千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(4)其他價格風險

如報導日金融資產－價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)稅後損益之影響如下：

報導日公允價值	111年度	110年度
上漲1%	\$ <u>1,939</u>	<u>7,761</u>
下跌1%	\$ <u>(1,939)</u>	<u>(7,761)</u>

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

本公司之非衍生性短期金融工具以其在個體資產負債表上之帳面價值估計其公允價值，因為此類金融工具到期日甚近，故其帳面價值應屬估計公允價值之合理基礎。此方法應用於按攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債，包含現金及約當現金、應收票據及帳款(含關係人)、應付票據及帳款(含關係人)、其他金融資產－流動、存出保證金及存入保證金等。

除上述金融工具及租賃負債依規定無須揭露公允價值資訊外，各財務報導日合併公司其餘各項金融工具之帳面價值及公允價值彙總如下：

		111.12.31			
		公 允 價 值			合 計
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	\$ <u>242,418</u>	<u>242,418</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>242,418</u>
		110.12.31			
		公 允 價 值			合 計
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	\$ <u>970,068</u>	<u>970,068</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>970,068</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

本公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

(3)民國一一一年度及一一〇年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十九)財務風險管理

1.概要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十八)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於本公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十八)。另，截至民國一一年及一〇年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

4.流動性風險

流動性風險係本公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。本公司管理流動性之方法係盡可能確保本公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使本公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督本公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控本公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保本公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一一年十二月三十一日止，本公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度154,700千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

本公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

(1)本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(二十)資本管理

董事會管理資本之目標係確保本公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據本公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定本公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對本公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據本公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定本公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一十一年十二月三十一日止，本公司資本管理之方式並未改變。

本公司於報導日之負債權益比率如下：

	111.12.31	110.12.31
負債總額	\$ <u>1,947,564</u>	<u>2,598,003</u>
權益總額	\$ <u>4,678,997</u>	<u>5,656,852</u>
負債權益比率	<u>42%</u>	<u>46%</u>

(廿一)非現金交易之籌資活動

本公司非現金交易籌資活動如下：

1.以租賃方式取得使用權資產，請詳附註六(八)。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.來自籌資活動之負債之調節如下表：

	111.1.1	現金流量	其 他	111.12.31
租賃負債(流動及非流動)	\$ 95,868	(14,893)	263	81,238
存入保證金	26,080	(9,960)	-	16,120
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 121,948</u>	<u>(24,853)</u>	<u>263</u>	<u>97,358</u>

	110.1.1	現金流量	其 他	110.12.31
租賃負債(流動及非流動)	\$ 85,390	(12,271)	22,749	95,868
存入保證金	11,985	14,095	-	26,080
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 97,375</u>	<u>1,824</u>	<u>22,749</u>	<u>121,948</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本個體財務報告之涵蓋期間內本公司之子公司及其他與本公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與本公司之關係
MCU Holdings Ltd. (MCU)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	本公司之合併子公司
Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	本公司之合併子公司
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	本公司之合併子公司
盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	本公司之合併子公司
Best Health Electronics Corp. (Best Health)	本公司之合併子公司
Best Health Electronics HK Limited (Best Health HK)	本公司之合併子公司
悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	本公司之合併子公司
Anchip Technology Corporation (Anchip)	本公司之合併子公司
安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	本公司之合併子公司
Best Power Electronics Corp. (Best Power)	本公司之合併子公司
Best Driver-tech Corp.(Best Driver-tech)	本公司之合併子公司
芯微電子(杭州)有限公司(芯動微)	本公司之合併子公司
Best Module-tech Corp.(Best Module-tech)	本公司之合併子公司
易智芯科技(廈門)有限公司(易智芯)	本公司之合併子公司
芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	本公司之合併子公司
合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	本公司之合併子公司
金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor (India) Private Ltd. (Holtek INDIA)	本公司之合併子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

關係人名稱	與本公司之關係
優方科技股份有限公司(優方)	本公司之合併子公司
Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	本公司之合併子公司
優方科技(東莞)有限公司(優方東莞)	本公司之合併子公司
倍創科技股份有限公司(倍創)	本公司之合併子公司
Best Modules Corp. (Best Modules)	本公司之合併子公司
倍易創新電子商務(廈門)有限公司(倍易創新)	本公司之合併子公司
芯通科技股份有限公司(芯通)	本公司之合併子公司
BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	本公司之合併子公司
芯通電子科技(東莞)有限公司(芯通東莞)	本公司之合併子公司
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	本公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	本公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	本公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	本公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	本公司之關聯企業
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	本公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	本公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	本公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	本公司之關聯企業
Bestway Electronic Inc.(Bestway)	本公司之關聯企業
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	本公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	本公司之關聯企業
泓達科技有限公司(泓達)	本公司之關聯企業
鈺威科技股份有限公司(鈺威)	本公司之關聯企業

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	111年度	110年度
合泰	\$ 1,343,653	2,373,348
芯群	792,360	882,541
金科	173,727	674,000
子公司	177,011	377,010
關聯企業	<u>767,290</u>	<u>1,116,287</u>
	<u>\$ 3,254,041</u>	<u>5,423,186</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司與合泰、芯群及金科之銷貨交易係透過第三地公司間接銷貨。

本公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至120天。本公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一一年及一一〇年十二月三十一日止，本公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為571,110千元及805,776千元，帳列採用權益法之投資項下。

本公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項(含備抵損失)明細如下：

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
合泰	\$ 64,023	356,918
芯群	448,424	318,062
子公司	30,874	98,823
關聯企業	<u>154,473</u>	<u>183,142</u>
	<u>\$ 697,794</u>	<u>956,945</u>

本公司因上述銷貨交易產生之關係人暫收款項明細如下：

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
暫收款-關聯企業(帳列其他流動負債)	<u>\$ 21,162</u>	<u>-</u>

2. 進貨及其他

本公司向關係人進貨金額如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
子公司	<u>\$ 37,804</u>	<u>41,449</u>

本公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

本公司委託關係人提供積體電路銷售服務支出金額如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
子公司	<u>\$ 41,507</u>	<u>36,272</u>

本公司因上述進貨及其他交易產生之應付款項如下：

	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
應付帳款-子公司(帳列應付帳款-關係人)	<u>\$ 8,136</u>	<u>8,092</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.其他交易

民國一一一年度及一一〇年度本公司向合併子公司及關聯企業收取人力支援等服務性質之收入分別為12,273千元及112,214千元。本公司因前述交易及代墊等所產生之應收款項餘額，於民國一一一年及一一〇年十二月三十一日分別為2,349千元及1,363千元，帳列其他金融資產—流動項下。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	<u>111年度</u>	<u>110年度</u>
短期員工福利	\$ 26,206	33,886
退職後福利	<u>432</u>	<u>432</u>
	<u>\$ 26,638</u>	<u>34,318</u>

八、質押之資產

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>111.12.31</u>	<u>110.12.31</u>
定期存款(帳列其他 金融資產—流動)	其他保證金	<u>\$ 8,818</u>	<u>8,813</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)本公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

(二)本公司之子公司與一供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金(帳列其他非流動資產項下)，約定本公司需購買之相關年限及最低數量。本公司考量市場需求，依合約估列相關合約負債準備，帳列其他流動負債及營業成本項下。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	111年度			110年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	36,885	711,960	748,845	45,789	966,377	1,012,166
勞健保費用	2,872	49,024	51,896	2,801	45,186	47,987
退休金費用	1,826	29,814	31,640	1,732	25,679	27,411
董事酬金	-	19,099	19,099	-	35,499	35,499
其他員工福利費用	1,721	19,982	21,703	1,884	21,838	23,722
折舊費用	5,614	42,122	47,736	7,667	36,765	44,432
攤銷費用	23	61,182	61,205	561	67,484	68,045

本公司民國一一一年度及一一〇年度員工人數及員工福利費用額外資訊如下：

	111年度	110年度
員工人數	460	448
未兼任員工之董事人數	4	4
平均員工福利費用	\$ 1,873	2,503
平均員工薪資費用	\$ 1,642	2,279
平均員工薪資費用調整情形	(28)%	34%
監察人酬金	\$ -	-

本公司薪資報酬政策(包括董事、經理人及員工)資訊如下：

- 1.董事酬勞：各董事酬勞之分配由董事長擬案，提請薪資酬勞委員會通過後給付。
- 2.員工及經理人薪資：依照本公司「起薪及調薪辦法」，並參考年資、績效等綜合因素辦理。
- 3.員工及經理人季獎金：依照本公司「員工季獎金發放標準公告」辦理。
- 4.員工及經理人年終獎金：依照本公司年度營運成績，由總經理室提出年終獎金額度，並經權責主管依據個人績效考核後辦理。
- 5.本公司已設立審計委員會取代監察人制度。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一年度本公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高持股比率	備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值		
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	7,422	115,414	-	115,414	-	
本公司	統一強棒貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	7,495	127,004	-	127,004	-	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	2,500	45,697	5.00 %	45,697	5.00 %	
盛凌投資股份有限公司	諧永投資股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	48,736	453,828	3.03 %	453,828	3.03 %	
盛凌投資股份有限公司	金信科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	127	101	2.49 %	101	6.08 %	
盛凌投資股份有限公司	精匠微電子股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	650	3,485	17.81 %	3,485	17.81 %	

- 4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面成本	處分損益	單位數	金額
本公司	統一強棒貨幣市場基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	統一投信	-	28,354	476,558	40,805	690,220	61,664	1,042,764	1,039,778	2,986	7,495	127,000 (註)
本公司	元大得寶貨幣市場基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	元大投信	-	28,039	339,029	8,233	100,000	36,272	440,779	439,029	1,749	-	- (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳附註十三(一)。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額(註2)	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	合泰	本公司之子公司	銷貨	1,343,653	27 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	64,023	8 %	
本公司	芯群	本公司之子公司	銷貨	792,360	16 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	448,424	57 %	
本公司	欣宏	合併公司之關聯企業	銷貨	258,936	5 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	54,175	7 %	
本公司	金科	本公司之子公司	銷貨	173,727	4 %	月結120天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	5,220	1 %	
本公司	Truetek	合併公司之關聯企業	銷貨	167,083	3 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	27,921	4 %	
本公司	Tech Wave	合併公司之關聯企業	銷貨	160,576	3 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	46,581	6 %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	148,526	3 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	24,835	3 %	

註1：僅就認列收益及資產之公司作單向表達。

註2：應收票據及帳款餘額含備抵損失。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	芯群	子公司	450,059	2.07	-	即期收款	81,948 (註)	1,635

註：係截至民國一一二年二月十日止收回之金額。

9.從事衍生性商品交易：無。

(二)轉投資事業相關資訊：

本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	665,449	665,449	22,053	100.00 %	1,341,014	100.00 %	61,814	61,814	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	193,416	100.00 %	(22,601)	(22,601)	本公司之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	23,034	100.00 %	1,556	1,556	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA), INC.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	23,034	100.00 %	1,556	註1	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	1,224,832	100.00 %	62,178	62,178	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	9,733	9,733	300	40.00 %	41,409	40.00 %	(11,515)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd.(BVI)	B.V.I.	投資海外各項投資	9,473	9,473	300	100.00 %	16,436	100.00 %	1,894	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	ForIC Electronics HK Limited	香港	電子元器件及單片機蕊片的技術支持與諮詢服務	866	866	200	100.00 %	34,424	100.00 %	5,244	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	70,189	40.00 %	6,019	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Truetek Technology Ltd.	Truetek Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機蕊片的技術研發與諮詢服務	34,652	34,652	8,000	100.00 %	89,547	100.00 %	13,623	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	31,124	31,124	1,045	40.00 %	52,276	40.00 %	5,939	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Quanding Technology Holding Ltd.	Quanding Technology HK Limited	香港	電子元器件及單片機蕊片的技術研發與諮詢服務	2,137	2,137	500	100.00 %	24,494	100.00 %	225	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,758	3,758	180	40.00 %	67,829	40.00 %	12,451	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Santek Holdings Ltd.	Santek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,662	8,662	2,000	100.00 %	92,934	100.00 %	23,133	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	3,470	3,470	800	40.00 %	6,909	40.00 %	(73,061)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newwave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	24,784	24,784	800	40.00 %	90,908	40.00 %	23,551	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	8,105	8,105	1,501	40.61 %	77,568	40.61 %	(14,271)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Newtek Electronics Ltd.	Newtek Electronics HK Limited	香港	投資並提供電子元件與單片機晶片之應用與技術諮詢	8,662	8,662	2,000	100.00 %	22,045	100.00 %	3,308	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	2,641	2,641	80	40.00 %	141,239	40.00 %	23,396	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	7,039	7,039	1	40.00 %	(140)	40.00 %	(7,209)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	2,937	2,937	1	60.00 %	33,297	60.00 %	28,298	註1	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	26,835	40.00 %	3,058	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	泓達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	9,115	33.33 %	1,639	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項投資	6,405	6,405	1	40.00 %	10,102	40.00 %	(1,401)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	19,808	20,965	5	75.00 %	47,949	80.00 %	23,221	註1	本公司之孫公司
Best Health Electronics Corporation	Best Health Electronics HK Limited	香港	電子元器件與單片機芯片的技術支持與諮詢服務	1,299	1,299	300	100.00 %	18,505	100.00 %	14,897	註1	本公司之孫公司投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Best Power Electronics Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	-	8,844	-	- %	-	100.00 %	72	註1、2	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Best Driver-Tech Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	6,753	6,753	2	80.00 %	18,893	80.00 %	10,807	註1	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Module-Tech Corpoation	B.V.I.	投資海外各項事業	12,426	12,426	3	100.00 %	13,470	100.00 %	144	註1	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Risingtek Corporation	B.V.I.	投資海外各項事業	-	15,603	-	- %	-	40.00 %	(97)	註1、3	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機晶片之技術支持與諮詢服務業務	3	3	6	0.10 %	3	0.10 %	1,237	(1)	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	429,826	42,983	100.00 %	794,353	100.00 %	68,910	68,910	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,941	95,941	7,880	40.00 %	142,845	40.00 %	66,713	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	59,204	59,204	2,000	100.00 %	138,567	100.00 %	10,254	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	79,680	79,680	2,000	100.00 %	159,923	100.00 %	56,247	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
欣宏電子股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	18,531	36.88 %	16,193	註1	本公司之孫公司
盛凌投資股份有限公司	鉅威科技股份有限公司	新北市	一般投資業	11,191	15,113	1,119	22.38 %	24,618	22.38 %	55,916	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	8,000	8,000	800	40.00 %	20,102	40.00 %	16,193	註1	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,140	6,140	200	100.00 %	41,416	100.00 %	9,872	註1	本公司之孫公司投資之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
盛凌投資股份有限公司	天字微機電股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	20.00 %	662	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	芯通科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、國際貿易業及資訊軟體服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	21,613	100.00 %	6,539	註1	本公司之孫公司
芯通科技股份有限公司	Bestcomm RF Electronics Inc.	B.V.I.	投資海外各項事業	14,054	14,054	30	100.00 %	13,841	100.00 %	1,813	註1	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	倍創科技股份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發、無店面零售業、國際貿易業	105,000	25,000	10,500	100.00 %	95,521	100.00 %	(3,508)	註1	本公司之孫公司
倍創科技股份有限公司	Best Modules Corp.	B.V.I.	投資海外各項事業	28,236	10,789	7	100.00 %	12,124	100.00 %	1,086	註1	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務	2,945	2,945	6,479	99.90 %	2,313	99.90 %	(1,237)	註1	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：Best Power Electronics Corporation 於民國一一年十一月進行清算並退回股款。

註3：Risingtek Corporation 於民國一一年三月進行清算並退回股款。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	322,726	(註1)	290,645	-	-	290,645	(45,513)	100 %	100 %	(45,513) (註5)	417,982	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路及電子元器件及單片機芯片的批發與進出口業務並提供技術諮詢服務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	87,295	100 %	100 %	87,295 (註5)	838,579	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(44,468)	40 %	40 %	(17,787)	11,803	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元器件及單片機芯片的技術支持與諮詢服務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	(11,188)	40 %	40 %	(4,475)	75,063	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	21,479	40 %	40 %	8,591 (註5)	184,757	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(18,636)	40 %	40 %	(7,454)	30,703	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	1,893	40 %	40 %	757	16,042	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	65,860	(註1)	2,647	-	-	2,647	(17,563)	40.61 %	40.61 %	(7,132) (註5)	131,130	-
信霖微智電子(上海)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	(7,654)	40 %	40 %	(3,061)	79,617	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	18,446	(註1)	1,964	-	-	1,964	22,954	40 %	40 %	9,182 (註5)	341,039	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	21,670	(註1)	1,600	-	-	1,600	5,939	40 %	40 %	2,376	79,878	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	(22,605)	100 %	100 %	(22,605) (註5)	193,375	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(7,197)	40 %	40 %	(2,879)	(1,375)	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	28,311	60 %	60 %	16,987	51,165	-
集芯源電子科技(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片的技術研發與諮詢服務	11,974	(註1)	-	-	-	-	(1,416)	40 %	40 %	(567)	23,953	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
悠健電子(東莞)有限公司	電子元件及單片機蕊片的技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	8,305	75 %	80 %	6,229	40,528	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元件、單片機蕊片的技術研發、技術服務及銷售	13,634	(註1)	9,392	-	-	9,392	1,773	100 %	100 %	1,773	13,071	-
優方科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元件、單片機蕊片的技術研發、技術服務及銷售	4,285	(註1)	-	-	-	-	9,948	54.75 %	54.75 %	5,446 (註5)	39,241	-
芯動微電子(杭州)有限公司	集成電路、電子元件、單片機蕊片的技術開發、技術服務及銷售	6,361	(註1)	-	-	-	-	10,803	80.00 %	80.00 %	8,642	20,851	-
易智芯科技(廈門)有限公司	設計、開發、生產集成電路、電子元件及單片機蕊件及其所需的組件及軟件產品，並提供相關技術諮詢及售後服務	10,573	(註1)	-	-	-	-	141	100.00%	100.00%	141	11,012	-
倍易創新電子商務(廈門)有限公司	從事互聯網銷售、集成電路、電子元件、單片機蕊片及其所需的組件及軟件產品的技術開發、技術服務及銷售	28,307	(註1)	10,806	17,501	-	28,307	1,126	100.00%	100.00%	1,126	12,129	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准 投資金額(註3)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額(註 4)
658,752 (美金21,851千元)	825,634 (美金26,929千元)	2,807,398

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；盛群經核准之金額係核准自台灣匯出投資金額計670,033千元(美金21,854千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計155,601千元(美金5,075千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。本公司之限額計算為淨值4,678,997千元 $\times$ 60%=2,807,398千元。

註5：係依同期間經台灣母公司會計師查核之財務報告認列投資損益。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一一一年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

(四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79 %

十四、部門資訊

請詳民國一一一年度合併財務報告。

盛群半導體股份有限公司



負責人： 吳啟勇

